

Dell PowerEdge R570

Guía técnica

Es posible que este contenido se haya traducido con IA. Para obtener más información, consulte el siguiente [enlace](#).

Notas, avisos y advertencias

 **NOTA:** NOTE indica información importante que lo ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** CAUTION indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

 **AVISO:** WARNING indica la posibilidad de daños en la propiedad, lesiones personales o la muerte.

Tabla de contenido

Capítulo 1: Configuraciones y características del PowerEdge R570 sistema.....	5
Cargas de trabajo clave.....	5
Nuevas tecnologías.....	6
Capítulo 2: Comparación de productos.....	8
Capítulo 3: Vistas y características del chasis.....	11
Configuraciones del sistema: vista frontal del sistema PowerEdge R570.....	11
Panel de control izquierdo (LCP), vista secundaria.....	24
Panel de control derecho (RCP): vista principal.....	25
Configuraciones del sistema: vista posterior del sistema PowerEdge R570.....	26
Configuraciones del sistema: vista interior del PowerEdge R570 sistema.....	31
Código QR de los recursos del PowerEdge R570 sistema.....	33
Configuraciones del chasis.....	33
Capítulo 4: Procesador.....	34
Características del procesador.....	34
Procesadores admitidos.....	34
Capítulo 5: Subsistema de memoria.....	36
Memoria compatible.....	36
Reglas de la memoria del sistema.....	36
Capítulo 6: almacenamiento.....	39
Controladoras de almacenamiento.....	39
Guía del usuario de las controladoras de almacenamiento del servidor.....	39
Unidades compatibles.....	39
Unidades de disco duro (HDD).....	40
Configuración de almacenamiento interno.....	42
Almacenamiento externo.....	42
Capítulo 7: Redes.....	43
Descripción general.....	43
Soporte de OCP 3.0.....	43
Tarjetas de OCP admitidas.....	43
NIC del OCP 3.0 frente a 2.0.....	44
Factores de forma de OCP.....	44
Capítulo 8: Subsistema PCIe.....	45
Tarjetas elevadoras PCIe.....	45
Capítulo 9: Especificaciones térmicas, acústicas y de alimentación.....	50
Alimentación.....	50

Fuentes de alimentación.....	50
Térmico.....	52
Diseño térmico.....	52
Acústica.....	53
Configuraciones acústicas de R570.....	53
Capítulo 10: Manejo de cables, rieles y rack.....	56
Información de manejo de cables y rieles.....	56
Capítulo 11: Sistemas operativos y virtualización.....	65
Sistemas operativos soportados.....	65
Capítulo 12: Dell Systems Management.....	66
Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC).....	66
Matriz de soporte de software de administración de sistemas.....	67
Capítulo 13: Apéndice A: Especificaciones adicionales.....	69
Dimensiones del chasis.....	69
Peso del sistema.....	70
Especificaciones del puerto NIC.....	71
Especificaciones de la DPU.....	71
Especificaciones de vídeo.....	71
Puertos USB.....	72
Clasificación de PSU.....	73
Especificaciones ambientales.....	74
Especificaciones de contaminación gaseosa y de partículas.....	75
Matriz de restricción térmica.....	76
Capítulo 14: Apéndice B: Cumplimiento de estándares.....	81
Capítulo 15: Apéndice C: Recursos adicionales.....	82
Capítulo 16: Apéndice D: servicio y soporte.....	83
¿Por qué anexar contratos de servicio?.....	83
ProSupport Infrastructure Suite.....	83
Servicios de soporte de especialidad.....	85
ProDeploy Infrastructure Suite.....	86
Servicios de implementación complementarios.....	89
Escenarios exclusivos de implementación.....	90
DÍA 2: servicios de automatización con Ansible.....	91
Servicios de Dell Technologies Consulting.....	91

Configuraciones y características del PowerEdge R570 sistema

El PowerEdge R570 sistema es un servidor de 2U que soporta lo siguiente:

- Un Procesador Intel® Xeon® 6 E-core con hasta 144 núcleos
- Un Procesador Intel® Xeon® 6 P-core con hasta 86 núcleos con opción R1S
- 16 ranuras DIMM
- Dos fuentes de alimentación redundantes de CA o CC*
- Hasta 12 unidades RAID SATA (HDD) de 3,5 pulgadas + 4 EDSFF E3. S unidades NVMe de 5.ª generación
- Hasta 8 unidades RAID NVMe (SSD) de 2,5 pulgadas.
- Hasta 8 unidades SSD NVMe de 2,5 pulgadas
- Hasta 8 unidades SATA (HDD/SSD) de 2,5 pulgadas
- Hasta 8 unidades de 2,5 pulgadas SATA/universales (HDD/SSD)
- Hasta 16 unidades RAID (HDD/SSD) SATA de 2,5 pulgadas
- Hasta 24 unidades SATA (HDD/SSD) de 2,5 pulgadas
- Hasta 8 EDSFF E3. Unidades NVMe de 5.ª generación S (corredor de aire caliente)
- Hasta 8 unidades EDSFF E3.S (pasillo frío) NVMe de 5.ª generación
- Hasta 16 unidades EDSFF E3.S (pasillo frío) NVMe de 5.ª generación
- Hasta 16 EDSFF E3. Unidades NVMe de 5.ª generación S (corredor de aire caliente)
- Hasta 32 EDSFF E3. Unidades NVMe de 5.ª generación S (corredor de aire caliente)

NOTA: Para obtener más información sobre cómo intercambiar en caliente el dispositivo SSD PCIe NVMe, consulte *Guía del usuario de SSD PCIe NVMe Express Flash de Dell* en Página [Soporte de Dell](#) > **Examinar todos los productos** > **Infraestructura** > **Infraestructura de centro de datos** > **Controladoras y adaptadores de almacenamiento** > **SSD PCIe NVMe Express Flash de Dell PowerEdge** > **Seleccionar este producto** > **Documentación** > **Manuales y documentos**.

NOTA: Todas las instancias de unidades SATA se mencionan como unidades en este documento, a menos que se indique lo contrario.

NOTA: La tarjeta madre se conoce como la placa del módulo de procesador host (HPM) en este documento.

NOTA: En este documento se proporciona una lista completa de las características del producto. Sin embargo, es posible que las características marcadas con un asterisco (*) no estén disponibles en el lanzamiento, pero pueden venir incluidas en futuras actualizaciones. Tenga en cuenta que en este documento no se confirma la disponibilidad ni el cronograma de lanzamiento de ninguna característica. Para obtener información más precisa y actualizada sobre la disponibilidad de las características, consulte la página del configurador del producto en [dell.com](#).

PRECAUCIÓN: No instale GPU, tarjetas de red u otros dispositivos de PCIe en el sistema que no hayan sido validados y probados por Dell. El daño causado por la instalación de hardware no autorizada e invalidada anulará la garantía del sistema.

Temas:

- [Cargas de trabajo clave](#)
- [Nuevas tecnologías](#)

Cargas de trabajo clave

Dell PowerEdge R570 ofrece un rendimiento potente en un servidor estándar especialmente diseñado que posee resiliencia cibernética. Ideal para los lugares siguientes:

- Virtualización/Cloud Scale
- Base de datos de escalamiento horizontal

- Computación en el perímetro
- Computación de alto rendimiento
- Nodo de almacenamiento definido por software

Nuevas tecnologías

El PowerEdge R570 es un sistema capaz de manejar aplicaciones y cargas de trabajo exigentes, como data warehouses, eCommerce, bases de datos y computación de alto rendimiento (HPC).

Tabla 1. Nuevas tecnologías

Tecnología	Descripción detallada
Procesador Intel® Xeon® 6 E-core	Conteo de núcleos: hasta 144 núcleos de procesador
	88 canales PCIe Gen 5.0 por CPU, bifurcación PCIe x16, x8, x4, x2 (5.ª generación)
	TDP máx.: hasta 330 W
Procesador Intel® Xeon® 6 P-core	Cantidad de núcleos: hasta 86 núcleos de procesador
	136 canales PCIe Gen 5.0 por CPU, bifurcación PCIe x16, x8, x4, x2 (5.ª generación)
	TDP máx.: hasta 350 W
Memoria DDR5	Hasta 8 canales por CPU y 16 DIMM en total
	Soporta RDIMM, DDR5 con ECC hasta 6400 MT/s
Generación de PCIe	5.ª generación a 32 GT/s
Ranura de PCIe	Hasta seis* ranuras PCIe con 16 canales en total
I/O flex.	I/O posterior con: • 1 puerto Ethernet BMC dedicado • 2 puertos USB 3.1 Type-A • 1 VGA
	Tarjeta NIC de OCP 3.0: 2 ranuras en la parte frontal (para la configuración de I/O frontal) 1 ranura en la parte posterior (para la configuración de I/O posterior)
	I/O frontal con: • 1 puerto USB 2.0 Type-C • 1 puerto USB 2.0 Type-A (opcional) • 1 Mini DisplayPort (opcional) • 1 serie DB9 (con configuración de I/O frontal) • 1 puerto Ethernet BMC dedicado (con configuración de I/O frontal)
M-PESTI	Protocolo semidúplex entre MCU y CPLD, la interfaz modular de banda lateral como parte del DC-MHS.
PERC dedicada	PERC 12 • H965i DC-MHS frontal • H365i DC-MHS frontal • Adaptador H365i • Adaptador H965i
Fuentes de alimentación	Doble PSU nuevo M-CRPS de 60 mm
	Platinum/Titanium de 800 W de CA/HVDC

Tabla 1. Nuevas tecnologías (continuación)

Tecnología	Descripción detallada
	Platinum/Titanium de 1100 W de CA/HVDC
	Titanium de 1500 W de CA/HVDC
	Titanium 1500 W 277 VCA y HVDC
	Titanium de 1800 W de CA/HVDC
	1400 W -48 V CC



NOTA: Pautas de compatibilidad con soporte vertical

- Los procesadores Intel Xeon R1S de núcleo P de 6 procesadores proporcionan una mayor cantidad de carriles PCIe en comparación con los procesadores Intel® Xeon de núcleo P de 6 procesadores estándares.
- En la plataforma PowerEdge R570:
 - Las tarjetas elevadoras RC1, RC4, RC6, RC8, RC10 y RC11 solo admiten procesadores R1S.
 - Las tarjetas elevadoras RC2 y RC9 son compatibles con las configuraciones de R1S y estándar de un solo procesador, según los requisitos de configuración de almacenamiento.
- La compatibilidad de las tarjetas verticales está sujeta al diseño específico de la plataforma y a las restricciones de asignación de carriles.
- Seleccione configuraciones de almacenamiento compatibles para garantizar la integridad del sistema y un rendimiento óptimo.

Comparación de productos

Tabla 2. Comparación de PowerEdge R570 y R760xs

Funciones	PowerEdge R570	PowerEdge R760xs
Procesador	- Un procesador Intel® Xeon® 6 E-core con hasta 144 núcleos - Un procesador Intel® Xeon® 6 P-core con hasta 86 núcleos con opción R1S	- Dos procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª generación (Sapphire Rapids) con hasta 32 núcleos - Dos procesadores escalables Intel® Xeon® de 5.ª generación (Emerald Rapids) con hasta 28 núcleos
Aceleradores	Hasta 3 DW de 400 W; Hasta 4 aceleradores SW de 75 W	Hasta dos aceleradores de ancho único de 75 W
Memoria		
Velocidad de DIMM	Hasta 6400 MT/s	Hasta 5200 MT/s
Tipo de memoria	RDIMM	RDIMM
Ranuras de módulos de memoria	16 ranuras DIMM DDR5	16 ranuras DIMM DDR5
	 NOTA: Solo admite DIMM DDR5 ECC registrados.	 NOTA: Solo soporta módulos DIMM DDR4 ECC registrados.
Almacenamiento		
Bahías frontales:	- Hasta 12 RAID SATA/HDD de 3,5 pulgadas, con un máximo de 384 TB - Hasta 8 RAID NVMe de 2,5 pulgadas, con un máximo de 491,52 TB - Hasta 8 unidades NVMe de 2,5 pulgadas con un máximo de 491,52 TB - Hasta 8 unidades de 2,5 pulgadas SATA con un máximo de 30,72 TB - Hasta 8 unidades de 2,5 pulgadas SATA/universal con un máximo de 491,52 TB - Hasta 16 unidades SATA RAID de 2,5 pulgadas con un máximo de 61,44 TB - Hasta 24 unidades de 2,5 pulgadas SATA con un máximo de 92,16 TB - Hasta 8 EDSFF E3.S (pasillo caliente) NVMe de 5.ª generación con un máximo de 491,52 TB - Hasta 8 EDSFF E3.S (pasillo frío) NVMe de 5.ª generación, con un máximo de 491,52 TB - Hasta 16 unidades EDSFF E3.S (pasillo frío) NVMe de 5.ª generación con un máximo de 983,04 TB - Hasta 16 EDSFF E3.S (pasillo caliente) NVMe de 5.ª generación con un máximo de 983,04 TB	- Bahía de unidad 0 - Hasta 8 SAS/SATA (HDD/SSD) de 3,5 pulgadas, con un máximo de 192 TB - Hasta 12 SAS/SATA (HDD/SSD) de 3,5 pulgadas, con un máximo de 288 TB - Hasta 8 SAS/SATA/NVMe (HDD SSD) de 2,5 pulgadas máximo 122,88 TB - Hasta 16 SAS/SATA/NVMe (HDD SSD) de 2,5 pulgadas máximo 121,6 TB - Hasta 16 (SAS/SATA) de 2,5 pulgadas + 8 (NVMe) (SSD) de 2,5 pulgadas, con un máximo de 244,48 TB

Tabla 2. Comparación de PowerEdge R570 y R760xs (continuación)

Funciones	PowerEdge R570	PowerEdge R760xs
	Hasta 32 EDSFF E3.S (pasillo caliente) NVMe de 5.ª generación con un máximo de 1966,08 TB	
Bahías posteriores:	Hasta 4 EDSFF E3.S NVMe de 5.ª generación con un máximo de 245,76 TB	Hasta 2 SAS/SATA/NVMe (HDD SSD) de 2,5 pulgadas máximo 30,72 TB
Controladoras de almacenamiento		
Controladoras internas	- PERC H365i DC-MHS frontal - PERC H965i DC-MHS frontal - Adaptador de PERC H365i - PERC H965i	- PERC H355 - PERC H755 - PERC H755N - HBA465i - PERC H965i - HBA355i, - HBA465i
Controladoras externas	- HBA 465e - PERC H965e	- HBA355e, - H965e
RAID de software	N/A	S160
Arranque interno	- Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS) - Unidad intermedia M.2 con hasta 2 SSD NVMe M.2 - USB	- Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1): HWRAID 2 x SSD M.2 - USB interno
Administración de sistema	- iDRAC - iDRAC Direct - API RESTful de iDRAC con Redfish - CLI de RACADM - iDRAC Service Module (iSM)	- iDRAC9 - iDRAC Direct - API RESTful de iDRAC con Redfish - iDRAC Service Module - Módulo inalámbrico de Quick Sync 2.0
Unidad de fuente de alimentación	- Platinum/Titanium de 800 W y 100-240 VCA o 240 HVDC, redundante y de intercambio en caliente - Platinum/Titanium de 1100 W y 100-240 VCA o 240 HVDC, redundante y de intercambio en caliente 1400 W -48 VCC, redundante y de intercambio en caliente - Titanium de 1500 W y 100-240 VCA o 240 HVDC, redundante y de intercambio en caliente 1500 W 277 V CA y HVDC Titanium, redundante y de intercambio en caliente - Titanium de 1800 W y 100-240 VCA o 240 HVDC, redundante y de intercambio en caliente	- Platinum de 600 W y 100-240 VCA/240 VCC - Titanium de 700 W y 200-240 VCA/240 VCC - Platinum de 800 W y 100-240 VCA/240 VCC 1100 W de CC/-48-(-60) V - Titanium de 1100 W y 100-240 V de CA/240 V de CC - Titanium de 1400 W y 100-240 VCA/240 VCC - Platinum de 1400 W y 100-240 V de CA/240 V de CC - Titanium de 1400 W y 277 VCA/366 VCC - Titanium de 1800 W y 200-240 VCA/240 VCC
Puertos		
Opciones de red	Hasta dos tarjetas NIC de OCP 3.0: 2 ranuras en la parte frontal o 1 ranura en la parte posterior	2 LOM de 1 GbE - Máximo de 1 OCP 3.0 (opcional)
Puertos frontales	1 puerto USB 2.0 Type-C (HOST/BMC directo)	1 puerto de iDRAC Direct (USB MicroAB) 1 USB 2.0

Tabla 2. Comparación de PowerEdge R570 y R760xs (continuación)

Funciones	PowerEdge R570	PowerEdge R760xs
	1 puerto USB 2.0 Type-A (KVM LCP opcional) 1 puerto mini-DisplayPort (KVM LCP opcional) 1 serie DB9 (con configuración de I/O frontal) 1 puerto Ethernet BMC dedicado (con configuración de I/O frontal)	1 VGA
Puertos posteriores	1 puerto Ethernet BMC dedicado 2 puerto USB 3.1 Type-A 1 VGA	1 x puerto ethernet iDRAC dedicado 1 USB 2.0 1 USB 3.0 1 serial (opcional) 1 VGA 2 Ethernet
Puertos internos	1 puerto USB 3.1 Type-A	1 USB 3.0 (opcional)
Ranuras		
PCIe	Hasta cuatro ranuras PCIe Gen5	Hasta dos ranuras PCIe Gen5
Factor de forma	Servidor en rack de 2U	Servidor en rack de 2U
Dimensiones y peso		
Altura	86,8 mm (3,42 pulgadas)	86,8 mm (3,42 pulgadas)
Anchura	482,0 mm (18,98 pulgadas)	482,0 mm (18,98 pulgadas)
Profundidad	802,38 mm (31,59 pulgadas) con bisel 801,49 mm (31,55 pulgadas) sin bisel (Pasillo frío/configuración de I/O frontal): 814,5 mm (32,06 pulgadas) sin bisel  NOTA: La configuración de I/O frontal no soporta el bisel	721,62 mm (28,4 pulgadas) con bisel 707,78 mm (27,85 pulgadas) sin bisel
Peso	Máx. 31 kg (68,3 lb)	Máx. 28.6 kg (63,0 lb)

Vistas y características del chasis

Temas:

- Configuraciones del sistema: vista frontal del sistema PowerEdge R570
- Configuraciones del sistema: vista posterior del sistema PowerEdge R570
- Configuraciones del sistema: vista interior del PowerEdge R570 sistema
- Código QR de los recursos del PowerEdge R570 sistema
- Configuraciones del chasis

Configuraciones del sistema: vista frontal del sistema PowerEdge R570

Vistas frontales de R570

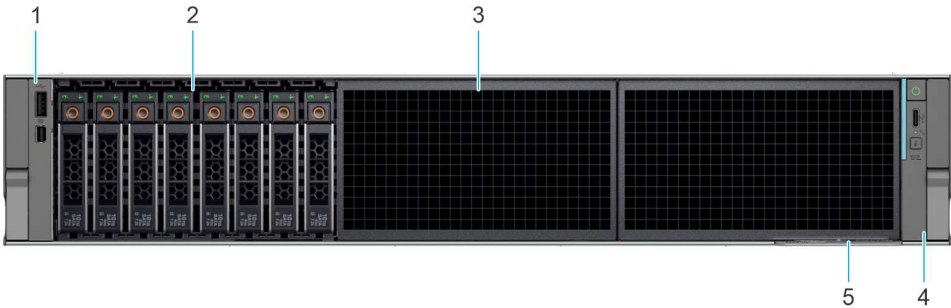


Ilustración 1. Vista frontal de un sistema de 8 unidades de 2,5 pulgadas

Tabla 3. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento	Puertos, paneles y ranuras	Icono	Descripción
1	Panel de control izquierdo (LCP): secundario	N/A	Contiene el puerto USB 2.0 Type-A (LCP opcional y KVM secundario) y el puerto Mini-DisplayPort (LCP opcional y KVM secundario). • Puerto USB 2.0 Type-A (LCP opcional y KVM secundario): este puerto es compatible con USB 2.0 y las funciones LCP opcional y KVM secundario. • Mini DisplayPort: permite conectar un dispositivo de visualización al sistema. NOTA: Utilice un cable Mini DisplayPort a DisplayPort certificado que cumpla con

Tabla 3. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema. (continuación)

Elemento	Puertos, paneles y ranuras	Icono	Descripción
			los estándares VESA DisplayPort para la salida de video con un monitor. NOTA: No se recomiendan adaptadores Mini DisplayPort a VGA o Mini DisplayPort a HDMI.
2	Unidades de 2,5 pulgadas	N/A	Permite instalar unidades compatibles en el sistema.
3	Unidad de relleno	De relleno	Panel de relleno para la ranura de unidad de almacenamiento
4	Panel de control derecho (RCP): principal	N/A	Contiene el LED de estado del sistema, el ID del sistema, el botón de encendido, el puerto USB Type-C y el LED de estado del host.
5	Etiqueta de servicio rápido	N/A	La etiqueta de servicio rápido es un panel de etiquetas deslizable hacia afuera que contiene información del sistema, como la etiqueta de servicio, la NIC, la dirección MAC, etc. Si ha optado por el acceso predeterminado seguro a iDRAC, la etiqueta de servicio rápido también contiene la contraseña predeterminada segura de iDRAC.

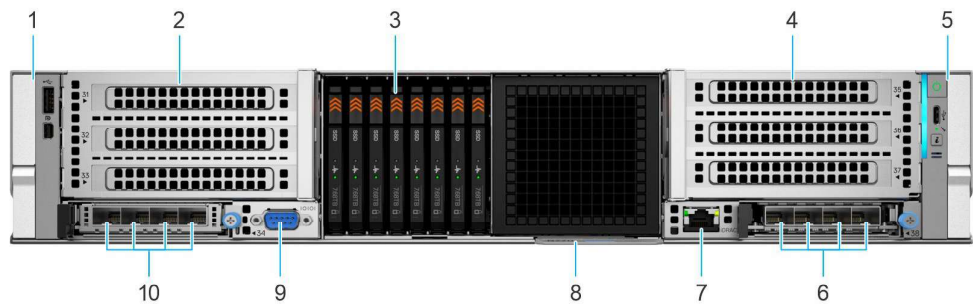


Ilustración 2. Vista frontal de un sistema de 8 unidades EDSFF E3.S NVMe (pasillo frío)

Tabla 4. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento	Puertos, paneles y ranuras	Icono	Descripción
1	Panel de control izquierdo (LCP): secundario	N/A	Contiene el puerto USB 2.0 Type-A (LCP opcional y KVM secundario) y el puerto Mini-DisplayPort (LCP opcional y KVM secundario).

Tabla 4. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema. (continuación)

Elemento	Puertos, paneles y ranuras	Icono	Descripción
			- Puerto USB 2.0 Type-A (LCP opcional y KVM secundario): este puerto es compatible con USB 2.0 y las funciones LCP opcional y KVM secundario. - Mini DisplayPort: permite conectar un dispositivo de visualización al sistema. NOTA: Utilice un cable Mini DisplayPort a DisplayPort certificado que cumpla con los estándares VESA DisplayPort para la salida de video con un monitor. NOTA: No se recomiendan adaptadores Mini DisplayPort a VGA o Mini DisplayPort a HDMI.
2	Tarjeta elevadora para tarjetas de expansión PCIe frontal 1	De relleno	La tarjeta elevadora para tarjetas de expansión permite conectar tarjetas de expansión PCI Express.
3	Unidades EDSFF E3.S	N/A	Permite instalar unidades compatibles en el sistema.
4	Tarjeta elevadora para tarjetas de expansión PCIe frontal 3	De relleno	La tarjeta elevadora para tarjetas de expansión permite conectar tarjetas de expansión PCI Express.
5	Panel de control derecho (RCP): principal	N/A	Contiene el LED de estado del sistema, el ID del sistema, el botón de encendido, el puerto USB Type-C y el LED de estado del host.
6	NIC de OCP (Principal/ Secundaria) NOTA: El OCP principal está en la ranura 38 en la parte inferior.	N/A	Le permite instalar el OCP principal/secundario en función de las configuraciones de tarjeta elevadora.
7	Puerto Ethernet de iDRAC dedicado	N/A	Permite acceder al puerto de la iDRAC.
8	Unidad de relleno	De relleno	Panel de relleno para la ranura de unidad de almacenamiento
9	Puerto serial COM		Permite conectar un dispositivo en serie al sistema.
10	NIC OCP o BOSS-N1 DC-MHS (ranura 34)	N/A	Permite instalar una controladora OCP o BOSS-N1

Tabla 4. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema. (continuación)

Elemento	Puertos, paneles y ranuras	Icono	Descripción
			DC-MHS secundaria, según la configuración de la tarjeta elevadora. NOTA: La OCP secundaria no soporta la característica de NIC compartida.



Ilustración 3. Vista frontal de un sistema de 16 unidades EDSFF E3.S NVMe (pasillo frío)

Tabla 5. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento	Puertos, paneles y ranuras	Icono	Descripción
1	Panel de control izquierdo (LCP): secundario	N/A	Contiene el puerto USB 2.0 Type-A (LCP opcional y KVM secundario) y el puerto Mini-DisplayPort (LCP opcional y KVM secundario). • Puerto USB 2.0 Type-A (LCP opcional y KVM secundario): este puerto es compatible con USB 2.0 y las funciones LCP opcional y KVM secundario. • Mini DisplayPort: permite conectar un dispositivo de visualización al sistema. NOTA: Utilice un cable Mini DisplayPort a DisplayPort certificado que cumpla con los estándares VESA DisplayPort para la salida de video con un monitor. NOTA: No se recomiendan adaptadores Mini DisplayPort a VGA o Mini DisplayPort a HDMI.
2	Tarjeta elevadora para tarjetas de expansión PCIe frontal 1	De relleno	La tarjeta elevadora para tarjetas de expansión permite

Tabla 5. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema. (continuación)

Elemento	Puertos, paneles y ranuras	Icono	Descripción
			conectar tarjetas de expansión PCI Express.
3	Unidades EDSFF E3.S	N/A	Permite instalar unidades compatibles en el sistema.
4	Tarjeta elevadora para tarjetas de expansión PCIe frontal 3	De relleno	La tarjeta elevadora para tarjetas de expansión permite conectar tarjetas de expansión PCI Express.
5	Panel de control derecho (RCP): principal	N/A	Contiene el LED de estado del sistema, el ID del sistema, el botón de encendido, el puerto USB Type-C y el LED de estado del host.
6	NIC de OCP (Principal/ Secundaria) NOTA: El OCP principal está en la ranura 38 en la parte inferior.	N/A	Le permite instalar el OCP principal/secundario en función de las configuraciones de tarjeta elevadora.
7	Puerto Ethernet de iDRAC dedicado	N/A	Permite acceder al puerto de la iDRAC.
8	Unidades EDSFF E3.S	N/A	Permite instalar unidades compatibles en el sistema.
9	Puerto serial COM		Permite conectar un dispositivo en serie al sistema.
10	NIC OCP O BOSS-N1 DC-MHS (ranura 34)	N/A	Permite instalar una controladora OCP o BOSS-N1 DC-MHS secundaria, según la configuración de la tarjeta elevadora. NOTA: La OCP secundaria no soporta la característica de NIC compartida.

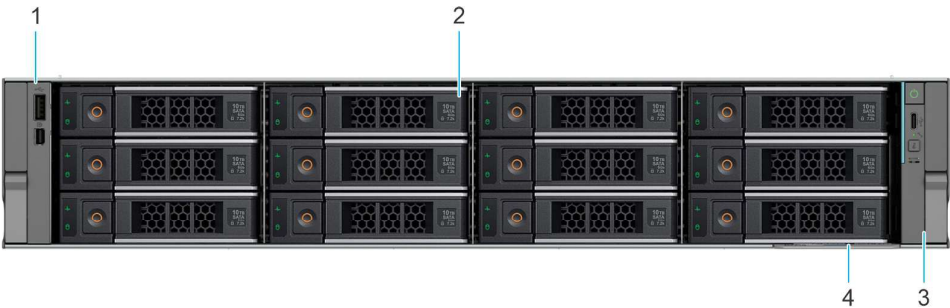


Ilustración 4. Vista frontal de un sistema de 12 unidades de 3,5 pulgadas

Tabla 6. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento	Puertos, paneles y ranuras	Icono	Descripción
1	Panel de control izquierdo (LCP): secundario	N/A	Contiene el puerto USB 2.0 Type-A (LCP opcional y KVM secundario) y el puerto Mini-

Tabla 6. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema. (continuación)

Elemento	Puertos, paneles y ranuras	Icono	Descripción
			DisplayPort (LCP opcional y KVM secundario). • Puerto USB 2.0 Type-A (LCP opcional y KVM secundario): este puerto es compatible con USB 2.0 y las funciones LCP opcional y KVM secundario. • Mini DisplayPort: permite conectar un dispositivo de visualización al sistema. NOTA: Utilice un cable Mini DisplayPort a DisplayPort certificado que cumpla con los estándares VESA DisplayPort para la salida de video con un monitor. NOTA: No se recomiendan adaptadores Mini DisplayPort a VGA o Mini DisplayPort a HDMI.
2	Unidades de 3,5 pulgadas	N/A	Permite instalar unidades compatibles en el sistema.
3	Panel de control derecho (RCP): principal	N/A	Contiene el LED de estado del sistema, el ID del sistema, el botón de encendido, el puerto USB Type-C y el LED de estado del host.
4	Etiqueta de servicio rápido	N/A	La etiqueta de servicio rápido es un panel de etiquetas deslizable hacia afuera que contiene información del sistema, como la etiqueta de servicio, la NIC, la dirección MAC, etc. Si ha optado por el acceso predeterminado seguro a iDRAC, la etiqueta de servicio rápido también contiene la contraseña predeterminada segura de iDRAC.

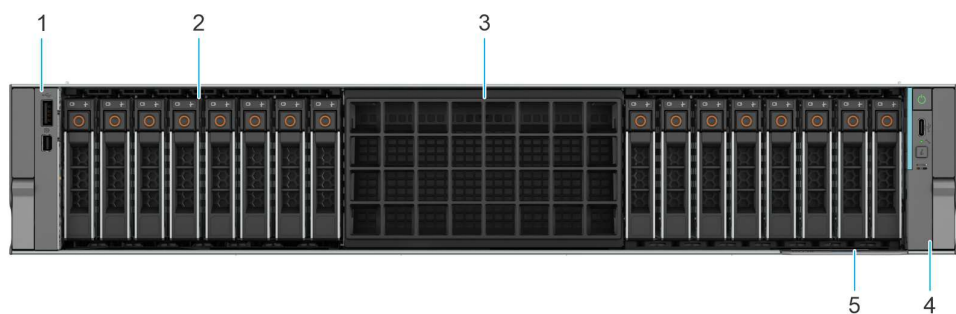


Ilustración 5. Vista frontal de un sistema de 16 unidades de 2,5 pulgadas

Tabla 7. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento	Puertos, paneles y ranuras	Icono	Descripción
1	Panel de control izquierdo (LCP): secundario	N/A	Contiene el puerto USB 2.0 Type-A (LCP opcional y KVM secundario) y el puerto Mini-DisplayPort (LCP opcional y KVM secundario). • Puerto USB 2.0 Type-A (LCP opcional y KVM secundario): este puerto es compatible con USB 2.0 y las funciones LCP opcional y KVM secundario. • Mini DisplayPort: permite conectar un dispositivo de visualización al sistema. NOTA: Utilice un cable Mini DisplayPort a DisplayPort certificado que cumpla con los estándares VESA DisplayPort para la salida de video con un monitor. NOTA: No se recomiendan adaptadores Mini DisplayPort a VGA o Mini DisplayPort a HDMI.
2	Unidades de 2,5 pulgadas	N/A	Permite instalar unidades compatibles en el sistema.
3	Unidad de relleno	De relleno	Panel de relleno para la ranura de unidad de almacenamiento
4	Panel de control derecho (RCP): principal	N/A	Contiene el LED de estado del sistema, el ID del sistema, el botón de encendido, el puerto USB Type-C y el LED de estado del host.
5	Etiqueta de servicio rápido	N/A	La etiqueta de servicio rápido es un panel de etiquetas deslizable hacia afuera que contiene información del sistema, como

Tabla 7. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema. (continuación)

Elemento	Puertos, paneles y ranuras	Icono	Descripción
			la etiqueta de servicio, la NIC, la dirección MAC, etc. Si ha optado por el acceso predeterminado seguro a iDRAC, la etiqueta de servicio rápido también contiene la contraseña predeterminada segura de iDRAC.

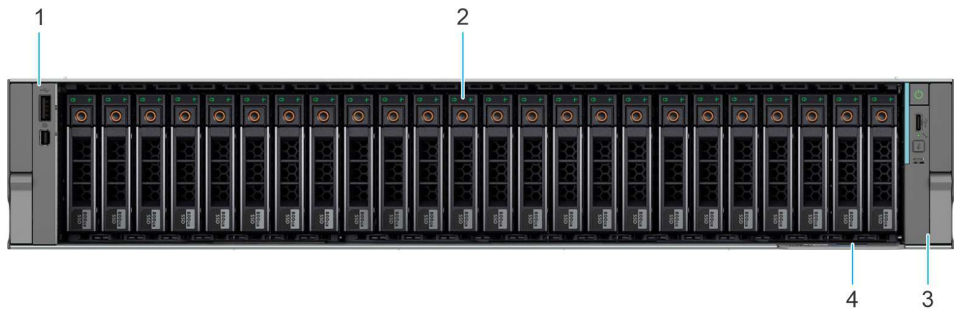


Ilustración 6. Vista frontal de un sistema de 24 unidades de 2,5 pulgadas

Tabla 8. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento	Puertos, paneles y ranuras	Icono	Descripción
1	Panel de control izquierdo (LCP): secundario	N/A	Contiene el puerto USB 2.0 Type-A (LCP opcional y KVM secundario) y el puerto Mini-DisplayPort (LCP opcional y KVM secundario). • Puerto USB 2.0 Type-A (LCP opcional y KVM secundario): este puerto es compatible con USB 2.0 y las funciones LCP opcional y KVM secundario. • Mini DisplayPort: permite conectar un dispositivo de visualización al sistema. NOTA: Utilice un cable Mini DisplayPort a DisplayPort certificado que cumpla con los estándares VESA DisplayPort para la salida de video con un monitor. NOTA: No se recomiendan adaptadores Mini DisplayPort a VGA o Mini DisplayPort a HDMI.
2	Unidades de 2,5 pulgadas	N/A	Permite instalar unidades compatibles en el sistema.

Tabla 8. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema. (continuación)

Elemento	Puertos, paneles y ranuras	Icono	Descripción
3	Panel de control derecho (RCP): principal	N/A	Contiene el LED de estado del sistema, el ID del sistema, el botón de encendido, el puerto USB Type-C y el LED de estado del host.
4	Etiqueta de servicio rápido	N/A	La etiqueta de servicio rápido es un panel de etiquetas deslizable hacia afuera que contiene información del sistema, como la etiqueta de servicio, la NIC, la dirección MAC, etc. Si ha optado por el acceso predeterminado seguro a iDRAC, la etiqueta de servicio rápido también contiene la contraseña predeterminada segura de iDRAC.

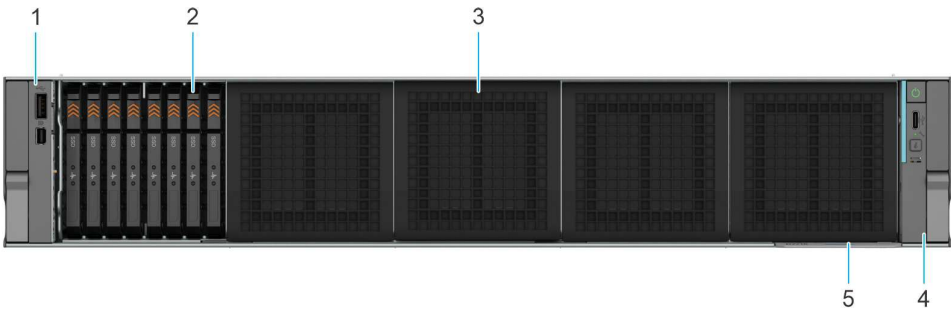


Ilustración 7. Vista frontal de 8 x EDSFF E3. Sistema de unidades S NVMe (pasillo caliente)

Tabla 9. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento	Puertos, paneles y ranuras	Icono	Descripción
1	Panel de control izquierdo (LCP): secundario	N/A	Contiene el puerto USB 2.0 Type-A (LCP opcional y KVM secundario) y el puerto Mini-DisplayPort (LCP opcional y KVM secundario). • Puerto USB 2.0 Type-A (LCP opcional y KVM secundario): este puerto es compatible con USB 2.0 y las funciones LCP opcional y KVM secundario. • Mini DisplayPort: permite conectar un dispositivo de visualización al sistema. NOTA: Utilice un cable Mini DisplayPort a DisplayPort certificado que cumpla con los estándares VESA DisplayPort para la salida de video con un monitor.

Tabla 9. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema. (continuación)

Elemento	Puertos, paneles y ranuras	Icono	Descripción
			 NOTA: No se recomiendan adaptadores Mini DisplayPort a VGA o Mini DisplayPort a HDMI.
2	Unidades EDSFF E3.S	N/A	Permite instalar unidades compatibles en el sistema.
3	Unidad de relleno	De relleno	Panel de relleno para la ranura de unidad de almacenamiento
4	Panel de control derecho (RCP): principal	N/A	Contiene el LED de estado del sistema, el ID del sistema, el botón de encendido, el puerto USB Type-C y el LED de estado del host.
5	Etiqueta de servicio rápido	N/A	La etiqueta de servicio rápido es un panel de etiquetas deslizable hacia afuera que contiene información del sistema, como la etiqueta de servicio, la NIC, la dirección MAC, etc. Si ha optado por el acceso predeterminado seguro a iDRAC, la etiqueta de servicio rápido también contiene la contraseña predeterminada segura de iDRAC.

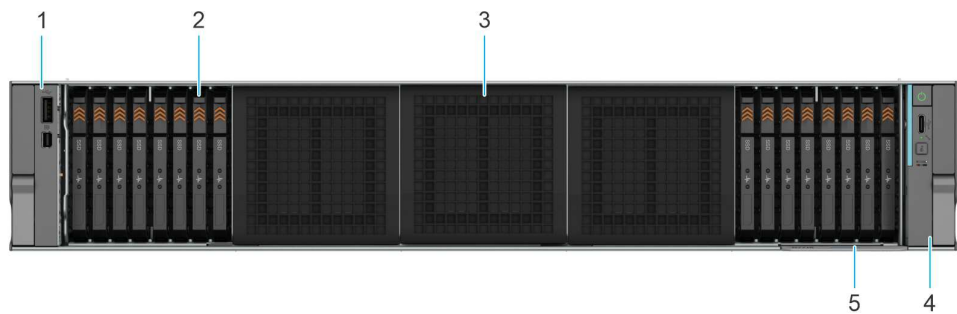


Ilustración 8. Vista frontal de 16 x EDSFF E3. Sistema de unidades S NVMe (pasillo caliente)

Tabla 10. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento	Puertos, paneles y ranuras	Icono	Descripción
1	Panel de control izquierdo (LCP): secundario	N/A	Contiene el puerto USB 2.0 Type-A (LCP opcional y KVM secundario) y el puerto Mini-DisplayPort (LCP opcional y KVM secundario). • Puerto USB 2.0 Type-A (LCP opcional y KVM secundario): este puerto es compatible con USB 2.0 y las funciones LCP opcional y KVM secundario.

Tabla 10. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema. (continuación)

Elemento	Puertos, paneles y ranuras	Icono	Descripción
			Mini DisplayPort: permite conectar un dispositivo de visualización al sistema. NOTA: Utilice un cable Mini DisplayPort a DisplayPort certificado que cumpla con los estándares VESA DisplayPort para la salida de video con un monitor. NOTA: No se recomiendan adaptadores Mini DisplayPort a VGA o Mini DisplayPort a HDMI.
2	Unidades EDSFF E3.S	N/A	Permite instalar unidades compatibles en el sistema.
3	Unidad de relleno	De relleno	Panel de relleno para la ranura de unidad de almacenamiento
4	Panel de control derecho (RCP): principal	N/A	Contiene el LED de estado del sistema, el ID del sistema, el botón de encendido, el puerto USB Type-C y el LED de estado del host.
5	Etiqueta de servicio rápido	N/A	La etiqueta de servicio rápido es un panel de etiquetas deslizable hacia afuera que contiene información del sistema, como la etiqueta de servicio, la NIC, la dirección MAC, etc. Si ha optado por el acceso predeterminado seguro a iDRAC, la etiqueta de servicio rápido también contiene la contraseña predeterminada segura de iDRAC.

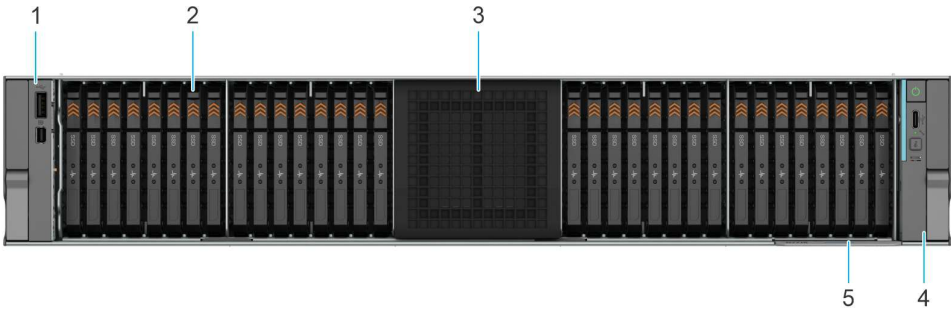


Ilustración 9. Vista frontal de 32 x EDSFF E3. Sistema de unidades S NVMe (pasillo caliente)

Tabla 11. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento	Puertos, paneles y ranuras	Icono	Descripción
1	Panel de control izquierdo (LCP): secundario	N/A	Contiene el puerto USB 2.0 Type-A (LCP opcional y KVM secundario) y el puerto Mini-DisplayPort (LCP opcional y KVM secundario). • Puerto USB 2.0 Type-A (LCP opcional y KVM secundario): este puerto es compatible con USB 2.0 y las funciones LCP opcional y KVM secundario. • Mini DisplayPort: permite conectar un dispositivo de visualización al sistema. NOTA: Utilice un cable Mini DisplayPort a DisplayPort certificado que cumpla con los estándares VESA DisplayPort para la salida de video con un monitor. NOTA: No se recomiendan adaptadores Mini DisplayPort a VGA o Mini DisplayPort a HDMI.
2	Unidades EDSFF E3.S	N/A	Permite instalar unidades compatibles en el sistema.
3	Unidad de relleno	De relleno	Panel de relleno para la ranura de unidad de almacenamiento
4	Panel de control derecho (RCP): principal	N/A	Contiene el LED de estado del sistema, el ID del sistema, el botón de encendido, el puerto USB Type-C y el LED de estado del host.
5	Etiqueta de servicio rápido	N/A	La etiqueta de servicio rápido es un panel de etiquetas deslizable hacia afuera que contiene información del sistema, como la etiqueta de servicio, la NIC, la dirección MAC, etc. Si ha optado por el acceso predeterminado seguro a iDRAC, la etiqueta de servicio rápido también contiene la contraseña predeterminada segura de iDRAC.

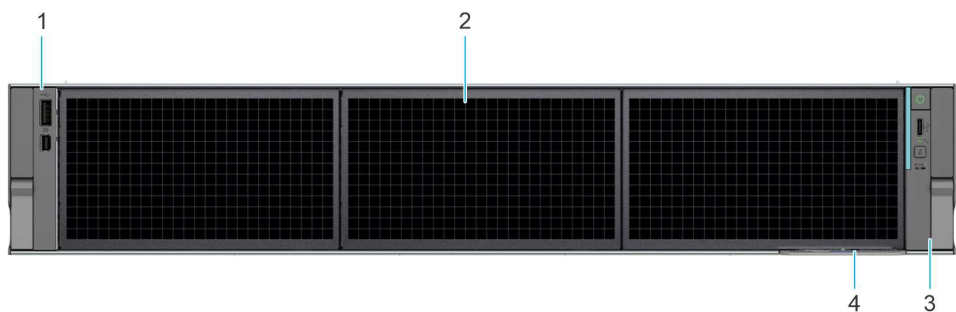


Ilustración 10. Vista frontal del sistema de configuración sin backplane

Tabla 12. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema.

Elemento	Puertos, paneles y ranuras	Icono	Descripción
1	Panel de control izquierdo (LCP): secundario	N/A	Contiene el puerto USB 2.0 Type-A (LCP opcional y KVM secundario) y el puerto Mini-DisplayPort (LCP opcional y KVM secundario). - Puerto USB 2.0 Type-A (LCP opcional y KVM secundario): este puerto es compatible con USB 2.0 y las funciones LCP opcional y KVM secundario. - Mini DisplayPort: permite conectar un dispositivo de visualización al sistema. NOTA: Utilice un cable Mini DisplayPort a DisplayPort certificado que cumpla con los estándares VESA DisplayPort para la salida de video con un monitor. NOTA: No se recomiendan adaptadores Mini DisplayPort a VGA o Mini DisplayPort a HDMI.
2	Unidad de relleno	De relleno	Panel de relleno para la ranura de unidad de almacenamiento
3	Panel de control derecho (RCP): principal	N/A	Contiene el LED de estado del sistema, el ID del sistema, el botón de encendido, el puerto USB Type-C y el LED de estado del host.
4	Etiqueta de servicio rápido	N/A	La etiqueta de servicio rápido es un panel de etiquetas deslizable hacia afuera que contiene información del sistema, como la etiqueta de servicio, la NIC, la dirección MAC, etc.

Tabla 12. En la tabla, se muestra la lista de componentes en la vista frontal del sistema. (continuación)

Elemento	Puertos, paneles y ranuras	Icono	Descripción
			Si ha optado por el acceso predeterminado seguro a iDRAC, la etiqueta de servicio rápido también contiene la contraseña predeterminada segura de iDRAC.

Panel de control izquierdo (LCP), vista secundaria

El sistema R570 tiene tres opciones para el panel de control izquierdo (LCP) y el panel secundario, como se muestra a continuación. La opción predeterminada es la de relleno.



Ilustración 11. Panel de control izquierdo (LCP), panel secundario, módulo de relleno

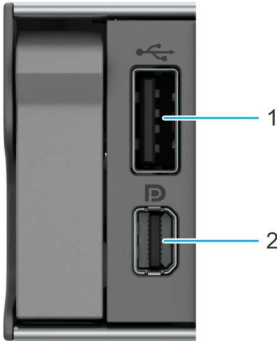


Ilustración 12. Panel de control izquierdo (LCP), panel secundario, módulo KVM

Tabla 13. Panel de control izquierdo (LCP) - Panel secundario - Módulo KVM (opcional)

Elemento	Indicador, botón o conector	Icono	Descripción
1	Puerto compatible con USB 2.0		El puerto USB es de 4 clavijas y cumple con los requisitos del estándar 2.0. Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.
2	Mini-DisplayPort		Permite conectar un dispositivo de visualización al sistema.

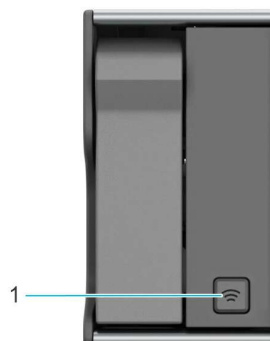


Ilustración 13. Panel de control izquierdo (LCP) - Panel secundario - Quick Sync 2.0 (opcional)

1. Botón de Quick Sync 2.0

Panel de control derecho (RCP): vista principal

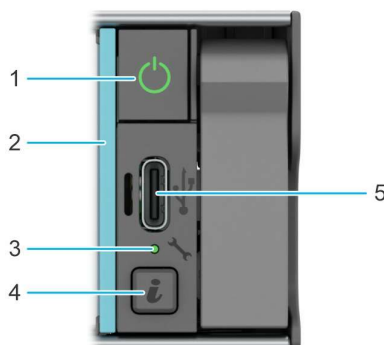


Ilustración 14. Panel de control derecho (RCP): principal

Tabla 14. Panel de control derecho (RCP): principal

Elemento	Indicador o botón	Icono	Descripción
1	Botón de encendido		Indica si el sistema está encendido o apagado. Presione el botón de encendido para encender o apagar el sistema manualmente. NOTA: Presione el botón de encendido para realizar un apagado ordenado de un sistema operativo que cumple con los requisitos de ACPI.
2	Indicador de estado e ID del sistema	N/D	Indica el estado del sistema.
3	Indicador LED de iDRAC Direct		El indicador LED de iDRAC Direct se ilumina para indicar que el puerto de iDRAC Direct está conectado activamente a un dispositivo.
4	Botón de ID del sistema		El ID del sistema permite que el usuario localice físicamente el sistema.
5	Puerto de host/iDRAC Direct (USB Type-C)		El puerto de iDRAC Direct (USB Type-C) le permite acceder a las funciones de USB Type-C de iDRAC Direct. Para obtener más información, consulte los manuales de iDRAC . NOTA: Puede configurar iDRAC Direct mediante un cable USB a USB Type-C, que puede conectar a su laptop o tableta. La longitud del cable no debe superar los 0,91 metros (3 pies). El rendimiento podría verse afectado por la calidad de los cables.

Tabla 15. Códigos indicadores de ID y estado del sistema

Código indicador de ID y estado del sistema	Condición
Azul fijo	Indica que el sistema está encendido y en buen estado, y el modo de ID del sistema no está activo. Presione el botón de ID del sistema para cambiar al modo de ID del sistema.
Azul parpadeante	Indica que el modo de ID del sistema está activo. Presione el botón de ID del sistema para cambiar al modo de estado del sistema.
Luz amarilla parpadeante	Indica que el sistema tiene una falla. Consulte el registro de eventos del sistema para ver los mensajes de error específicos. Manuales de PowerEdge .

Configuraciones del sistema: vista posterior del sistema PowerEdge R570

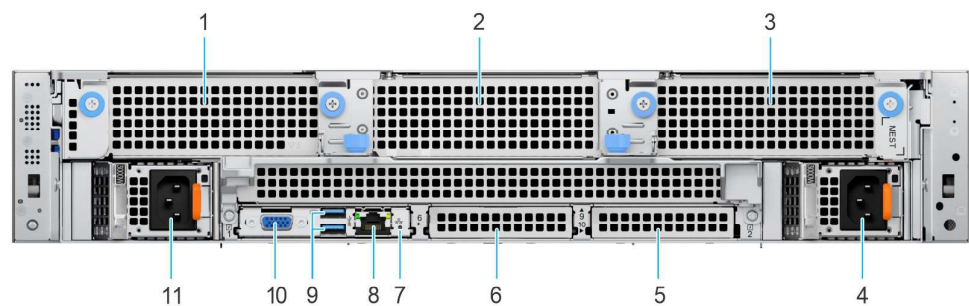


Ilustración 15. Vista posterior del sistema con configuración de I/O frontal

Tabla 16. Vista posterior del sistema con configuración de I/O frontal

Elemento	Puertos, paneles o ranuras	Icono	Descripción
1	Soporte vertical para tarjetas de expansión PCIe 1 de relleno	N/A	En la configuración de I/O frontal, la tarjeta elevadora de relleno se instala en la bahía de tarjetas elevadoras para tarjetas de expansión.
2	Soporte vertical para tarjetas de expansión PCIe 3 de relleno	N/A	
3	Soporte vertical para tarjetas de expansión PCIe 5 de relleno	N/A	
4	Fuente de alimentación (PSU2)	 2	PSU2 es la PSU secundaria del sistema.
5	Soporte de relleno de tarjeta NIC de OCP	N/A	En la configuración de I/O frontal, se instala un soporte de relleno de OCP en la bahía de tarjetas NIC de OCP.
6	Soporte de relleno de BOSS	N/A	En la configuración de I/O frontal, el soporte de relleno de BOSS se instala en la bahía de BOSS-N1 DC-MHS.
7	Puerto dedicado de iDRAC		Le permite acceder remotamente a iDRAC. Cuando el puerto de iDRAC frontal se conecta a la red, el puerto de iDRAC posterior se desactiva automáticamente.
8	Puerto USB 3.0		El puerto USB es de 9 pines y cumple con los requisitos del estándar 3.0. Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.
9	Puerto VGA		Permite conectar un dispositivo de visualización al sistema.

Tabla 16. Vista posterior del sistema con configuración de I/O frontal (continuación)

Elemento	Puertos, paneles o ranuras	Icono	Descripción
10	Fuente de alimentación (PSU1)	 1	PSU1 es la PSU principal del sistema.

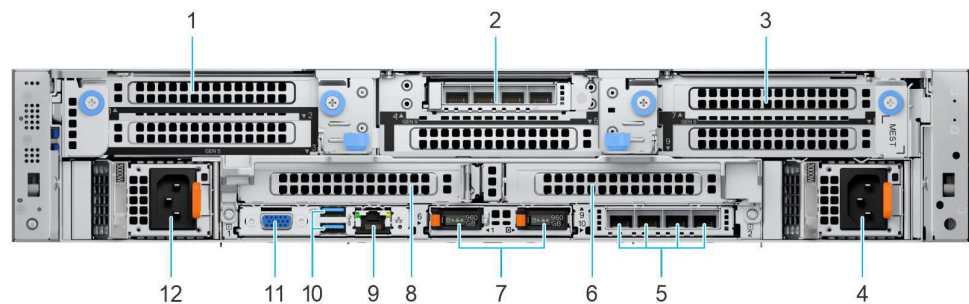


Ilustración 16. Vista posterior del sistema con configuración de I/O posterior

Tabla 17. Vista posterior del sistema con configuración de I/O posterior

artículos	Puertos, paneles o ranuras	Icono	Descripción
1	Tarjeta elevadora de tarjeta de expansión PCIe 1	N/A	La tarjeta elevadora para tarjetas de expansión permite conectar tarjetas de expansión PCI Express.
2	Tarjeta elevadora de tarjeta de expansión PCIe 3	N/A	La tarjeta elevadora para tarjetas de expansión permite conectar tarjetas de expansión PCI Express.
3	Tarjeta elevadora de tarjeta de expansión PCIe 5	N/A	La tarjeta elevadora para tarjetas de expansión permite conectar tarjetas de expansión PCI Express.
4	Fuente de alimentación (PSU2)	 2	PSU2 es la PSU secundaria del sistema.
5	Tarjeta OCP NIC	N/A	La tarjeta OCP NIC es compatible con OCP 3.0. Los puertos de NIC están integrados en la tarjeta de OCP, que está conectada a la tarjeta madre y también soporta la característica de NIC compartida de iDRAC.
6	Tarjeta elevadora de tarjeta de expansión PCIe 4	N/A	La tarjeta elevadora para tarjetas de expansión permite conectar tarjetas de expansión PCI Express.
7	Módulo BOSS-N1 DC-MHS	N/A	Módulo BOSS para el arranque interno del sistema.
8	Tarjeta elevadora de tarjeta de expansión PCIe 2	N/A	La tarjeta elevadora para tarjetas de expansión permite conectar tarjetas de expansión PCI Express.
9	Puerto dedicado de iDRAC		Le permite acceder remotamente a iDRAC. Cuando el puerto de iDRAC frontal se

Tabla 17. Vista posterior del sistema con configuración de I/O posterior (continuación)

artículos	Puertos, paneles o ranuras	Icono	Descripción
			conecta a la red, el puerto de iDRAC posterior se desactiva automáticamente.
10	Puerto USB 3.0		El puerto USB es de 9 pines y cumple con los requisitos del estándar 3.0. Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.
11	Puerto VGA		Permite conectar un dispositivo de visualización al sistema.
12	Fuente de alimentación (PSU1)		PSU1 es la PSU principal del sistema.

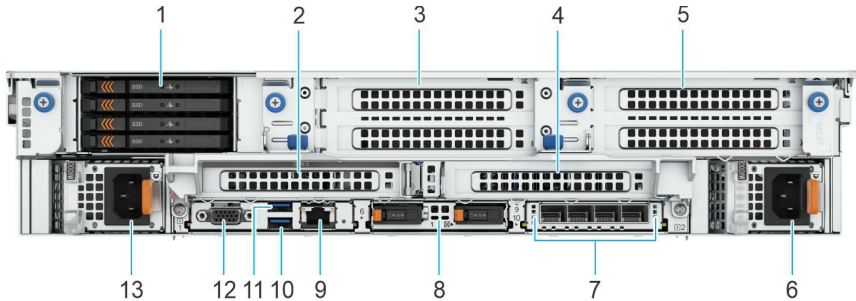


Ilustración 17. Vista posterior del sistema con unidades NVMe EDSFF E3.S posteriores

Tabla 18. Vista posterior del sistema con unidades NVMe EDSFF E3.S posteriores

artículos	Puertos, paneles o ranuras	Icono	Descripción
1	Unidades EDSFF E3.S	N/A	Permite instalar unidades compatibles en el sistema.
2	Tarjeta elevadora de tarjeta de expansión PCIe 2	N/A	La tarjeta elevadora para tarjetas de expansión permite conectar tarjetas de expansión PCI Express.
3	Tarjeta elevadora de tarjeta de expansión PCIe 3	N/A	La tarjeta elevadora para tarjetas de expansión permite conectar tarjetas de expansión PCI Express.
4	Tarjeta elevadora de tarjeta de expansión PCIe 4	N/A	La tarjeta elevadora para tarjetas de expansión permite conectar tarjetas de expansión PCI Express.
5	Tarjeta elevadora de tarjeta de expansión PCIe 5	N/A	La tarjeta elevadora para tarjetas de expansión permite conectar tarjetas de expansión PCI Express.
6	Fuente de alimentación (PSU2)		PSU2 es la PSU secundaria del sistema.
7	Tarjeta OCP NIC	N/A	La tarjeta OCP NIC es compatible con OCP 3.0. Los puertos de NIC están integrados en la tarjeta de OCP, que está conectada a la tarjeta madre y

Tabla 18. Vista posterior del sistema con unidades NVMe EDSFF E3.S posteriores (continuación)

artículos	Puertos, paneles o ranuras	Icono	Descripción
			también soporta la característica de NIC compartida de iDRAC.
8	Módulo BOSS-N1 DC-MHS	N/A	Módulo BOSS para el arranque interno del sistema.
9	Puerto dedicado de iDRAC		Le permite acceder remotamente a iDRAC. Cuando el puerto de iDRAC frontal se conecta a la red, el puerto de iDRAC posterior se desactiva automáticamente.
10	Puerto USB 3.0		El puerto USB es de 9 pines y cumple con los requisitos del estándar 3.0. Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.
11	Puerto USB 3.0		El puerto USB es de 9 pines y cumple con los requisitos del estándar 3.0. Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.
12	Puerto VGA		Permite conectar un dispositivo de visualización al sistema.
13	Fuente de alimentación (PSU1)		PSU1 es la PSU principal del sistema.

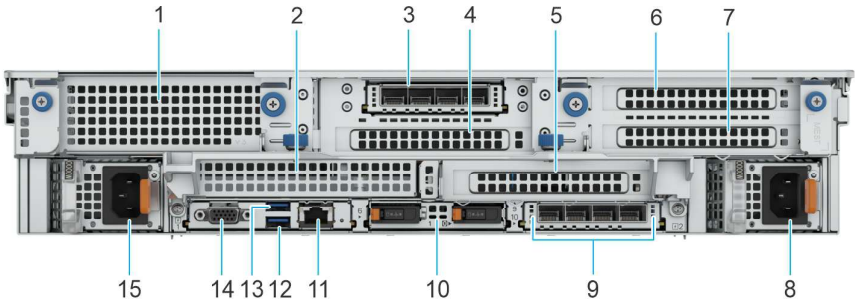


Ilustración 18. Vista posterior del sistema de configuración sin backplane

Tabla 19. Vista posterior del sistema de configuración sin backplane

artículos	Puertos, paneles o ranuras	Icono	Descripción
1	Soporte vertical para tarjetas de expansión PCIe 5 de relleno	N/A	Relleno para la ranura de tarjeta elevadora de expansión PCIe.
2	Soporte vertical para tarjetas de expansión PCIe 2 de relleno	N/A	Relleno para la ranura de tarjeta elevadora de expansión PCIe.
3	OCP de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansión PCIe	N/A	OCP de la tarjeta elevadora para tarjetas de expansión PCIe.
4	PCIe de relleno en el soporte vertical para tarjetas de expansión	N/A	PCIe de relleno en el soporte vertical para tarjetas de expansión
5	Tarjeta elevadora de tarjeta de expansión PCIe 4	N/A	La tarjeta elevadora para tarjetas de expansión permite

Tabla 19. Vista posterior del sistema de configuración sin backplane (continuación)

artículos	Puertos, paneles o ranuras	Icono	Descripción
			conectar tarjetas de expansión PCI Express.
6	Tarjeta elevadora de tarjeta de expansión PCIe 5	N/A	La tarjeta elevadora para tarjetas de expansión permite conectar tarjetas de expansión PCI Express.
7	PCIe de relleno en el soporte vertical para tarjetas de expansión	N/A	PCIe de relleno en el soporte vertical para tarjetas de expansión
8	Fuente de alimentación (PSU2)	 2	PSU2 es la PSU secundaria del sistema.
9	Tarjeta OCP NIC	N/A	La tarjeta OCP NIC es compatible con OCP 3.0. Los puertos de NIC están integrados en la tarjeta de OCP, que está conectada a la tarjeta madre y también soporta la característica de NIC compartida de iDRAC.
10	Módulo BOSS-N1 DC-MHS	N/A	Módulo BOSS para el arranque interno del sistema.
11	Puerto dedicado de iDRAC		Le permite acceder remotamente a iDRAC. Cuando el puerto de iDRAC frontal se conecta a la red, el puerto de iDRAC posterior se desactiva automáticamente.
12	Puerto USB 3.0		El puerto USB es de 9 pines y cumple con los requisitos del estándar 3.0. Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.
13	Puerto USB 3.0		El puerto USB es de 9 pines y cumple con los requisitos del estándar 3.0. Este puerto permite conectar dispositivos USB al sistema.
14	Puerto VGA		Permite conectar un dispositivo de visualización al sistema.
15	Fuente de alimentación (PSU1)	 1	PSU1 es la PSU principal del sistema.

Configuraciones del sistema: vista interior del PowerEdge R570 sistema

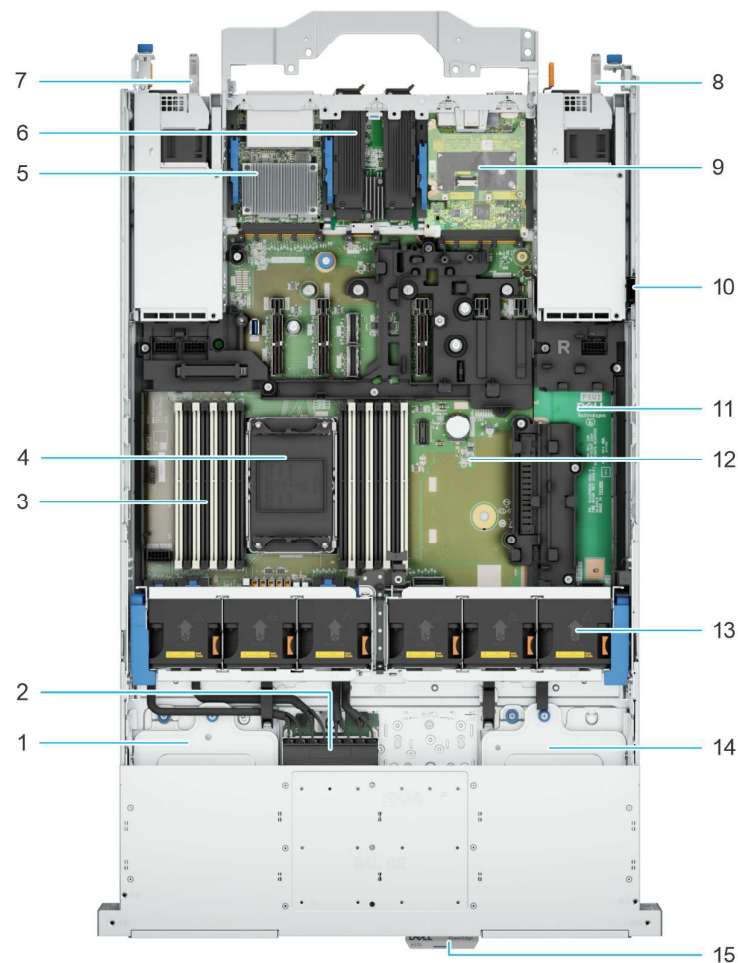


Ilustración 19. Interior del sistema

- | | |
|---|---|
| 1. OCP frontal o BOSS-N1 frontal | 2. Backplane de unidades |
| 3. Ranuras de DIMM | 4. Módulo del disipador de calor del procesador |
| 5. Tarjeta NIC OCP 3.0 | 6. Módulo BOSS-N1 DC-MHS |
| 7. PSU 2 | 8. PSU 1 |
| 9. Módulo DC-SCM | 10. Switch de intrusión |
| 11. Placa intercaladora de alimentación (PIB) | 12. Módulo de procesador de host (HPM) |
| 13. Ventiladores de enfriamiento | 14. OCP frontal |
| 15. Etiqueta de servicio rápido | |

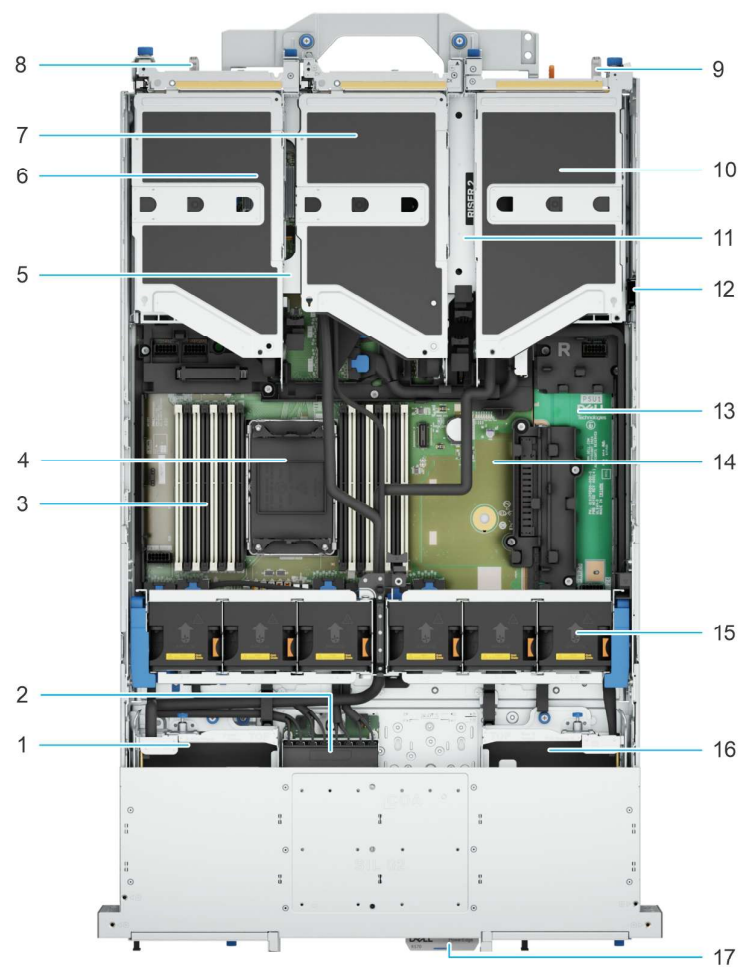


Ilustración 20. Interior del sistema con tarjetas elevadoras

- | | |
|---|---|
| 1. OCP frontal o BOSS-N1 frontal | 2. Backplane de unidades |
| 3. Ranuras de DIMM | 4. Módulo del disipador de calor del procesador |
| 5. Tarjeta elevadora 4 | 6. Tarjeta elevadora 5 |
| 7. Tarjeta elevadora 3 | 8. PSU 2 |
| 9. PSU 1 | 10. Tarjeta elevadora 1 |
| 11. Tarjeta elevadora 2 | 12. Switch de intrusión |
| 13. Placa intercaladora de alimentación (PIB) | 14. Módulo de procesador de host (HPM) |
| 15. Ventiladores de enfriamiento | 16. OCP frontal |
| 17. Etiqueta de servicio rápido | |

Código QR de los recursos del PowerEdge R570 sistema

Ilustración 21. Código QR para el sistema PowerEdge



R570

Configuraciones del chasis

El sistema PowerEdge™ R570 soporta lo siguiente:

Bahía frontal:

- Hasta 12 unidades RAID SATA de 3,5 pulgadas (HDD)
- Hasta 8 unidades RAID NVMe de 2,5 pulgadas
- Hasta 8 unidades de 2,5 pulgadas NVMe
- Hasta 8 unidades SATA de 2,5 pulgadas
- Hasta 8 unidades SATA/universales de 2,5 pulgadas
- Hasta 16 unidades SATA RAID de 2,5 pulgadas
- Hasta 24 unidades SATA de 2,5 pulgadas
- Hasta 8 EDSFF E3. Unidades NVMe de 5.ª generación S (corredor de aire caliente)
- Hasta 8 unidades EDSFF E3.S (pasillo frío) NVMe de 5.ª generación
- Hasta 16 unidades EDSFF E3.S (pasillo frío) NVMe de 5.ª generación
- Hasta 16 EDSFF E3. Unidades NVMe de 5.ª generación S (corredor de aire caliente)
- Hasta 32 EDSFF E3. Unidades NVMe de 5.ª generación S (corredor de aire caliente)

Bahía posterior:

- Hasta 4 unidades EDSFF E3.S NVMe de quinta generación

NOTA: Para obtener más información sobre cómo intercambiar en caliente el dispositivo U.2 SSD PCIe NVMe, consulte la *Guía del usuario de la SSD PCIe NVMe Express Flash de Dell* en **Buscar todos los productos > Infraestructura del centro de datos > Controladoras y adaptadores de almacenamiento > Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCIe SSD > Documentación > Manuales y documentos.**

Procesador

Temas:

- Características del procesador

Características del procesador

Los procesadores Intel® Xeon® serie 6 satisfacen diversas necesidades de potencia, rendimiento y eficiencia. Los núcleos eficientes (núcleos E) ofrecen una alta densidad de núcleos y un rendimiento excepcional por vatio, mientras que los núcleos de rendimiento (núcleos P) se destacan en la gama más amplia de cargas de trabajo con un mayor rendimiento para IA y HPC. Intel® Xeon® 6 ofrece un rendimiento mejorado por vatio, un rendimiento aumentado por rack, velocidades de memoria actualizadas, I/O mejoradas, velocidades de UPI ampliadas y seguridad de extensión de software adicional.

A continuación, se enumeran las características y funciones de los procesadores:

- Hasta 144 núcleos y TDP de hasta 330 W para el procesador Intel® Xeon® 6 E-core
- Hasta 86 núcleos y TDP de hasta 350 W para el procesador Intel® Xeon® 6 P-core
- Hasta 8 canales, DDR5 de 6400 MT/s (1 DPC) y 5200 MT/s (2 DPC)
- UPI 2.0: hasta 24 GT/s
- Hasta 88 canales PCIe 5.0
- R1S: hasta 136 canales PCIe 5.0
- Capacidad de bifurcación PCIe
- Conector Intel® E2: LGA 4710-2

Procesadores admitidos

En la tabla que se incluye a continuación, se muestran las SKU del Procesador Intel® Xeon® 6 E-core que soporta el sistema R570.

Tabla 20. Procesador Intel® Xeon® 6 E-core que soporta el sistema R570

Procesador	Velocidad de reloj (GHz)	Caché (M)	UPI (GT/s)	Núcleos	Subprocesos	Turbo	Velocidad de la memoria (MT/s)	Capacidad de memoria	TDP
6780E	2.2	108	24	144	144	Turbo	6400	1 TB	330 W
6766E	1.9	108	24	144	144	Turbo	6400	1 TB	250 W
6756E	1.8	96	24	128	128	Turbo	6400	1 TB	225 W
6746E	2	96	24	112	112	Turbo	6400	1 TB	250 W
6740E	2.4	96	24	96	96	Turbo	6400	1 TB	250 W
6731E	2.2	96	24	96	96	Turbo	5600	1 TB	250 W
6710E	2.4	96	24	64	64	Turbo	5600	1 TB	205 W

Tabla 21. Procesador Intel® Xeon® 6 P-core que soporta el sistema R570

Procesador	Velocidad de reloj (GHz)	Caché (M)	UPI (GT/s)	Núcleos	Subprocesos	Turbo	Velocidad de la memoria (MT/s)	Capacidad de memoria	TDP
6787P	2	336	24	86	172	Turbo	6400	4 TB	350 W

Tabla 21. Procesador Intel® Xeon® 6 P-core que soporta el sistema R570 (continuación)

Procesador	Velocidad de reloj (GHz)	Caché (M)	UPI (GT/s)	Núcleos	Subprocesos	Turbo	Velocidad de la memoria (MT/s)	Capacidad de memoria	TDP
6767P	2.4	336	24	64	128	Turbo	6400	4 TB	350 W
6747P	2.7	288	24	48	96	Turbo	6400	4 TB	330 W
6737P	2.9	144	24	32	64	Turbo	6400	4 TB	270 W
6730P	2.5	288	24	32	64	Turbo	6400	4 TB	250 W
6527P	3.0	144	24	24	48	Turbo	6400	4 TB	255 W
6724P	3.6	72	24	16	32	Turbo	6400	4 TB	210 W
6517P	3.2	72	24	16	32	Turbo	6400	4 TB	190 W
6505P	2.2	48	24	12	24	Turbo	6400	4 TB	150 W
6507P	3.5	48	24	8	16	Turbo	6400	4 TB	150 W
6781P [#]	2.0	336	N/D	80	160	Turbo	6400	2 TB	350 W
6761P [#]	2.5	336	N/D	64	128	Turbo	6400	2 TB	350 W
6741P [#]	2.5	288	N/D	48	96	Turbo	6400	2 TB	300 W
6731P [#]	2.5	144	N/D	32	64	Turbo	6400	2 TB	245 W
6521P [#]	2.6	144	N/D	24	48	Turbo	6400	2 TB	225 W
6511P [#]	2.5	72	N/D	16	32	Turbo	6400	2 TB	150 W

 **NOTA:** [#] indica la CPU R1S.

Subsistema de memoria

Temas:

- Memoria compatible
- Reglas de la memoria del sistema

Memoria compatible

Tabla 22. Comparación de la tecnología de la memoria

Funciones	PowerEdge R570 (DDR5)
Tipo de DIMM	RDIMM
Velocidad de transferencia	6400 MT/s (1 DPC) y 5200 MT/s (2 DPC) NOTA: Compatibilidad con la velocidad máxima de transferencia de DIMM que depende de la ocupación de DIMM y la SKU de CPU
Voltaje	1,1 V

Tabla 23. DIMM compatibles

Velocidad nominal de DIMM (MT/s)	Tipo de DIMM	Capacidad del módulo DIMM (GB)	Rangos por DIMM	Ancho de datos	Voltios por DIMM (V)
6400	RDIMM	16	1	x8	1.1
6400	RDIMM	32	2	x8	1.1
6400	RDIMM	64	2	x4	1.1
6400	RDIMM	96	2	x4	1.1
6400	RDIMM	128	2	x4	1.1
6400	RDIMM	256	8	x4	1.1

NOTA: El procesador puede reducir el cumplimiento de la velocidad de DIMM nominal.

Reglas de la memoria del sistema

El sistema PowerEdge R570 admite DIMM registrados DDR5 (RDIMM). La memoria del sistema contiene las instrucciones que inicia el procesador.

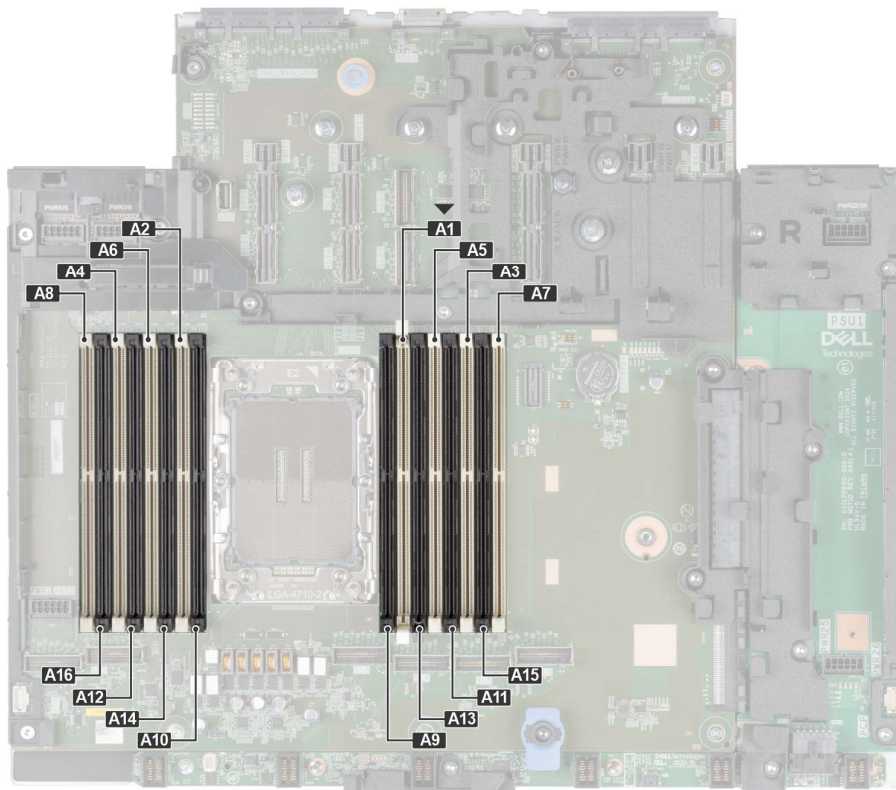


Ilustración 22. Canales de la memoria

Los canales de memoria se organizan de la manera siguiente:

Tabla 24. Canales de la memoria

Procesador	Canal A	Canal B	Canal C	Canal D	Canal E	Canal F	Canal G	Canal H
Procesador 1	Ranuras A1 y A9	Ranuras A5 y A13	Ranuras A3 y A11	Ranuras A7 y A15	Ranuras A2 y A10	Ranuras A6 y A14	Ranuras A4 y A12	Ranuras A8 y A16

Tabla 25. Matriz de memoria compatible

Tipo de DIMM	Rango	Capacidad	Velocidad y voltaje nominal de DIMM	Velocidad de funcionamiento			
				Procesador Intel® Xeon® 6 E-core		Procesador Intel® Xeon® 6 P-core	
				1 DIMM por canal (DPC)	2 DIMM por canal (DPC)	1 DIMM por canal (DPC)	2 DIMM por canal (DPC)
RDIMM	1R	16 GB	DDR5 (1,1 V), 6400 MT/s	N/A	N/A	Hasta 6400 MT/s	N/A
	2 R	32 GB	DDR5 (1,1 V), 6400 MT/s	Hasta 6400 MT/s	N/A	Hasta 6400 MT/s	Hasta 5200 MT/s
		64 GB	DDR5 (1,1 V), 6400 MT/s	Hasta 6400 MT/s	Hasta 5200 MT/s	Hasta 6400 MT/s	Hasta 5200 MT/s
		96 GB	DDR5 (1,1 V), 6400 MT/s	N/A	N/A	Hasta 6400 MT/s	Hasta 5200 MT/s
		128 GB	DDR5 (1,1 V), 6400 MT/s	N/A	N/A	Hasta 6400 MT/s	Hasta 5200 MT/s
	8 R	256 GB	DDR5 (1,1 V), 6400 MT/s	N/A	N/A	N/A	Hasta 5200 MT/s

NOTA: El procesador puede reducir el cumplimiento de la velocidad de DIMM nominal.

NOTA: Compatibilidad con la velocidad máxima de transferencia de DIMM que depende de la ocupación de DIMM y SKU de CPU.

Tabla 26. Guía de replicación de memoria para Intel® Xeon® 6 E-core

Capacidad DIMM	1 DIMM	4 DIMMS	8 DIMM (1DPC)	12 DIMM	16 DIMM (2DPC)
32 GB RDIMM	Sí	N/A	Sí	N/A	N/A
RDIMM de 64 GB	N/D	N/D	Sí	N/A	Sí

Tabla 27. Guía de replicación de memoria para Intel® Xeon® 6 P-core

Capacidad DIMM	1 DIMM	4 DIMMS	8 DIMM (1DPC)	12 DIMM	16 DIMM (2DPC)
RDIMM de 16 GB	Sí	N/A	Sí	N/A	N/A
32 GB RDIMM	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
RDIMM de 64 GB	N/D	Sí	Sí	N/A	Sí
RDIMM de 96 GB	N/D	N/D	Sí	N/A	Sí
RDIMM de 128 GB	N/D	N/D	Sí	N/A	Sí
RDIMM de 256 GB	N/D	N/D	N/D	N/D	Sí

Tabla 28. Requisito de capacidad de memoria para las tarjetas GPU compatibles

Rango recomendado de memoria del sistema (1,5x - 2x memoria de GPU)					
Nombre de la GPU	Memoria de GPU	GPU x1	2 GPU	GPU x3	GPU x4
L4	24 GB	36-48 GB	72-96 GB	108-144 GB	144-192 GB
L40S	48 GB	72-96 GB	144-192 GB	216-288 GB	N/A
H100NVL	94 GB	141-188 GB	282-376 GB	423-564 GB	N/A

NOTA: Siga la guía de replicación de memoria para replicar la memoria del sistema de manera adecuada con la capacidad correcta.

NOTA: La duplicación de memoria y el modo resistente a fallas (FRM) se admiten en la configuración de 8 o 16 DIMM por CPU.

NOTA: La configuración de un DIMM por CPU tiene características limitadas.

almacenamiento

Temas:

- [Controladoras de almacenamiento](#)
- [Unidades compatibles](#)
- [Configuración de almacenamiento interno](#)
- [Almacenamiento externo](#)

Controladoras de almacenamiento

Las opciones de controladoras RAID de Dell ofrecen mejoras de rendimiento, incluida la solución fPERC. fPERC proporciona una controladora RAID HW base que no consume una ranura PCIe mediante el uso de un factor de forma pequeño y un conector de alta densidad al plano de la base.

Las ofertas de controladora PERC de 17 G aprovechan enormemente la familia de PERC de 16 G. Los niveles de valor y rendimiento de valor se transferirán a la 17 G de la 16 G.

NOTA: PowerEdge no es compatible con el Trimodo, la combinación de SAS, SATA y NVMe detrás de la misma controladora.

NOTA: Para obtener más información sobre las características de las controladoras RAID Dell PowerEdge (PERC), las controladoras RAID de software o la tarjeta BOSS, y la implementación de las tarjetas, consulte la documentación de la controladora de almacenamiento en [Manuales de la controladora de almacenamiento](#).

Guía del usuario de las controladoras de almacenamiento del servidor

- Guías del usuario de las controladoras de almacenamiento del servidor, haga clic [aquí](#)

Unidades compatibles

En la tabla que se muestra a continuación, se enumeran las unidades internas compatibles con R570.

Tabla 29. Unidades compatibles

Factor de forma	Tipo	Velocidad	Velocidad de rotación	Capacidades
2,5 inches	SATA	6 Gb/s	SSD	480 GB, 960 GB, 1,92 TB, 3,84 TB
2,5 inches	NVMe de CC	4. ^a generación	SSD	800 GB, 960 GB, 1,6 TB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB, 7,68 TB
2,5 inches	Ent NVMe	4. ^a generación	SSD	1,6 TB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB, 7,68 TB, 15,36 TB, 61,44 TB
3,5 inch	SATA	6 Gb/s	7200	2 TB, 4 TB, 8 TB, 12 TB, 16 TB, 20 TB, 24 TB, 32 TB
3,5 inch	SATA	12 Gb/s	7200	4 TB, 8 TB, 12 TB, 16 TB, 20 TB, 24 TB, 32 TB
M.2	NVMe	4. ^a generación	N/A	480 GB. 960 GB
EDSFF E3. S	NVMe de CC	5. ^a generación	SSD	1,6 TB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB

Tabla 29. Unidades compatibles (continuación)

Factor de forma	Tipo	Velocidad	Velocidad de rotación	Capacidades
EDSFF E3. S	Ent NVMe	5. ^a generación	SSD	3,2 TB, 3,84 TB, 6,4 TB, 7,68 TB, 15,36 TB, 30,72 TB, 61,44 TB

NOTA: Las Ofertas planificadas están sujetas a cambios y es posible que no se publiquen como se diseñaron originalmente.

Unidades de disco duro (HDD)

Datos de HDD

Una unidad de disco duro (HDD) es un medio de almacenamiento que se caracteriza por un conjunto de platos giratorios con brazos para mover cabezales de grabación por las superficies a las ubicaciones adecuadas para leer y escribir los datos designados.



Ilustración 23. Unidad de disco duro

Los cabezales leen o escriben los datos y los transfieren a través de la interfaz al servidor. La interfaz para Dell HDD empresariales estándar puede ser Serial Attached SCSI (SAS) o Serial ATA (SATA) y afecta la velocidad a la que se transfieren los datos. Por lo general, SATA es de 6 gigabits por segundo, donde SAS es de 12 gigabits por segundo, por lo que el rendimiento de SAS puede ser dos veces el de SATA. Además, debido a que tiene mejor señal al ruido, SAS puede tener longitudes de cables más largas, lo que le permite conectarse al almacenamiento de datos externo. SAS también se considera un protocolo más sólido.

Por lo general, se utilizan discos duros empresariales con servidores de múltiples servidores que ejecutan software empresarial. Algunos ejemplos son bases de datos de procesamiento de transacciones, infraestructura de Internet (correo electrónico, servidor Web, comercio electrónico), software de computación científica y software de administración de almacenamiento nearline. Generalmente, las unidades empresariales funcionan continuamente ("24/7") en ambientes exigentes, a la vez que ofrecen el mayor rendimiento posible sin sacrificar la confiabilidad.

Los discos duros empresariales más rápidos giran a 10 000 y 15 000 RPM, y pueden lograr velocidades de transferencia de medios secuenciales por encima de 290 MB/s. Las unidades que se ejecutan a 10 000 o 15 000 RPM utilizan platos más pequeños para reducir los requisitos de alimentación y, por lo tanto, generalmente tienen una menor capacidad que las unidades de 7200 RPM de mayor capacidad. Las unidades de 10 000 y 15 000 están etiquetadas como cruciales o de rendimiento optimizado, mientras que las de 7200 se conocen como cruciales para el negocio o de capacidad optimizada. Dado que las unidades de 7200 giran a una velocidad más lenta, pueden tener platos y espacio más grandes para más platos en una carcasa de HDD. Esto permite unidades de mayor capacidad: 16 TB, 18 TB, etc.

Las velocidades de las tareas de lectura/escritura aleatorias generalmente se miden en IOPS (operaciones de entrada/salida por segundo) y las unidades de 15 000 pueden ser de hasta 290. Esto puede sonar como un gran número, pero es eclipsado por IOPS (en los cientos de miles) disponible en los discos SSD. El siguiente es un vínculo a un gráfico que muestra las características de rendimiento de HDD:

HDD_Characteristic_and_Metrics

Según el tipo de carga de trabajo, las funcionalidades del dispositivo de almacenamiento se priorizarán de manera diferente. A continuación, se describen varias funcionalidades y los medios que seleccionaría para cada una.

- Mejor rendimiento medido en IOPS: el rendimiento de almacenamiento para cargas de trabajo aleatorias se mide en IOPS. Cuando se solicite en términos de rendimiento general de IOPS, seleccione 15 000, a continuación, 10 000 y luego 7200, y dentro de esos HDD SAS, HDD SAS NL y HDD SATA.
- Mejor rendimiento medido en la productividad, o en gigabytes por segundo (GB/s): a menos que se trate de cargas de trabajo secuenciales intensas que se beneficiarían de la tecnología flash, los HDD son una buena opción para las cargas de trabajo secuenciales, como la visualización de medios o el registro de la base de datos. El almacenamiento en caché de NAND puede aumentar aún más el rendimiento del almacenamiento de HDD según sea necesario.
- Disminución de latencia: para las cargas de trabajo sensibles a la latencia, el almacenamiento interno en el servidor en sí suele tener menos latencia que el almacenamiento en arreglos externos, donde los tiempos de recuperación más prolongados en la red pueden aumentar en gran medida la latencia de almacenamiento existente. Es importante tener en cuenta que los discos SSD presentan una latencia mucho menor que las HDD mecánicas.
- Mayor capacidad: para cargas de trabajo impulsadas por la capacidad, como los archivos de correo electrónico, el respaldo basado en disco y las aplicaciones de almacenamiento de objetos, la alta IOPS o el rendimiento pueden ser menos que una prioridad en comparación con la capacidad. En este caso, elija unidades de disco duro de uso rentable, que pueden ofrecer la mayor capacidad al menor costo.

A pesar de que, por lo general, las HDD proporcionan un rendimiento más bajo y una mayor latencia que los discos SSD, aún son una excelente opción cuando se utiliza como parte de una estrategia de almacenamiento completa que balancea el costo por GB, la capacidad, las necesidades de las aplicaciones y el rendimiento.

Matriz de características de HDD

Tabla 30. Matriz de características de HDD

Tipo	Interfaz	Factor de forma	RPM	Seguridad	Capacidad	Descripción
HDD	SAS de 12 Gb/s	2.5	10K	ISE	2.4TB	SAS independiente de 10 000 RPM de 2,4 TB
HDD	SAS de 12 Gb/s	2.5	10K	FIPS	2.4TB	SAS independiente de 10 000 RPM y de 2,4 TB
HDD	SAS de 12 Gb/s	2.5	10K	ISE	1.2TB	SAS independiente de 10 000 RPM de 1,2 TB
HDD	SAS de 12 Gb/s	2.5	10K	ISE	600GB	SAS independiente de 10 000 RPM de 600 GB
HDD	SATA de 6 Gbps	3.5	7.2K	ISE	24TB	SATA independiente de 7200 RPM y de 24 TB
HDD	SATA de 6 Gbps	3.5	7.2K	ISE	20TB	SATA independiente de 7200 RPM y de 20 TB
HDD	SATA de 6 Gbps	3.5	7.2K	ISE	16TB	SATA independiente de 7200 RPM y de 16 TB
HDD	SAS de 12 Gb/s	3.5	7.2K	FIPS	16TB	FIPS SAS independiente de 7200 RPM y de 16 TB
HDD	SATA de 6 Gbps	3.5	7.2K	ISE	12TB	SATA independiente de 7200 RPM y de 12 TB
HDD	SATA de 6 Gbps	3.5	7.2K	ISE	8TB	SATA independiente de 7200 RPM y de 8 TB
HDD	SAS de 12 Gb/s	3.5	7.2K	FIPS	8TB	FIPS SAS independiente de 7200 RPM y de 8 TB
HDD	SATA de 6 Gbps	3.5	7.2K	ISE	4TB	SATA independiente de 7200 RPM y de 4 TB

Tabla 30. Matriz de características de HDD (continuación)

Tipo	Interfaz	Factor de forma	RPM	Seguridad	Capacidad	Descripción
HDD	SATA de 6 Gbps	3.5	7.2K	ISE	2TB	SATA independiente de 7200 RPM y de 2 TB
HDD	SAS de 12 Gb/s	3.5	7.2K	ISE	24TB	SAS independiente de 7200 RPM y de 24 TB
HDD	SAS de 12 Gb/s	3.5	7.2K	ISE	20TB	SAS independiente de 7200 RPM y de 20 TB
HDD	SAS de 12 Gb/s	3.5	7.2K	ISE	16TB	SAS independiente de 7200 RPM y de 16 TB
HDD	SAS de 12 Gb/s	3.5	7.2K	ISE	12TB	SAS independiente de 7200 RPM y de 12 TB
HDD	SAS de 12 Gb/s	3.5	7.2K	ISE	8TB	SAS independiente de 7200 RPM y de 8 TB
HDD	SAS de 12 Gb/s	3.5	7.2K	ISE	4TB	SAS independiente de 7200 RPM y de 4 TB

 **NOTA:** Las Ofertas planificadas están sujetas a cambios y es posible que no se publiquen como se diseñaron originalmente.

Este documento se actualiza a medida que se producen cambios; por lo que, para mantenerse al tanto de la información más reciente, debe asegurarse de guardarlo como marcador, en lugar de descargar una copia, o consulte [Matriz de plataforma y unidad](#).

Configuración de almacenamiento interno

Opciones de configuración de almacenamiento interno disponibles de R570:

- 12 RAID SAS (HDD) de 3,5 pulgadas + 4 unidades NVMe EDSFF E3.S de 5.ª generación
- 8 unidades RAID NVMe (SSD) de 2,5 pulgadas
- 8 unidades NVMe (SSD) de 2,5 pulgadas
- 8 unidades (HDD/SSD) SAS/SATA de 2,5 pulgadas
- 16 unidades RAID SAS/SATA de 2,5 pulgadas (HDD/SSD)
- 8 unidades EDSFF E3.S (pasillo frío) NVMe de 5.ª generación

Almacenamiento externo

El sistema R570 admite los tipos de dispositivos de almacenamiento externo que se indican en la tabla que se incluye a continuación.

Tabla 31. Dispositivos de almacenamiento externo admitidos

Tipo de dispositivo	Descripción
Cinta externa	Compatible con la conexión a productos de cinta USB externos
Software de dispositivo NAS/IDM	Admite pila de software NAS
JBOD	Es compatible con la conexión a JBOD serie MD de 12 Gb.

Temas:

- Descripción general
- Soporte de OCP 3.0

Descripción general

PowerEdge ofrece una amplia variedad de opciones para obtener información que se desplaza hacia y desde nuestros servidores. Se eligen las mejores tecnologías de la industria, y estos adaptadores se validan con rigurosidad para un uso totalmente soportado y sin preocupaciones en los servidores Dell.

Soporte de OCP 3.0

Tarjetas de OCP admitidas

Tabla 32. Tarjetas de OCP admitidas

Factor de forma	Tipo de puerto	Velocidad del puerto	Conteo de puertos
OCP 3.0	QSFP56	100 GbE	2
	QSFP56	100 GbE	2
	SFP28	25 GbE	4
	SFP28	25 GbE	2
	QSFP56	100 GbE	2
	BT	1 GbE	4
	BT	10 GbE	4
	BT	10 GbE	2
	SFP28	25 GbE	4
	SFP28	25 GbE	4
	QSFP56	100 GbE	2
	BT	10 GbE	2
	BT	10 GbE	2
	SFP28	25 GbE	2
	BT	1 GbE	2

NIC del OCP 3.0 frente a 2.0

Tabla 33. Comparación entre la NIC del OCP 3.0 y 2.0

Factor de forma	OCP 2.0 (tarjeta intermedia LOM)	OCP 3.0	Notas
Generación de PCIe	Gen3	Gen5	Las OCP3 compatibles son SFF (factor de forma pequeño).
Canales máximos de PCIe	Hasta x16	Hasta x16	Consulte la matriz de prioridad de las ranuras del servidor.
LOM compartida	Sí	Sí	Solo OCP en la ranura 10 (I/O posterior) puede admitir la redirección de puertos de iDRAC como NIC compartida.
Alimentación AUX	Sí	Sí	Se utiliza para LOM compartida

Factores de forma de OCP

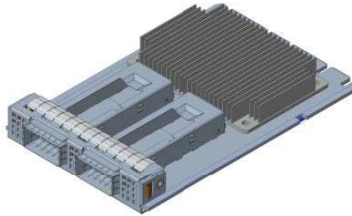


Ilustración 24. Factor de forma de tarjeta pequeña de OCP 3.0 (LS)

Para obtener más información sobre el proceso de instalación de la tarjeta OCP, consulte el manual de instalación y servicio de R570 en el sitio de soporte de Dell.

Subsistema PCIe

Temas:

- Tarjetas elevadoras PCIe

Tarjetas elevadoras PCIe

A continuación, se muestran las ofertas de tarjetas elevadoras para la plataforma. .

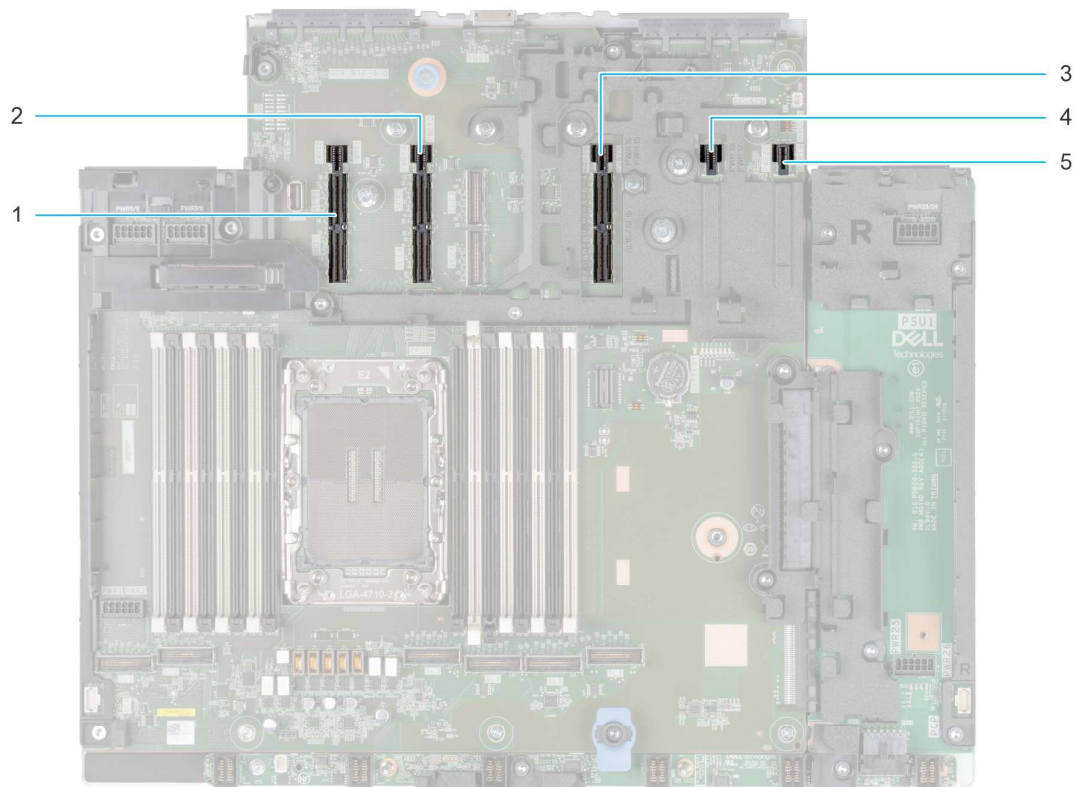


Ilustración 25. Ubicación de conectores de tarjeta elevadora en la placa de HPM

1. Tarjeta elevadora 5
2. Tarjeta elevadora 4
3. Tarjeta elevadora 3
4. Conector de alimentación de tarjeta elevadora
5. Conector de alimentación de tarjeta elevadora

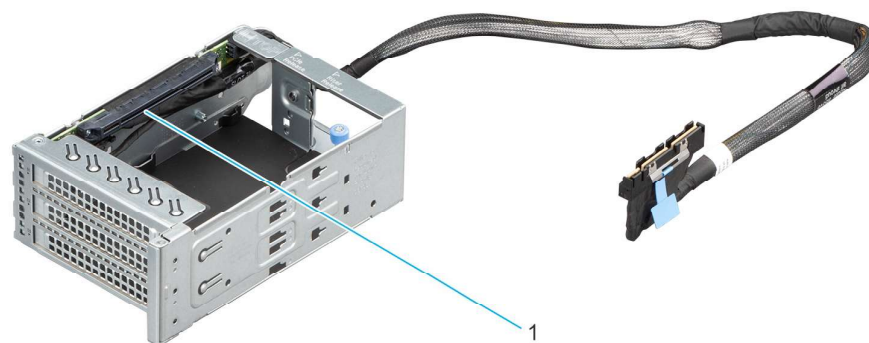


Ilustración 26. Tarjeta elevadora RF1

1. Ranura 31



Ilustración 27. Tarjeta elevadora RF2

1. Ranura 34

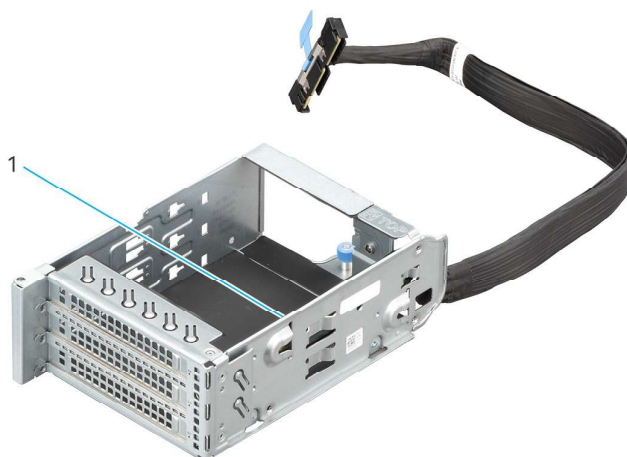


Ilustración 28. Tarjeta elevadora RF3

1. Ranura 36

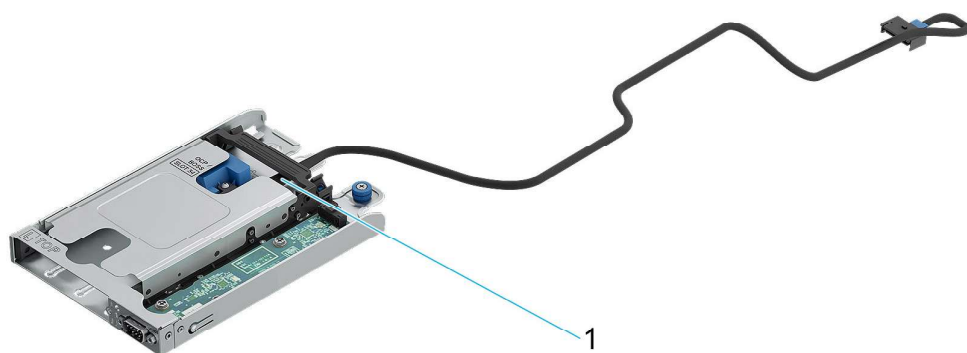


Ilustración 29. Tarjeta elevadora RF4

1. Ranura 38

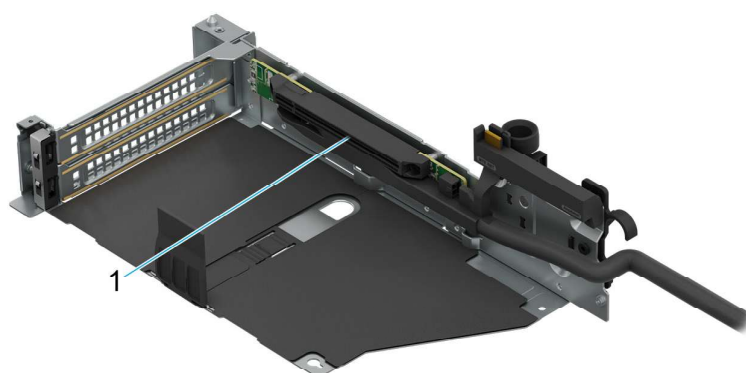


Ilustración 30. Tarjeta elevadora R1

1. Ranura 2

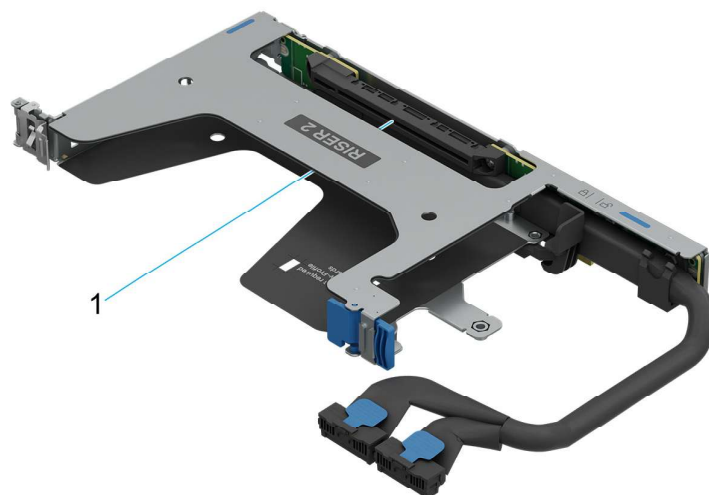


Ilustración 31. Tarjeta elevadora R2

1. Ranura 3

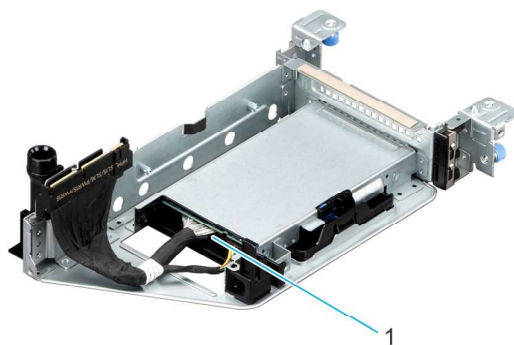


Ilustración 32. Tarjeta elevadora R3

1. Ranura 4

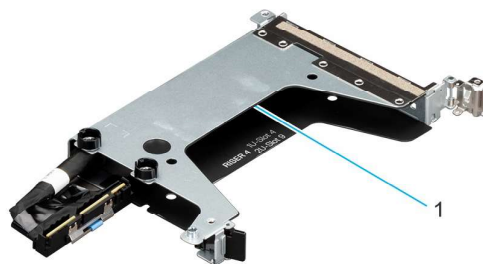


Ilustración 33. Tarjeta elevadora R4

1. Ranura 9

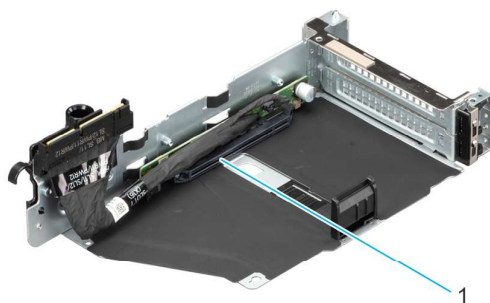


Ilustración 34. Tarjeta elevadora R5

1. Ranura 7

Tabla 34. Configuraciones de tarjeta elevadora PCIe

N.º de configuración	Configuración de tarjeta elevadora	N.º de procesadores	Tipo de PERC compatible	Almacenamiento posterior posible
RC 0	SIN RSR	1	PERC frontal	No
RC 1	R1x+R2t+R3e+R4b+R5b	1	PERC frontal	No
RC 2	RF2a + RF4b	1	N/D	No
RC 3	RF1a + RF3c	1	N/D	No
RC 4	RF1a + RF2a + RF3d + RF4a	1	N/D	No
RC 5	R3f + R4b + R5b	1	PERC frontal	No
RC 6	R1x + R3b + R4b + R5b	1	N/D	No
RC 7	R3f + R4b + R5b	1	Adaptador de PERC	Sí
RC 8	RF1a+RF4c+R1x+R3b+R5b	1	N/D	No
RC 9	R4b + R5b	1	PERC frontal	No
RC 10	R2t + R3e + R4b + R5b	1	Adaptador de PERC	No
RC 11	R3e + R4b + R5b	1	N/D	No

NOTA: Pautas de compatibilidad con soporte vertical

- Los procesadores Intel Xeon R1S de núcleo P de 6 procesadores proporcionan una mayor cantidad de carriles PCIe en comparación con los procesadores Intel® Xeon de núcleo P de 6 procesadores estándares.
- En la plataforma PowerEdge R570:
 - Las tarjetas elevadoras RC1, RC4, RC6, RC8, RC10 y RC11 solo admiten procesadores R1S.
 - Las tarjetas elevadoras RC2 y RC9 son compatibles con las configuraciones de R1S y estándar de un solo procesador, según los requisitos de configuración de almacenamiento.
- La compatibilidad de las tarjetas verticales está sujeta al diseño específico de la plataforma y a las restricciones de asignación de carriles.
- Seleccione configuraciones de almacenamiento compatibles para garantizar la integridad del sistema y un rendimiento óptimo.

Especificaciones térmicas, acústicas y de alimentación

Los servidores PowerEdge tienen una amplia recopilación de sensores que realizan un seguimiento automático de la actividad térmica, lo que ayuda a regular la temperatura, reduce el ruido del servidor y disminuye el consumo de energía. En la tabla a continuación, se enumeran las herramientas y tecnologías que Dell ofrece para reducir el consumo de energía y aumentar la eficiencia energética:

Temas:

- [Alimentación](#)
- [Térmico](#)
- [Acústica](#)

Alimentación

Tabla 35. Herramientas y tecnologías de alimentación

Característica	Descripción
Portafolio de fuentes de alimentación (PSU)	El portafolio de PSU de Dell incluye funciones inteligentes, como la optimización dinámica de la eficiencia mientras se mantienen la disponibilidad y la redundancia. Obtenga información adicional en la sección de fuentes de alimentación.
Herramientas para el dimensionamiento correcto	La Herramienta de planificación de infraestructura empresarial (EIPT) es una herramienta que puede ayudarlo a determinar la configuración de hardware más eficiente posible. Con el EIPT de Dell, puede calcular el consumo de energía del hardware, la infraestructura de alimentación y el almacenamiento para una carga de trabajo dada. Obtenga más información en Dell EIPT .
Cumplimiento de normas del sector	Los servidores de Dell están en conformidad con todas las certificaciones y directrices pertinentes del sector, incluidas 80 PLUS, Climate Savers y ENERGY STAR.
Precisión del monitoreo de la alimentación	Las mejoras de monitoreo de la alimentación para PSU incluyen: • La precisión del monitoreo de la alimentación del Dell es actualmente del 1 %, mientras que el estándar del sector es del 5 % • Informes de alimentación más precisos
Infraestructura de rack	Dell ofrece algunas de las soluciones de infraestructura de alimentación de mayor eficiencia del sector, incluidas las siguientes: • Unidades de distribución de energía (PDU) • Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) • Gabinets de racks de contención de consumo de energía inteligente • Conectores de acoplamiento ciego de CA Obtenga información adicional en: Alimentación y enfriamiento .

Fuentes de alimentación

Las fuentes de alimentación Energy Smart tienen funciones inteligentes, como la capacidad de optimizar dinámicamente la eficiencia mientras conservan la disponibilidad y la redundancia. También incluyen tecnologías mejoradas de reducción de consumo de energía, como la conversión de alimentación de alta eficiencia, las técnicas avanzadas de administración térmica y las funciones de administración de energía integradas, incluido el monitoreo de alimentación de alta precisión. En la tabla a continuación, se muestran las opciones de fuente de alimentación disponibles para R570.

Tabla 36. Especificaciones de PSU

PSU	Clas e	Disipaci ón de calor (máxima) BTU/h	Frecuenc ia (Hz)	Voltaje de AC			Voltaje de DC			Corriente (A)
				De 200 a 240 V	De 100 a 120 V	277 V	240 V	- (48-60) V	336 V	
Modo mixto de 800 W	Platini um	3000	50/60	800 W	800 W	N/D	N/D	N/D	N/D	9,2-4,5 A
	Titanium	3000	50/60	800 W	800 W	N/D	N/D	N/D	N/D	9,2-4,5 A
	N/A	3000	N/D	N/D	N/D	N/D	800 W	N/D	N/D	3,7 A
1100 W	Titanium	4100	50/60	1100 W	1050 W	N/D	N/D	N/D	N/D	12-6,1 A
	Platini um	4100	50/60	1100 W	1050 W	N/D	N/D	N/D	N/D	12-6,1 A
	N/A	4100	N/D	N/D	N/D	N/D	1100 W	N/D	N/D	5,1 A
1400 W /-48 V CC	Titanium	5310	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	1400 W	N/D	33 A
1500 W 227 V CA	Titanium	5625	50/60	N/A	N/A	N/A	1500 W	N/D	N/D	6,1 A
	N/D	5625	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	1500 W	4,91 A
Modo mixto de 1500 W	Titanium	5625	50/60	1500 W	1050 W	N/D	N/D	N/D	N/D	12-8,2 A
	N/A	5625	N/D	N/D	N/D	N/D	1500 W	N/D	N/D	6,8 A
Modo mixto de 1800 W	Titanium	6750	50/60	1800 W	1050 W	N/D	N/D	N/D	N/D	9.8-8,2 A
	N/A	6750	N/D	N/D	N/D	N/D	1800 W	N/D	N/D	8,2 A



Ilustración 35. Cables de alimentación PSU

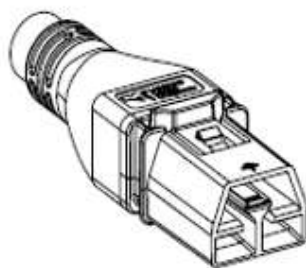


Ilustración 36. Cable de alimentación APP 2006G1



Ilustración 37. Cable de alimentación del APOWA048 LOTES

Tabla 37. Cables de alimentación PSU

Factor de forma	Mensaje de salida	Cable de alimentación
60 mm, redundante	Modo mixto de 800 W	C13
	Modo mixto de 1100 W	C13
	1400 W -48 V CC	LOTES APOWA048
	Modo mixto de 1500 W	C13
	1500 W/277 V	APP2006G1/2006G3
	Modo mixto de 1800 W	C13

Térmico

Los servidores PowerEdge tienen una amplia recopilación de sensores que rastrean automáticamente la actividad térmica, lo que ayuda a regular la temperatura, reduce el ruido del servidor y disminuye el consumo de energía.

Diseño térmico

La administración térmica de la plataforma ayuda a ofrecer un alto rendimiento con la cantidad adecuada de enfriamiento para los componentes, a la vez que se conservan las velocidades de ventiladores más bajas posibles. Esto se realiza en una amplia variedad de temperaturas ambientales, de 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F), y a rangos de temperatura ambiente amplios.

1. Reliability	• Component hardware reliability remains the top thermal priority. • System thermal architectures and thermal control algorithms are designed to ensure there are no tradeoffs in system level hardware life.
2. Performance	• Performance and uptime are maximized through the development of cooling solutions that meet the needs of even the densest of hardware configurations.
3. Efficiency	• 17G servers are designed with an efficient thermal solution to minimize power and airflow consumption, and/or acoustics for acoustical deployments. • Dell's advanced thermal control algorithms enable minimization of system fans speeds while meeting the above Reliability and Performance tenets.
4. Forward Compatibility	• Forward compatibility means that thermal controls and thermal architecture solutions are robust to scale to new components that historically would have otherwise required firmware updates to ensure proper cooling. • The frequency of required firmware updates is thus reduced.

Ilustración 38. Características del diseño térmico

El diseño térmico del PowerEdge R570 refleja lo siguiente:

- Diseño térmico optimizado: el diseño del sistema está creado para lograr un diseño térmico óptimo.
- El diseño y la ubicación de los componentes del sistema están diseñados para proporcionar una cobertura para flujo de aire máxima para componentes críticos, con el menor uso posible de alimentación del ventilador.

- Administración térmica integral: el sistema de control térmico regula la velocidad del ventilador, basándose en varias respuestas diferentes de sensores de temperatura de componentes de todo el sistema y en el inventario de configuraciones del sistema. El monitoreo de la temperatura incluye componentes como procesadores, DIMM, chipset, entorno de entrada de aire, unidades de disco duro y OCP.
- Control de velocidad del ventilador térmico de ciclo cerrado y abierto: el control térmico de ciclo abierto utiliza la configuración del sistema para determinar la velocidad del ventilador, basándose en la temperatura del entorno de entrada de aire. El método de control térmico de ciclo cerrado utiliza información de temperaturas para determinar dinámicamente las velocidades adecuadas del ventilador.
- Ajustes configurables por el usuario: entendiendo que cada cliente tiene circunstancias o expectativas únicas del sistema. Para obtener más información, consulte el Manual de instalación y servicio del Dell PowerEdge R570 en [Manuales de PowerEdge](#) y "Control térmico avanzado: optimización de los objetivos de alimentación y los entornos" en Dell.com.
- Redundancia de enfriamiento: el sistema R570 permite una redundancia de ventilador de N+1, lo cual da lugar a una operación continua con un error de ventilador en el sistema.
- Especificaciones de entorno: la administración térmica optimizada hace que el sistema R570 sea confiable en una amplia variedad de entornos operativos.

Acústica

Configuraciones acústicas de R570

Dell PowerEdge R570 es un servidor en rack con salida acústica que abarca desde niveles adecuados para un entorno de oficina hasta los que se encuentran en los centros de datos.

R570 está diseñado para usarse en un centro de datos, pero es posible que algunos usuarios prefieran usarlo en una configuración más silenciosa. Sin embargo, tenga en cuenta que, en la mayoría de los casos, la velocidad del operador de aire inactivo del sistema no se puede reducir sin cambiar la configuración del sistema y, en algunos casos, es posible que incluso un cambio en la configuración no reduzca las velocidades de transferencia de aire en estado inactivo.

Tabla 38. Configuraciones probadas para la experiencia acústica

Configuraciones	Configuración de gama baja con la experiencia acústica más silenciosa para la publicación	Configuración de GPU con la experiencia acústica operativa más silenciosa para la publicación	Típico: 1 (Unidades de 2,5") *	Típico: 1 (I/O frontal)	Típico: 1 (Unidades de 3,5")	Típico: 2 Con GPU
TDP de CPU	150 W	150 W	270 W	270 W	270 W	300 W
Cantidad de CPU	1	1	1	1	1	1
Memoria de RDIMM	32G DDR5	32G DDR5	32G DDR5	32G DDR5	32G DDR5	32G DDR5
Cantidad de memoria	1	16	16	16	16	16
Tipo de backplane	8 BP de 2,5"	8 E3.S (pasillo frío)	24 BP de 2,5"	8 E3.S (pasillo frío)	12 BP de 3,5" + BP posterior de 4 x E3.S	8 E3.S (pasillo frío)
Tipo de módulo HDD	Unidad de estado sólido (SSD) SATA	E3.S	Unidad de estado sólido (SSD) SATA	E3.S	HDD de 3,5 , E3.S	E3.S
Cantidad de HDD	8	8	16	8	12+4	8
Tipo de PSU	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W	1500 W
Cantidad de PSU	2	2	2	2	2	2
OCP	2 10G x1	2 10G x1	2 100G x1	2 100G x2	2 100G x1	2 100G x1
PCI 1	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
PCI 2	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	H100

Tabla 38. Configuraciones probadas para la experiencia acústica (continuación)

Configuraciones	Configuración de gama baja con la experiencia acústica más silenciosa para la publicación	Configuración de GPU con la experiencia acústica operativa más silenciosa para la publicación	Típico: 1 (Unidades de 2,5")*	Típico: 1 (I/O frontal)	Típico: 1 (Unidades de 3,5")	Típico: 2 Con GPU
PCI 3	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
PCI 4	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	H100
PCI 5	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
PCI 6	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
PCI 7	N/D	N/D	N/D	N/D	Adaptador H365	H100
PCI 31	N/D	L4	N/D	N/D	N/D	N/D
PERC frontal	H365 frontal	N/D	H365 frontal	N/D	N/D	N/D

Tabla 39. Experiencia acústica de las configuraciones de R570

Configuraciones		Configuració n de gama baja con la experiencia acústica más silenciosa para la publicación	Configuració n de GPU con la experiencia acústica operativa más silenciosa para la publicación	Típico: 1 (Unidades de 2,5")*	Típico: 1 (I/O frontal)	Típico: 1 (Unidades de 3,5")	Típico: 2 Con GPU
Rendimiento acústico: inactivo/en funcionamiento a 25 °C de temperatura ambiente							
L _{WA,m} (B)	Inactivo ⁽⁴⁾	5.5	6.6	6.7	6.1	6.5	6.8
	Operativo/ Operativo de uso del cliente ^{(5) (6)}	5.5	7.9	6.7	6.1	6.5	9.0
K _v (B)	Inactivo ⁽⁴⁾	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	Operativo/ Operativo de uso del cliente ^{(5) (6)}	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
L _{pA,m} (dB)	Inactivo ⁽⁴⁾	37	50	51	43	47	51
	Operativo/ Operativo de uso del cliente ^{(5) (6)}	37	66	51	43	7	75
Tonos discretos destacados ⁽³⁾		Relación de prominencia < 15 dB					Relación de prominencia < 19 dB
Rendimiento acústico: inactivo a 28 °C de temperatura ambiente							
L _{WA,m} ⁽¹⁾ (B)		6.0	6.8	7.3	6.3	7.6	71
K _v (B)		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
L _{pA,m} ⁽²⁾ (dB)		43	53	58	46	60	54
Rendimiento acústico: carga máx. a 35 °C de temperatura ambiente							
L _{WA,m} ⁽¹⁾ (B)		8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	9.0

Tabla 39. Experiencia acústica de las configuraciones de R570 (continuación)

Configuraciones	Configuración de gama baja con la experiencia acústica más silenciosa para la publicación	Configuración de GPU con la experiencia acústica operativa más silenciosa para la publicación	Típico: 1 (Unidades de 2,5")*	Típico: 1 (I/O frontal)	Típico: 1 (Unidades de 3,5")	Típico: 2 Con GPU
$K_v(B)$	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
$L_{pA,m}^{(2)}(dB)$	69	69	69	69	70	75

(1) L_wA , m: el nivel de potencia de sonido de ponderación A (L_wA) declarado se calcula según la sección 5.2 de ISO 9296 (2017) con los datos recopilados mediante los métodos que se describen en ISO 7779 (2010). Es posible que los datos de ingeniería que se presentan aquí no cumplan por completo con el requisito de declaración de ISO 7779.

(2) L_{pA} , m: el nivel de presión de sonido de emisión de ponderación A declarado es en la posición de transeúnte según la sección 5.3 de ISO 9296 (2017) y se mide mediante los métodos que se describen en ISO 7779 (2010). El sistema se coloca sobre una mesa estándar, 75 cm por encima de una superficie reflectante. Es posible que los datos que se presentan aquí no sean cumplan completamente con ISO 7779.

(3) Tonos discretos destacados: se siguen los criterios de D.6 y D.11. de ECMA-74 (17.^a ed., diciembre de 2019) para determinar si los tonos discretos son destacados y para informarlos, si es así.

(4) Modo inactivo: es la condición de estado estable en la que el servidor está encendido, pero ninguna función prevista está operativa.

(5) Modo de funcionamiento: el máximo de la salida acústica de estado estable en el 50 % de TDP de CPU o HDD activas por C.9.3.2 en ECMA-74 (17.^a ed., diciembre del 2019).

Manejo de cables, rieles y rack

Temas:

- [Información de manejo de cables y rieles](#)

Información de manejo de cables y rieles

Las ofertas de rieles de PowerEdge R570 son de dos tipos generales: deslizantes y estáticos. Las ofertas de manejo de cables constan de un brazo de administración de cables (CMA) opcional y una barra liberadora de tensión (SRB) opcional.

Consulte la *Matriz de compatibilidad del rack y dimensionamiento de rieles de sistemas Enterprise* disponible en [matriz de racks-rieles](#) para obtener información acerca de lo siguiente:

- Detalles específicos sobre los tipos de rieles.
- Rangos de ajuste de rieles para diversos tipos de bridas de montaje en rack.
- Profundidad del riel con y sin accesorios de manejo de cables
- Tipos de rack admitidos para diversos tipos de brida de montaje en rack.

Los siguientes son factores clave que rigen la adecuada selección de los rieles:

- El espacio entre las bridas de montaje frontal y posterior del rack.
- Tipo y ubicación de los equipos montados en la parte posterior del rack, como unidades de distribución de alimentación (PDU).
- Profundidad total del rack.

Resumen de las características de los rieles deslizantes

Los rieles deslizantes permiten que el sistema se extienda totalmente fuera del rack para las tareas de servicio. Hay dos tipos de rieles deslizantes disponibles: rieles deslizantes ReadyRails II y rieles deslizantes de encaje/encastre. Los rieles deslizantes están disponibles con o sin el brazo de administración de cables (CMA) opcional o la barra liberadora de tensión (SRB) opcional.

Rieles deslizantes B21 ReadyRails para racks de 4 postes

- Compatible con la instalación de encastre del chasis en los rieles.
- Compatibilidad con la instalación sin herramientas en racks de 4 postes con orificios redondos sin rosca o cuadrados compatibles con EIA-310-E de 19", incluyendo todas las generaciones de racks de Dell.
- Compatibilidad con la instalación con herramientas en racks de 4 postes con orificios con rosca compatibles con EIA-310-E de 19".
- Compatibilidad con la extensión completa del sistema fuera del rack para permitir la reparación de componentes internos importantes.
- Soporte para la barra liberadora de tensión (SRB) opcional.
- Soporte para el CMA (brazo de administración de cables) opcional.

NOTA: Para las situaciones en las que no se requiere compatibilidad con el CMA, los soportes de montaje de CMA externos se pueden desinstalar de los rieles deslizantes. Esto reduce la longitud general de los rieles y elimina las posibles interferencias en PDU montadas en la parte posterior o en la puerta del rack posterior.

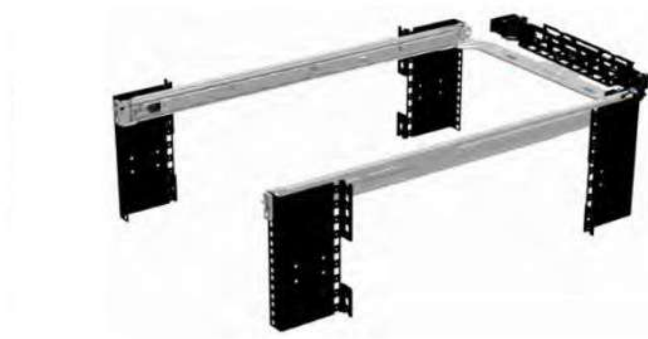


Ilustración 39. Rieles deslizantes con CMA opcional



Ilustración 40. Rieles deslizantes con SRB opcional

Rieles deslizantes de encaje/encastre B22 para racks de 4 postes

- Es compatible con la instalación de encastre o de encaje del chasis en los rieles.
- Compatibilidad con la instalación sin herramientas en racks con orificios redondos sin rosca o cuadrados compatibles con EIA-310-E de 19", incluidas todas las generaciones de racks de Dell. También se soporta la instalación sin herramientas en racks de 4 postes con orificios redondos con rosca.
- Compatibilidad con la instalación sin herramientas en racks Dell Titan-S o Titan-D.
- Compatibilidad con la extensión completa del sistema fuera del rack para permitir la reparación de componentes internos importantes.
- Soporte para el CMA (brazo de administración de cables) opcional.
- Soporte para la barra liberadora de tensión (SRB) opcional.

NOTA: Para las situaciones en las que no se requiere compatibilidad con el CMA, los soportes de montaje de CMA externos se pueden desinstalar de los rieles deslizantes. Esto reduce la longitud general de los rieles y elimina las posibles interferencias en PDU montadas en la parte posterior o en la puerta del rack posterior.

Resumen de rieles estáticos B20

Los rieles estáticos ofrecen una mayor gama de ajuste y necesitan menos espacio total de montaje que los rieles deslizantes, debido a su menor complejidad y a que no deben soportar CMA. Los rieles estáticos soportan una mayor variedad de racks que los rieles deslizantes. Sin embargo, no soportan la facilidad de reparación en el rack y, por lo tanto, no son compatibles con el CMA. Los rieles estáticos tampoco son compatibles con SRB.



Ilustración 41. Rieles estáticos

Resumen de características de los rieles estáticos

Rieles estáticos para racks de 4 postes y de 2 postes:

- Compatible con la instalación de encaje del chasis en los rieles.
- Compatibilidad con la instalación sin herramientas en racks de 4 postes con orificios redondos sin rosca o cuadrados que cumplen con los requisitos de EIA-310-E de 19 pulgadas, incluidas todas las generaciones de racks de Dell.
- Soporte para la instalación con herramientas en racks de 4 y 2 postes con orificios con rosca que cumplen con los requisitos de EIA-310-E de 19 pulgadas.
- Compatibilidad con la instalación con herramientas en racks Dell Titan-S o Titan-D.



NOTA:

- Los tornillos no están incluidos en el kit de rieles estáticos ya que los racks se ofrecen con diversos tipos de rosca. Los tornillos se proporcionan para montaje de rieles estáticos en racks con bridas de montaje con rosca.
- El diámetro de la cabeza del tornillo debe ser de 10 mm o menos.

Instalación en racks de 2 postes

Si realiza la instalación en racks de 2 postes (Telco), debe utilizar los rieles estáticos ReadyRails II (B20). Los rieles deslizantes solo soportan el montaje en racks de 4 postes.



Ilustración 42. Rieles estáticos en una configuración de 2 postes de montaje central

Instalación en los racks Titan-S o Titan-D de Dell

Para una instalación sin herramientas en racks Titan o Titan-D, se deben utilizar los rieles de encaje/encastre (B22). Este riel se contrae lo suficiente para encajar en el rack con bridas de montaje espaciadas alrededor de 24 pulgadas de la parte frontal a la posterior. El riel deslizante de encaje/encastre permite que los biseles de los servidores y los sistemas de almacenamiento se alineen cuando se instalan en estos racks. Para la instalación con herramientas, los rieles estáticos de encaje (B20) se deben usar para la alineación del bisel con sistemas de almacenamiento.

Instalación del rack

El diseño de encastre significa que, para instalar el sistema verticalmente en los rieles, se insertan los separadores en los laterales del sistema, en las ranuras con forma de J de los miembros de los rieles internos, con los rieles en posición extendida. El método de instalación recomendado consiste en insertar primero los separadores posteriores del sistema en las ranuras con forma de J de los rieles, para liberar una mano y, luego, girar el sistema hacia abajo en las ranuras con forma de J restantes usando la mano libre para sostener el riel contra el lateral del sistema.

El diseño de encaje significa que los miembros del riel (del chasis) internos se deben conectar primero a los laterales del sistema y luego se deben insertar a los miembros externos (del gabinete) instalados en el rack.

Instalación del sistema en el rack (opción A: con los rieles colocados)

1. Tire hacia afuera los rieles de deslizamiento interiores del rack hasta que encajen en su lugar.



Ilustración 43. Tire hacia afuera del riel interno

2. Localice el separador de riel posterior de cada lado del sistema y bájeles en las ranuras en J de la parte posterior del ensamblaje deslizante.
3. Gire el sistema hacia abajo hasta que todos los separadores de riel estén introducidos en las ranuras en J.

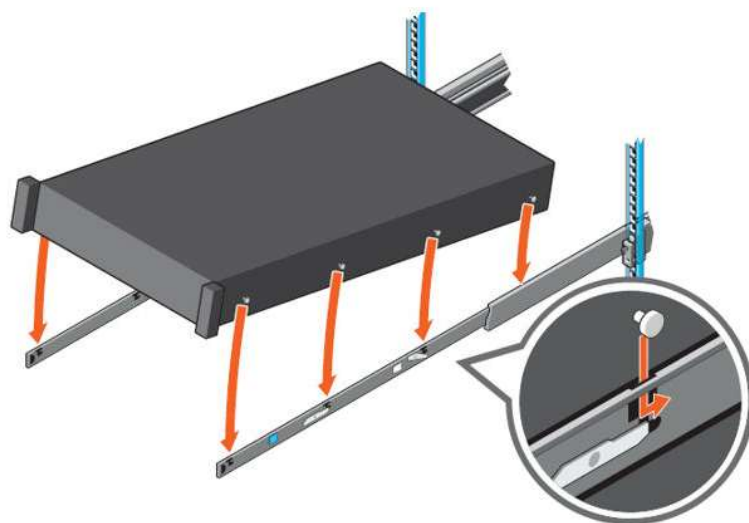


Ilustración 44. Separadores de rieles asentados en las ranuras con forma de J

4. Empuje el sistema hacia dentro hasta que las palancas de bloqueo hagan clic para encajar en su lugar.
5. Tire las lengüetas de bloqueo de liberación y deslizamiento azules hacia delante o hacia atrás en ambos rieles y deslice el sistema dentro del rack hasta que se encuentre dentro.

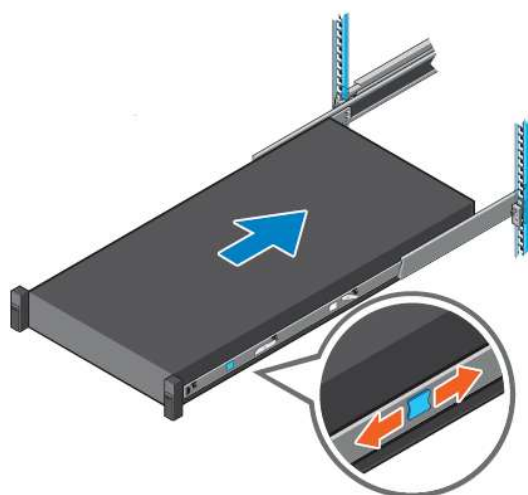


Ilustración 45. Deslice el sistema en el rack

Instalación del sistema en el rack (opción B: de encaje)

1. Empuje hacia afuera los rieles de deslizamiento intermedios del rack hasta que encajen en su lugar.
2. Tire hacia delante de las lengüetas blancas y deslice el riel interno hacia afuera de los rieles intermedios para soltar el cierre del riel interno.

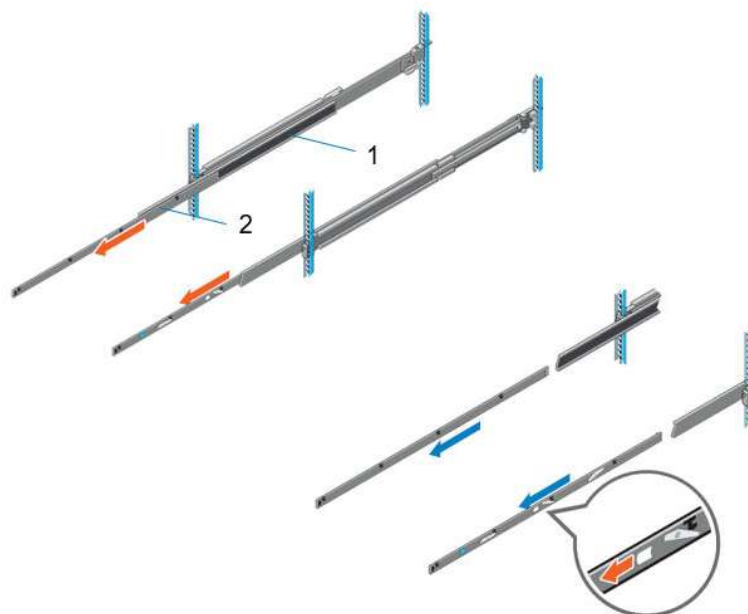


Ilustración 46. Tire del riel intermedio

Tabla 40. Etiqueta de componente del riel

Número	Componente
1	Riel intermedio
2	Riel interno

3. Alinee las ranuras con forma de J en el riel con los separadores del sistema y deslice hacia delante hasta que encajen en su lugar para conectar los rieles internos a los laterales del sistema.

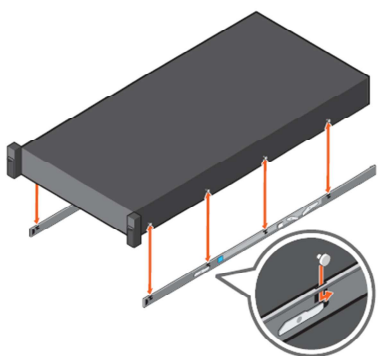


Ilustración 47. Conecte los rieles internos al sistema

4. Con los rieles intermedios extendidos, instale el sistema en los rieles extendidos.

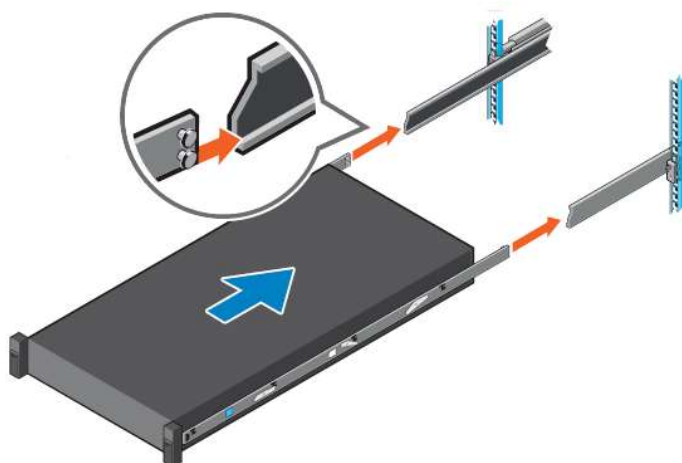


Ilustración 48. Instale el sistema en los rieles extendidos

5. Tire de las lengüetas de bloqueo de deslizamiento y liberación azules hacia delante o hacia atrás en ambos rieles y deslice el sistema en el rack.

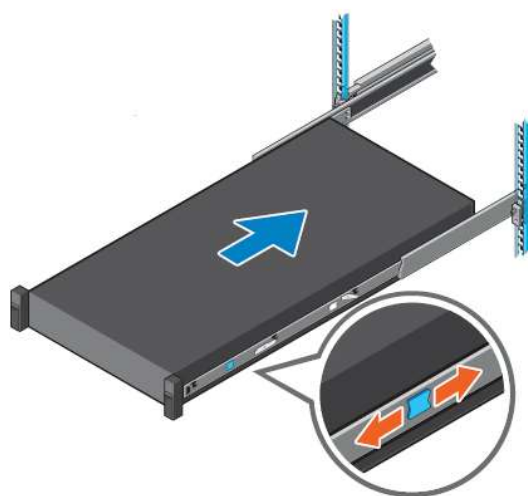


Ilustración 49. Deslice el sistema en el rack

Brazo de administración de cables (CMA)

El brazo de administración de cables (CMA) opcional organiza y fija los cables que salen de la parte posterior de los sistemas. Se desdobra para permitir que los sistemas se extiendan fuera del rack sin tener que desconectar los cables. Entre algunas características clave del CMA, se incluyen:

- Recipientes grandes en forma de U para permitir una carga densa de cables.
- Patrón de ventilación abierta para obtener un flujo de aire óptimo.
- Posibilidad de montaje en ambos lados, girando los soportes cargados con muelles de un lado al otro.
- Utiliza tiras de velcro en lugar de bridas de plástico para eliminar el riesgo de que el cable sufra daños durante el ciclo.
- Incluye una bandeja fija de perfil bajo para sostener y retener el CMA completamente cerrado.
- El CMA y la bandeja se montan sin necesidad de usar herramientas, con diseños de encastre simples e intuitivos.

El CMA se puede montar en cualquiera de los lados de los rieles deslizantes, sin utilizar herramientas o realizar conversiones. Para sistemas con una fuente de alimentación (PSU), se recomienda montar en el lado opuesto al de la fuente de alimentación, para facilitar el acceso a esta y a las unidades posteriores (si corresponde) con fines de servicio o reemplazo.



Ilustración 50. Rieles deslizantes con CMA



Ilustración 51. Cableado del CMA

Barra liberadora de tensión (SRB)

La barra liberadora de tensión (SRB) opcional para PowerEdge R570 organiza y admite conexiones de cables en el extremo posterior del servidor para evitar daños por curvaturas.

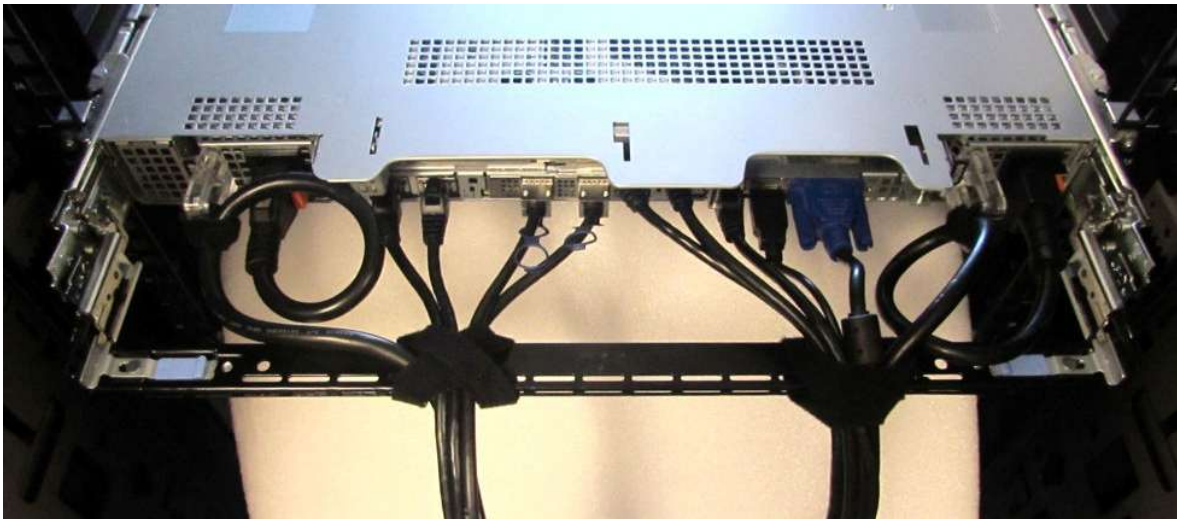


Ilustración 52. Barra liberadora de tensión cableada

- Conexión sin herramientas a los rieles
- Dos posiciones de profundidad para alojar distintas cargas de cables y profundidades de rack
- Es compatible con las cargas de cables y controla la presión en conectores de servidor
- Los cables se pueden separar en paquetes específicos para propósitos discretos

Sistemas operativos y virtualización

Temas:

- [Sistemas operativos soportados](#)

Sistemas operativos soportados

El sistema PowerEdge R570 sistema soporta los siguientes sistemas operativos:

- Canonical Ubuntu Server LTS
- Microsoft Windows Server con Hyper-V
- RedHat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi

Para obtener especificaciones y detalles de interoperabilidad, consulte [Soporte de SO](#).

Dell Systems Management

Dell brinda soluciones de administración que ayudan a los administradores de TI a implementar, actualizar, monitorear y administrar los activos de TI. Las soluciones y las herramientas de OpenManage le permiten responder a problemas y solucionarlos rápidamente mediante la administración eficiente de los servidores Dell en entornos físicos y remotos, y el funcionamiento dentro y fuera de banda (sin agente).

El portafolio de productos OpenManage incluye innovadoras herramientas de administración incorporadas, por ejemplo, Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) y consolas, como OpenManage Enterprise, el plug-in OpenManage Power Manager y herramientas como Repository Manager. Dell ha desarrollado soluciones integrales de administración de sistemas basadas en estándares abiertos, mediante la conexión o integración de sus ofertas con los principales proveedores y marcos de trabajo de administración de sistemas, como Ansible, Microsoft y VMware, lo que permite la administración avanzada del hardware de Dell. Las herramientas clave para la administración de los servidores Dell PowerEdge son la iDRAC y la consola OpenManage Enterprise (OME). OpenManage Enterprise ayuda a los administradores de sistemas con la administración del ciclo de vida de varias generaciones de servidores PowerEdge. OME tiene funciones adicionales que se pueden agregar con plug-ins como OpenManage Enterprise Services, Update Manager, APEX AIOps Observability (anteriormente CloudIQ) y Power Manager. También ofrece la integración con VMware vCenter y Microsoft System Center, además de un conjunto de herramientas que incluye Repository Manager, para facilitar la administración del hardware de PowerEdge. Los cuatro pilares principales de los sistemas administrados de Dell se alinean estrechamente con los problemas y los retos para el negocio que enfrentan muchos departamentos de TI.

- Automatización de la administración de TI.
 - Administración de automatización integral para reducir los gastos operativos y aumentar el tiempo de actividad y la eficiencia en general de los sistemas.
 - Proporciona un conjunto completo de herramientas para la automatización según las necesidades específicas.
- Administración simplificada.
 - Herramientas simples pero potentes, para la administración de servidores Dell.
 - Herramientas integradas que agilizan los compromisos de soporte.
 - Funciones innovadoras de administración listas para usar.
- Seguridad de forma predeterminada.
 - Los servidores Dell ofrecen sólidas defensas de seguridad a modo de prevención contra la última generación de ataques maliciosos.
 - La seguridad está diseñada en profundidad en la arquitectura de firmware y hardware para una protección óptima.
- Administración de infraestructura más inteligente.
 - Ofrece una consola de uno a varios de última generación para administrar la infraestructura de servidor y de TI.
 - Inteligencia incorporada que tiene en cuenta la infraestructura para optimizar la solución de problemas y la implementación.

En este documento, se proporciona una descripción general de las ofertas de OpenManage Systems Management para ayudar a los administradores de TI a elegir las herramientas adecuadas para administrar por completo los servidores Dell PowerEdge.

- La más reciente [Guía de visión general de administración de sistemas Dell](#).

Temas:

- [Integrated Dell Remote Access Controller \(iDRAC\)](#)
- [Matriz de soporte de software de administración de sistemas](#)

Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)

iDRAC10 ofrece administración avanzada, sin agentes, local y remota de servidores. Incorporada en cada servidor PowerEdge, la iDRAC10 proporciona un medio seguro para automatizar muchas tareas comunes de administración. Debido a que la iDRAC está incorporada en todos los servidores PowerEdge, no se debe instalar ningún software adicional; se deben conectar los cables de potencia y de red, y la iDRAC estará lista para su uso. Incluso antes de instalar un sistema operativo o un hipervisor, los administradores de TI tendrán un conjunto completo de funciones de administración de servidor al alcance de la mano.

Con la iDRAC10 implementada en el portafolio de Dell PowerEdge, las mismas técnicas de administración de TI y herramientas se pueden aplicar a todo. Esta plataforma de administración coherente permite escalar los servidores PowerEdge a medida que crecen las necesidades de infraestructura de una organización. Los clientes pueden utilizar la API RESTful de la iDRAC para lo último en métodos de administración escalable de servidores PowerEdge. Con esta API, la iDRAC permite el soporte con el estándar de Redfish y lo mejora con las extensiones de Dell para optimizar la administración en escala de los servidores PowerEdge. Al tener a iDRAC en el núcleo, el

portafolio completo de OpenManage de las herramientas Systems Management permite a todos los clientes adaptar una solución rentable y asequible a un entorno de cualquier tamaño.

El aprovisionamiento sin intervención (ZTP) está integrado en iDRAC. El ZTP es una administración sin agente de automatización inteligente de Dell. Una vez que el servidor PowerEdge se conecta a la alimentación y a las redes, ese sistema puede supervisarse y administrarse completamente, ya sea que esté frente al servidor o de manera remota a través de una red. Sin necesidad de agentes de software, un administrador de TI puede:

- Monitoreo
- Administrar
- Actualizar
- Solucionar problemas y corregir servidores Dell.

Gracias a las características como la implementación y el aprovisionamiento sin intervención y el bloqueo del sistema, la iDRAC10 está especialmente diseñada para simplificar la administración de servidores. Para los clientes cuya plataforma de administración existente utiliza administración dentro de banda, Dell proporciona iDRAC Service Module, un servicio ligero que puede interactuar con iDRAC10 y el sistema operativo del host para soportar plataformas de administración heredadas.

Cuando se piden con DHCP activado de fábrica, los servidores PowerEdge se pueden configurar automáticamente la primera vez que se encienden y se conectan a la red. Este proceso utiliza configuraciones basadas en perfiles que garantizan que cada servidor esté configurado según sus especificaciones. Para esta característica, se requiere la licencia iDRAC Enterprise.

La iDRAC10 ofrece los siguientes niveles de licencia:

Tabla 41. Niveles de licencia de iDRAC10

Licencia	Descripción
iDRAC10 Core	• Disponible para todos los servidores. • Características de administración de sistemas de Core para usuarios conscientes de los costos.
iDRAC10 Enterprise	• Disponible como una venta adicional en todos los servidores. • Incluye todas las funciones de Core. Además, incluye funciones adicionales de automatización, consola virtual y características de seguridad. • Se incluye con las licencias de administración segura de claves empresariales (SEKM) y verificación segura de componentes (SCV).
iDRAC10 Datacenter	• Disponible como una venta adicional en todos los servidores. • Incluye todas las funciones de Core y Enterprise. • Incluye funciones clave como streaming de telemetría y administración térmica. • Incluye aceleradores avanzados (GPU y DPU), administración del sistema y enfriamiento avanzado por aire y líquido.

Para obtener una lista completa de las funciones de iDRAC por nivel de licencia, consulte la **Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller 10** en Dell.com.

Para obtener más detalles sobre iDRAC10, incluidos informes técnicos y videos, consulte:

- El soporte para Integrated Dell Remote Access Controller 10 (iDRAC10) se encuentra en la página de la [Base de conocimientos](http://Base de conocimientos en Dell.com) en Dell.com

Matriz de soporte de software de administración de sistemas

Tabla 42. Matriz de soporte de software de administración de sistemas

Funciones	Especificaciones técnicas
Administración integrada	iDRAC
	iDRAC Direct
	API RESTful de iDRAC con Redfish
	CLI de RACADM
	iDRAC Service Module (iSM)

Tabla 42. Matriz de soporte de software de administración de sistemas (continuación)

Funciones	Especificaciones técnicas
Consola de OpenManage	OpenManage Enterprise (OME)
	OME Power Manager
	OME Services
	OME Update Manager
	OME APEX AIOps Observability
	OME Integration for VMware vCenter (con VMware Aria Operations)
	Integración de OME para Microsoft System Center
	OpenManage Integration for Windows Admin Center
Movilidad	OME Mobile con módulo inalámbrico Quick Sync 2
Herramientas	IPMI
Administración de cambios	Dell Repository Manager
	Actualización del sistema Dell
	Catálogos empresariales
	Server Update Utility (SUU)
OpenManage Integrations	Colecciones Ansible de Red Hat
	Proveedores de Terraform
Seguridad	Firmware firmado criptográficamente
	Cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa)
	Arranque seguro
	Verificación de componentes protegidos (comprobación de integridad de hardware)
	Borrado seguro
	Raíz de confianza de silicio
	Bloqueo del sistema
	FIPS de TPM 2.0, con certificado de CC-TCG
	Detección de intrusiones al chasis
Sistemas operativos	Canonical Ubuntu Server LTS
	Microsoft Windows Server con Hyper-V
	RedHat Enterprise Linux
	SUSE Linux Enterprise Server
	VMware ESXi

Apéndice A: Especificaciones adicionales

Temas:

- Dimensiones del chasis
- Peso del sistema
- Especificaciones del puerto NIC
- Especificaciones de la DPU
- Especificaciones de vídeo
- Puertos USB
- Clasificación de PSU
- Especificaciones ambientales

Dimensiones del chasis

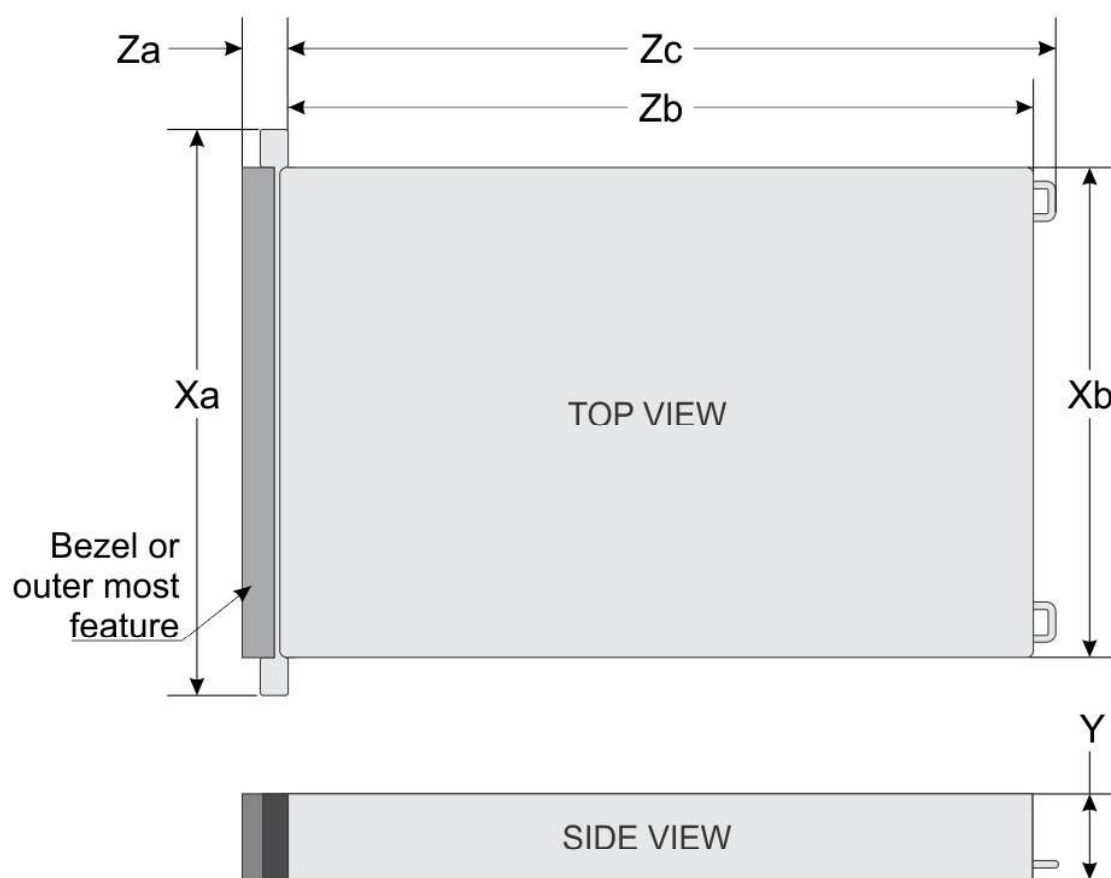


Ilustración 53. Dimensiones del chasis

Tabla 43. Dimensiones del chasis PowerEdge R570

Unidades	Xa	Xb	S	Za	Zb	Zc
Hasta 8 unidades EDSFF E3.S Hasta 16 unidades EDSFF E3.S Configuraciones de pasillo frío	19.0 inches (482 mm)	434 mm (17,1 pulgadas)	86,8 mm (3,42 pulgadas)	42,9 mm (1,69 pulgadas) sin bisel i NOTA: El bisel frontal no soporta una configuración de I/O frontal.	700,7 mm (27,59 pulgadas) de lengüeta a la pared posterior	30.4 inches (771.6 mm)
12 unidades de 3,5 pulgadas 8 unidades de 2,5 pulgadas 16 unidades de 2,5 pulgadas 24 unidades de 2,5 pulgadas Hasta 32 unidades EDSFF E3.S	19.0 inches (482 mm)	434 mm (17,1 pulgadas)	86,8 mm (3,42 pulgadas)	30,78 mm (1,21 pulgadas) con bisel 29,89 mm (1,18 pulgadas) sin bisel	700,7 mm (27,59 pulgadas) de lengüeta a la pared posterior	30.4 inches (771.6 mm)

i **NOTA:** Zb es la superficie externa de la pared posterior nominal, donde se encuentran los conectores de I/O de la placa de HPM.

Peso del sistema

Tabla 44. Peso del sistema PowerEdge R570

Configuración del sistema	Peso máximo (con todas las unidades/SSD)
8 x 2,5 pulgadas SATA (HDD/SSD)	25,2 kg (55,5 lb)
16 x 2,5 pulgadas SATA (HDD/SSD)	27,1 kg (59,7 lb)
24 SATA (HDD/SSD) de 2,5 pulgadas	28,6 kg (63,05 lb)
12 SATA (HDD/SDD) de 3,5 pulgadas	31 kg (68,3 lb)
Configuración de pasillo frío de 8 EDSFF E3.S NVMe de 5.ª generación	27,8 kg (61,28 lb)
8 EDSFF E3.S NVMe de 5.ª generación	22,3 kg (49,16 lb)
16 EDSFF E3. Configuración de corredor de aire frío NVMe de 5.ª generación S	22,9 kg (50,48 lb)
32 EDSFF E3. Configuración de pasillo caliente de NVMe de 5.ª generación S	24,2 kg (53,35 lb)

Tabla 45. Recomendaciones para el manejo del peso de PowerEdge R570

Peso del chasis	Descripción
De 40 a 70 lb	Se recomienda que lo levanten dos personas.
De 70 a 120 lb	Se recomienda que lo levanten tres personas.
≥121 lb	Se recomienda utilizar un elevador de servidor.

Especificaciones del puerto NIC

El PowerEdge R570 sistema soporta puertos de controladora de interfaz de red (NIC) integrados en las tarjetas NIC de Open Compute Project (OCP).

Tabla 46. Especificación del puerto de la NIC para el sistema

Característica	Especificaciones
Tarjeta NIC 3.0 de OCP	2 de 100 GbE, 2 de 25 GbE, 4 de 25 GbE, 2 de 10 GbE, 4 de 10 GbE, 4 de 1 GbE

NOTA: Hasta dos tarjetas NIC de OCP se pueden instalar en la parte frontal o posterior del sistema, según la configuración de I/O del sistema.

Especificaciones de la DPU

La plataforma PowerEdge R470 admite unidades de procesamiento de datos (DPU). Estas unidades son soluciones de sistema en chip que combinan núcleos ARM, NIC de alto rendimiento y motores de aceleración programables para descargar y acelerar los servicios de infraestructura del centro de datos.

Tabla 47. Tarjetas de unidades de procesamiento de datos (DPU) compatibles

Funciones	Especificaciones
Modelo	NVIDIA BlueField-3 B3220
Tipo	Unidades de procesamiento de datos (DPU)
Redes	2 de 200 GbE
Factor de forma	FHHL
Interfaz	PCIe x16 de 5.ª generación
Consumo de energía	150 W
Soportes verticales compatibles	RC 1 (ranura 7), RC 3 (ranura 31), RC 4 (ranura 31), RC 5 (ranura 7), RC 6 (ranura 7), RC 8 (ranura 7), RC 9 (ranura 7), RC 10 (ranura 7), RC 11 (ranura 7)

Especificaciones de vídeo

El PowerEdge R570 sistema soporta la controladora de gráficos Matrox G200 incorporada con 16 MB de buffer de trama de vídeo.

Tabla 48. Opciones de resolución de vídeo compatibles

Solución	Velocidad de actualización (Hz)	Profundidad del color (bits)
640 x 480	60	8, 16, 32
800 x 600	60	8, 16, 32
1024 x 768	60	8, 16, 32
1152 x 864	60	8, 16, 32
1280 x 800	60	8, 16, 32
1280 x 1024	60	8, 16, 32
1360 x 768	60	8, 16, 32
1400 x 1050	60	8, 16, 32
1440 x 900	60	8, 16, 32

Tabla 48. Opciones de resolución de video compatibles (continuación)

Solución	Velocidad de actualización (Hz)	Profundidad del color (bits)
1600 x 1200	60	8, 16, 32
1680 x 1050	60	8, 16, 32
1920 x 1080	60	8, 16, 32
1920 x 1200	60	8, 16, 32

Puertos USB



Ilustración 54. Puerto USB frontal

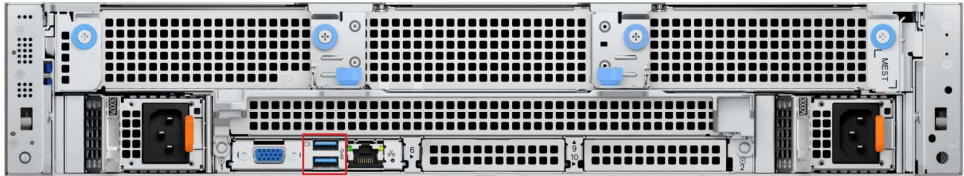


Ilustración 55. Puerto USB posterior

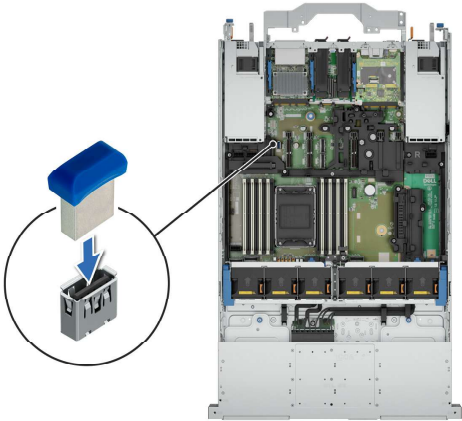


Ilustración 56. Puerto USB interno

Tabla 49. Especificaciones de USB de los sistemas

Parte frontal		Parte posterior		Interno	
Tipo de puerto USB	Núm. de puertos	Tipo de puerto USB	Núm. de puertos	Tipo de puerto USB	Núm. de puertos
Puerto USB 2.0 Type-C	1	Puertos USB 3.1 Type-A	2	Puerto USB 3.1 Type-A	1

Tabla 49. Especificaciones de USB de los sistemas (continuación)

Parte frontal		Parte posterior		Interno	
Puerto USB 2.0 Type-A (opcional)	1				

Clasificación de PSU

En la tabla que se incluye a continuación, se indica la capacidad de alimentación de las PSU en el modo de funcionamiento de línea alta/baja.

Tabla 50. Clasificaciones de PSU de línea alta y línea baja

PSU	Platinum de 800 W	Titanium de 800 W	Titanium de 1100 W	Platinum de 1100 W	Titanium de 1400 W: CC de 48 V	Titanium de 1500 W	Titanium de 1500 W y 277 V	Titanium de 1800 W
Alimentación pico (línea alta)	1240 W	1240 W	1705 W	1705 W	N/D	2325 W	2325 W	2790 W
Línea alta	800 W	800 W	1100 W	1100 W	N/D	1500 W	1500 W	1800 W
Alimentación pico (línea baja)	1240 W	1240 W	1627 W	1627 W	N/D	1627 W	N/D	N/D
Línea baja	800 W	800 W	1050 W	1050 W	N/D	1050 W	N/D	N/D
Línea alta de 240 VCC	800 W	800 W	1100 W	1100 W	N/D	1500 W	N/D	1800 W
Línea alta de 380 VCC	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1500 W	N/D
De -48 a 60 VCC	N/A	N/A	N/A	N/A	1400 W	N/D	N/D	N/D

PowerEdge R570 admite hasta dos fuentes de alimentación de CA con redundancia 1+1, detección automática y funcionalidad de conmutación automática.

Si hay dos PSU presentes durante la POST, se realiza una comparación entre las capacidades de potencia de las PSU. En caso de que las potencias de las PSU no coincidan, se activará la de mayor capacidad. Además, se mostrará una precaución de falta de coincidencia entre PSU en el BIOS o iDRAC.

Si se agrega una segunda PSU en el tiempo de ejecución, para que esa PSU en particular se habilite, la capacidad de potencia de la PSU insertada originalmente debe ser igual a la de la PSU nueva. De lo contrario, la PSU se marcará como incompatible en iDRAC y la segunda PSU no se habilitará.

Las PSU de Dell han alcanzado los niveles de eficiencia Platinum y Titanium, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 51. Nivel de eficiencia de la PSU

Objetivos de eficiencia por carga						
Factor de forma	Mensaje de salida	Clase	10 %	20 %	50 %	100 %
60 mm, redundante	800 W con modo mixto	Platinum	N/A	90,00 %	94,00 %	91,00 %
	Modo mixto de 800 W	Titanium	N/A	90,00 %	94,00 %	91,00 %
	1100 W con modo mixto	Titanium	90,00 %	94,00 %	96,00 %	91,00 %

Tabla 51. Nivel de eficiencia de la PSU (continuación)

Objetivos de eficiencia por carga						
Factor de forma	Mensaje de salida	Clase	10 %	20 %	50 %	100 %
	1100 W con modo mixto	Platinum	90,00 %	94,00 %	96,00 %	91,00 %
	Titanium de 1400 W: CC de 48 V	Titanium	90,00 %	94,00 %	96,00 %	91,00 %
	Modo mixto de 1500 W	Titanium	90,00 %	94,00 %	96,00 %	91,00 %
	1500 W 227 V	Titanium	90,00 %	94,00 %	96,00 %	91,00 %
	Modo mixto de 1800 W	Titanium	90,00 %	94,00 %	96,00 %	91,00 %

Especificaciones ambientales

NOTA: Para obtener más información sobre las certificaciones medioambientales, consulte **Hoja de datos medioambientales de productos** dentro de **Manuales y documentos** en [Soporte de Dell](#).

Tabla 52. Especificaciones de funcionamiento continuo para ASHRAE A3

Temperatura	Operaciones continuas permitidas
Rangos de temperatura para altitudes <= 900 m (<= 2953 pies)	De -5 °C a 40 °C (de 41 °F a 104 °F) sin que el equipo reciba la luz directa del sol
Rangos de porcentaje de humedad (sin condensación en todo momento)	8 % de RH con un punto de condensación mínimo de -12 °C a 85 % de RH con un punto de condensación máximo de 24 °C (75,2 °F)
Reducción de valores nominales de altitud en funcionamiento	La temperatura máxima se reduce 1 °C/175 m (33,8 °F/574 pies) por encima de los 900 m (2953 pies)

Tabla 53. Especificaciones de funcionamiento continuo para ASHRAE A4

Temperatura	Operaciones continuas permitidas
Rangos de temperatura para altitudes <= 900 m (<= 2953 pies)	De -5 °C a 45 °C (de 41 °F a 113 °F) sin que el equipo reciba la luz directa del sol
Rangos de porcentaje de humedad (sin condensación en todo momento)	8 % de RH con un punto de condensación mínimo de -12 °C a 90 % de RH con un punto de condensación máximo de 24 °C (75,2 °F)
Reducción de valores nominales de altitud en funcionamiento	La temperatura máxima se reduce 1 °C/125 m (33,8 °F/410 pies) por encima de los 900 m (2953 pies)

Tabla 54. Especificaciones de vibración máxima

Vibración máxima	Especificaciones
En funcionamiento	0,21 G _{rms} de 5 Hz a 350 Hz (todas las orientaciones de funcionamiento)
Almacenamiento	1,38 G _{rms} de 10 Hz a 500 Hz durante 15 minutos (evaluados los seis laterales)

Tabla 55. Especificaciones de impulso de impacto máximo

Impulso de impacto máximo	Especificaciones
En funcionamiento	Seis impulsos ejecutados consecutivamente en el sentido positivo y negativo de los ejes "x", "y" y "z", de 6 G durante un máximo de 11 ms.

Tabla 55. Especificaciones de impulso de impacto máximo (continuación)

Impulso de impacto máximo	Especificaciones
Almacenamiento	Seis impulsos ejecutados consecutivamente en los ejes "x", "y" y "z", positivo y negativo (un impulso en cada lado del sistema), de 71 G durante un máximo de 2 ms.

Especificaciones de contaminación gaseosa y de partículas

En la tabla a continuación, se definen las limitaciones que ayudan a evitar cualquier falla o daño en el equipo por contaminación gaseosa o de partículas. Si los niveles de emisión de gases y partículas contaminantes están por encima de los límites especificados y causan daños o fallas en el equipo, es posible que deba corregir las condiciones ambientales. La corrección de las condiciones medioambientales será responsabilidad del cliente.

Tabla 56. Especificaciones de contaminación de partículas

Contaminación de partículas	Especificaciones
Filtración de aire: solo centro de datos convencional	ISO clase 8 por ISO 14644-1 define la filtración de aire de centro de datos con un límite de confianza superior del 95 %. NOTA: El filtrado del aire de la sala con un filtro MERV8, como se especifica en ANSI/ASHRAE Standard 127, es un método recomendado para lograr las condiciones de entorno necesarias. NOTA: El aire que entre en el centro de datos tiene que tener una filtración MERV11 o MERV13. NOTA: Esta condición solo se aplica a los ambientes de centro de datos. Los requisitos de la filtración de aire no se aplican a los equipos de TI designados para ser utilizados fuera del centro de datos, en entornos tales como una oficina o una fábrica.
Gabinete o centro de datos de borde locales (entorno sellado de ciclo cerrado)	No se necesita filtración para los gabinetes que se prevé que se abrirán seis veces o menos por año. De lo contrario, se requiere una filtración de clase 8 por ISO 1466-1, como se definió anteriormente. NOTA: En entornos comúnmente superiores a ISA-71 clase G1 o que pueden tener desafíos conocidos, es posible que se requieran filtros especiales.
Polvo conductor: entornos de centro de datos y entornos de centro sin datos	El aire debe estar libre de polvo conductor, filamentos de zinc u otras partículas conductoras. NOTA: El polvo conductor, que puede interferir en el funcionamiento del equipo, puede originarse de diversas fuentes, incluidos los procesos de fabricación y las virutas de zinc que pueden desarrollarse en el revestimiento de placas para piso falso elevadas. NOTA: Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de centro sin datos.
Polvo corrosivo: entornos de centro de datos y entornos de centro sin datos	- El aire debe estar libre de polvo corrosivo. - El polvo residual que haya en el aire debe tener un punto delicuescente inferior a una humedad relativa del 60 %. NOTA: Se aplica a entornos de centro de datos y entornos de centro sin datos.

Tabla 57. Especificaciones de contaminación gaseosa

Contaminación gaseosa	Especificaciones	Notas
Velocidad de corrosión del cupón de cobre	ISA-71 Clase G1: <300 Å/mes	De acuerdo con ANSI/ISA71.04

Tabla 57. Especificaciones de contaminación gaseosa (continuación)

Contaminación gaseosa	Especificaciones	Notas
Velocidad de corrosión del cupón de plata	ISA-71 Clase G1: <200 Å/mes	De acuerdo con ANSI/ISA71.04

Matriz de restricción térmica

Tabla 58. Referencia de etiqueta

Etiqueta	Descripción
STD	Estándar
HPR	Alto rendimiento
HPR Silver	Ventilador Silver de alto rendimiento (HPR)
HPR Gold	Ventilador de alto rendimiento (HPR) Gold
HSK	Disipador de calor
LP	Perfil bajo
FH	Altura completa
EXT	Ampliar

Tabla 59. Matriz del disipador de calor y el procesador

Disipador de calor	TDP del procesador
HSK STD de 2U	- Requiere una cubierta regular - TDP de CPU de ≤ 150 W en una configuración que no es de 12 x 3,5"
HSK HPR	- Requiere una cubierta regular - TDP de CPU de > 150 W o todas las CPU en una configuración de 12 x 3,5"

NOTA: El componente crítico dicta la temperatura ambiente de la configuración. Por ejemplo, si la temperatura ambiente del procesador es 35 °C, la del DIMM es 35 °C y la de la GPU es 30 °C, la temperatura ambiente de la configuración solo puede ser de 30 °C.

Tabla 60. Matriz de restricción térmica para enfriamiento con aire (no GPU)

Configuración		Pasillo frío 8 E3.S 16 E3.S	8 NVMe de 2,5 pulga das	12 SAS/ SATA de 3,5 pulga das	12 SAS/ SATA de 3,5 pulga das	16 unidad es de 2,5 pulga das 24 unida des de 2,5 pulga das	Pasillo caliente 8 E3.S 16 E3.S	Pasillo caliente 32 x E3. S	Tempera tura ambiente
Almacenamiento posterior		Sin unidades posteriores	Sin unidades posteriores	Parte posterior : 4 E3.S	Sin unidades posteriores	Sin unidades posteriores	Sin unidades posteriores	Sin unidades posteriores	
Cubierta		Cubierta regular							
Procesador	TDP/ cTDP	Ventilador/HSK							
6710E	205 W	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	35°C
6756E	225 W	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	35°C
6740E/ 6766E/ 6731E/ 6746E	250 W	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	35°C
6780E	330 W	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	35°C
6507P/ 6505P/ 6511P	150 W	Ventilador HPR Silver STD HSK	Ventilador HPR Silver STD HSK	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Silver STD HSK	Ventilador HPR Silver STD HSK	Ventilador HPR Gold STD HSK	35°C
6517P	190 W	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	35°C
6724P	210 W	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	35°C
6521P	225 W	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver	Ventilador HPR Gold	Ventilador HPR Gold	Ventilador HPR Silver	Ventilador HPR Silver	Ventilador HPR Gold	35°C

Tabla 60. Matriz de restricción térmica para enfriamiento con aire (no GPU) (continuación)

Configuración		Pasillo frío 8 E3.S 16 E3.S	8 NVMe de 2,5 pulga das	12 SAS/ SATA de 3,5 pulga das	12 SAS/ SATA de 3,5 pulga das	16 unidad es de 2,5 pulga das 24 unida des de 2,5 pulga das	Pasillo caliente 8 E3.S 16 E3.S	Pasillo caliente 32 x E3. S	Tempera tura ambiente
Almacenamiento posterior		Sin unidades posteriores	Sin unidades posterior es	Parte posterior : 4 E3.S	Sin unidades posterior es	Sin unidades posterior es	Sin unidades posterior es	Sin unidades posterior es	
Cubierta		Cubierta regular							
Procesad or	TDP/ cTDP	Ventilador/HSK							
			HSK HPR	HSK HPR	HSK HPR	HSK HPR	HSK HPR	HSK HPR	
6731P	245 W	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	35°C
6527P	255 W	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	35°C
6737P	270 W	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	35°C
6730P	250 W	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	35°C
6741P	300 W	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	35°C
6747P	330 W	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	35°C
6787P/ 6767P/ 6781P/ 6761P	350 W	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Silver HSK HPR	Ventilador HPR Gold HSK HPR	35°C
Memoria		Temperatura ambiente							

Tabla 60. Matriz de restricción térmica para enfriamiento con aire (no GPU) (continuación)

Configuración		Pasillo frío 8 E3.S 16 E3.S	8 NVMe de 2,5 pulga das	12 SAS/ SATA de 3,5 pulga das	12 SAS/ SATA de 3,5 pulga das	16 unidad es de 2,5 pulga das 24 unida des de 2,5 pulga das	Pasillo caliente 8 E3.S 16 E3.S	Pasillo caliente 32 x E3. S	Tempera tura ambiente
Almacenamiento posterior		Sin unidades posteriores	Sin unidades posterior es	Parte posterior : 4 E3.S	Sin unidades posterior es	Sin unidades posterior es	Sin unidades posterior es	Sin unidades posterior es	
Cubierta		Cubierta regular							
Procesad or	TDP/ cTDP	Ventilador/HSK							
RDIMM de 16 GB		35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C
RDIMM de 32 GB		35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C
RDIMM de 64 GB		35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C
RDIMM de 96 GB		35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C
RDIMM de 128 GB		35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C

Tabla 61. Matriz de restricción térmica para enfriamiento por aire (GPU)

Configuración		Pasillo frío 8 E3.S 16 E3.S	Temperatura ambiente
Almacenamiento posterior		Sin unidades posteriores	
Cubierta		Cubierta de GPU	
Procesador	TDP/cTDP	Ventilador/HSK	
6710E	205 W	Ventilador HPR Gold 1U EXT HSK	35°C
6756E	225 W	Ventilador HPR Gold 1U EXT HSK	35°C
6740E/6766E/6731E/ 6746E	250 W	Ventilador HPR Gold 1U EXT HSK	35°C
6780E	330 W	Ventilador HPR Gold 1U EXT HSK	35°C
6507P/6505P/6511P	150 W	Ventilador HPR Gold 1U EXT HSK	35°C
6517P	190 W	Ventilador HPR Gold 1U EXT HSK	35°C

Tabla 61. Matriz de restricción térmica para enfriamiento por aire (GPU) (continuación)

Configuración		Pasillo frío 8 E3.S 16 E3.S	Temperatura ambiente
Almacenamiento posterior		Sin unidades posteriores	
Cubierta		Cubierta de GPU	
Procesador	TDP/cTDP	Ventilador/HSK	
6724P	210 W	Ventilador HPR Gold 1U EXT HSK	35°C
6521P	225 W	Ventilador HPR Gold 1U EXT HSK	35°C
6731P	245 W	Ventilador HPR Gold 1U EXT HSK	35°C
6527P	255 W	Ventilador HPR Gold 1U EXT HSK	35°C
6737P	270 W	Ventilador HPR Gold 1U EXT HSK	35°C
6730P	250 W	Ventilador HPR Gold 1U EXT HSK	35°C
6741P	300 W	Ventilador HPR Gold 1U EXT HSK	35°C
6747P	330 W	Ventilador HPR Gold 1U EXT HSK	35°C
6787P/6767P/6781P/ 6761P	350 W	Ventilador HPR Gold 1U EXT HSK	30°C
Memoria		Temperatura ambiente	
RDIMM de 16 GB		35°C	35°C
RDIMM de 32 GB		35°C	35°C
RDIMM de 64 GB		35°C	35°C
RDIMM de 96 GB		35°C	35°C
RDIMM de 128 GB		35°C	35°C

Apéndice B: Cumplimiento de estándares

El sistema cumple con los siguientes estándares del sector.

Tabla 62. Documentos estándar del sector

Estándar	URL para obtener información y especificaciones
ACPI Especificación de interfaz de alimentación y configuración avanzada, v6.4	ACPI
Ethernet Estándar IEEE 802.3-2022	Estándares IEEE
MSFT WHQL Microsoft Windows Hardware Quality Labs	Programa de compatibilidad del hardware de Windows
IPMI Intelligent Platform Management Interface, v2.0	IPMI
Memoria DDR5 Especificación de SDRAM DDR5	DDR5 SDRAM
PCI Express Especificación de base de PCI Express, v5.0.	Especificaciones de PCIe
PMBus Especificación del protocolo de administración de sistema de alimentación, v1.2	Especificaciones de PMBus
SMBIOS Especificación de referencia del BIOS de administración de sistema, v3.3.0	SMBIOS DMTF
TPM Especificación del módulo de plataforma segura, v2.0	Especificaciones de TPM
UEFI Especificación de interfaz de firmware extensible unificada, v2.7	Especificaciones de UEFI
PI Especificación de inicialización de la plataforma, v1.7	
USB Bus serie universal v2.0 y SuperSpeed v3.0 (USB 3.1 de 1.ª generación)	Biblioteca de documentos de USB
NVMe Especificación de base Express. Revision 2.0c	Especificaciones de NVME
NVMe Especificaciones del conjunto de comandos	
1. Especificación del conjunto de comandos de NVM Express. Revision 1.1c	
2. Conjunto de comandos de espacios de nombres zonificados de NVM Express. Revision 1.0c	
3. Conjunto de comandos de valor de clave de NVM Express®. Revision 1.0c	
NVMe Especificaciones de transporte	
1. Transporte de NVM Express mediante PCIe. Revision 1.0c	
2. Revisión de transporte RDMA de NVM Express. 1.0b	
3. Transporte TCP de NVM Express. Revision 1.0c	
NVMe Interfaz de administración de NVM Express. Revision 1.2c	
NVMe Especificación de arranque de NVMe. Revisión 1.0	

Apéndice C: Recursos adicionales

Tabla 63. Recursos adicionales

Recurso	Descripción del contenido	Ubicación
Manual de instalación y servicio	En este manual, disponible en formato PDF, se proporciona la siguiente información: • Características del chasis • Programa de configuración del sistema • Códigos indicadores del sistema • BIOS del sistema • Procedimientos de extracción y reemplazo • Diagnóstico • Puentes y conectores	Dell.com/Support/Manuals
Guía de introducción	Esta guía se envía con el sistema y también está disponible en formato PDF. En esta guía, se proporciona la siguiente información: • Pasos de configuración inicial	Dell.com/Support/Manuals
Guía de instalación del rack	Este documento se envía con los kits del rack y proporciona instrucciones para instalar un servidor en un rack.	Dell.com/Support/Manuals
Etiqueta de información del sistema	La etiqueta de información del sistema documenta el diseño de la placa de HPM y la configuración de los puentes del sistema. El texto se minimiza debido a las limitaciones de espacio y a las consideraciones de traducción. El tamaño de la etiqueta se estandariza en todas las plataformas.	Dentro de la cubierta del chasis del sistema
Etiqueta MyDell	La aplicación de un teléfono puede escanear este código en el chasis para acceder a información adicional y recursos para el servidor, incluidos videos, materiales de referencia, información de la etiqueta de servicio e información de contacto de Dell.	Dentro de la cubierta del chasis del sistema
Herramienta de planificación de la infraestructura empresarial (EIPT)	La EIPT en línea de Dell permite estimaciones más fáciles y significativas para ayudarlo a determinar la configuración más eficiente posible. Utilice la EIPT para calcular el consumo de energía del hardware, la infraestructura de alimentación y el almacenamiento.	Dell.com/calc

Apéndice D: servicio y soporte

Temas:

- ¿Por qué anexar contratos de servicio?
- ProSupport Infrastructure Suite
- Servicios de soporte de especialidad
- ProDeploy Infrastructure Suite
- Servicios de implementación complementarios
- Escenarios exclusivos de implementación
- DÍA 2: servicios de automatización con Ansible
- Servicios de Dell Technologies Consulting

¿Por qué anexar contratos de servicio?

Los servidores Dell PowerEdge incluyen una garantía de hardware estándar que destaca nuestro compromiso con la calidad del producto, ya que garantiza la reparación o el reemplazo de componentes defectuosos. Si bien nuestras garantías son líderes en la industria, tienen un límite de 1 a 3 años, según el modelo, y no cubren la asistencia para software. Los registros de llamadas muestran que los clientes suelen buscar soporte técnico de Dell para problemas relacionados con el software, como orientación sobre la configuración, solución de problemas, asistencia de actualizaciones o ajuste del rendimiento. Aliente a los clientes a comprar contratos de ProSupport Service para complementar la cobertura de la garantía y garantizar un soporte óptimo destinado tanto al hardware como al software. ProSupport proporciona una garantía de hardware completa más allá del periodo de garantía original.

ProSupport Infrastructure Suite

ProSupport Infrastructure Suite es un conjunto de servicios de soporte que permite que los clientes creen la solución adecuada para su empresa. Es un soporte líder en la industria y de clase empresarial que se alinea con la gravedad de los sistemas, la complejidad del entorno y la distribución de sus recursos de TI.

Ilustración 57. ProSupport Enterprise Suite

	Basic Hardware Support ¹	ProSupport	BEST ProSupport Plus
Outcome Assistance and Advocacy via assigned Technical Customer Success Manager ①			
Enjoy a frictionless customer experience with cross-functional lifecycle management aligned to your goals			✓
Accelerate time-to-value through onboarding assistance, education and success planning			✓
Turn challenges into opportunities with actionable strategies powered by data and AI-driven analytics			✓
Ensure coverage continuity while preparing to scale for future success			✓
Proactive Monitoring & Actionable Insights via Dell's connectivity solutions and tools			
Quickly visualize performance through a current system health score		✓	✓
Cybersecurity monitoring and mitigation recommendations provide another layer of protection		✓	✓
Predictive performance and capacity analysis address bottlenecks		✓	✓
Prevent or plan for downtime with predictive hardware anomaly detection		✓	✓
Energy consumption and carbon footprint forecasting support sustainability and stewardship initiatives		✓	✓
Get ahead of problems with proactive issue detection with automated case creation	✓	✓	✓
Streamline internal IT efforts with efficient service request and escalation management tools	✓	✓	✓
Minimize disruptions by self-dispatching eligible parts	✓	✓	✓
Support Essentials			
Receive an assigned incident manager for Sev 1 issues who will work your issue through to resolution		✓	✓
Count on Mission Critical Support during Sev 1 incidents and natural disasters ①			✓
Keep systems code current and performing at peak through Proactive System Maintenance			✓
Get priority access to senior technical support engineers—skip the queues and callbacks			✓
Bringing your own software? We provide limited 3rd party software support ①			✓
Choose onsite parts delivery and labor response that meets your needs	Next Business Day	NBD or 4-hour	4-hour
Select product coverage that best augments your internal resources	Hardware	Hardware & Software	Hardware & Software
Have an issue? We are here for you by phone, chat and online	Local business hours	24/7/365	24/7/365

ProSupport Plus for Infrastructure

ProSupport Plus for Infrastructure es la solución definitiva para los clientes que buscan disfrutar de mantenimiento preventivo y rendimiento óptimo en los activos críticos para sus empresas. El servicio atiende a los clientes que requieren soporte proactivo, predictivo y personalizado para sistemas que administran cargas de trabajo y aplicaciones de negocio críticas. Cuando los clientes adquieren un servidor PowerEdge, recomendamos ProSupport Plus, nuestro servicio de soporte proactivo y preventivo para los sistemas cruciales de su empresa. ProSupport Plus proporciona todos los beneficios de ProSupport, incluidas las siguientes “Cinco razones principales para comprar ProSupport Plus (PSP)”

- Acceso prioritario a expertos especializados en soporte:** una solución de problemas inmediata y avanzada de un ingeniero que comprende las soluciones de infraestructura de Dell.
- Soporte mejorado para situaciones críticas:** cuando se presentan problemas de soporte críticos (gravedad 1), el cliente tiene la garantía de que haremos todo lo posible para que el sistema vuelva a funcionar lo más rápido posible.
- Gerente técnico de éxito del cliente:** El defensor de soporte #1 del cliente, que garantiza que obtenga la mejor experiencia de soporte proactivo y predictivo posible.
- Mantenimiento de sistemas:** semestralmente, mantendremos actualizados los sistemas ProSupport Plus de un cliente mediante la instalación de las últimas actualizaciones de firmware, BIOS y controladores para mejorar el rendimiento y la disponibilidad.
- Soporte de software de otros fabricantes:** Dell es el único punto de responsabilidad del cliente para todo el software elegible de otros fabricantes que se instale en su sistema ProSupport Plus, ya sea que nos haya comprado o no el software.

ProSupport for Infrastructure

Soporte integral 24x7 para hardware y software, lo mejor para aplicaciones y cargas de trabajo de producción, pero no críticas. El servicio ProSupport ofrece expertos altamente capacitados a toda hora y en todo el mundo para abordar sus necesidades de TI. Ayudamos a minimizar las interrupciones y a maximizar la disponibilidad de las cargas de trabajo de servidores PowerEdge con lo siguiente:

- soporte 24x7 por teléfono, chat y en línea
- Un punto de responsabilidad central para todos los problemas de hardware y software
- Compatibilidad con aplicaciones, hipervisor y sistema operativo
- Asesorías de seguridad de Dell

- Opciones de niveles de servicio de respuesta en el sitio de 4 horas o al siguiente día laboral
- Detección proactiva de problemas con creación automatizada de casos
- Detección predictiva de anomalías de hardware
- Administrador de incidentes asignado para casos de gravedad 1
- Soporte colaborativo de otros fabricantes
- Acceso a las AIOps platforms (MyService360, TechDirect y CloudIQ)
- Experiencia coherente, independientemente de dónde se encuentren los clientes o qué idioma hablen.

Basic Hardware Support

Proporciona soporte de hardware reactivo durante el horario comercial normal, excepto los días festivos nacionales locales. Sin soporte de software ni orientación relacionada con software. Para mejorar los niveles de soporte, elija ProSupport o ProSupport Plus.

Servicios de soporte de especialidad

Los servicios de soporte de especialidad opcionales complementan ProSupport Infrastructure Suite para proporcionar competencias adicionales que son fundamentales para las operaciones de los centros de datos modernos.

Complementos de cobertura de hardware para ProSupport o ProSupport Plus

- **Conserve su disco duro (KYHD), Conserve su componente (KYC) o Conserve su GPU (KYGPU):**

Normalmente, si un dispositivo falla mientras está en garantía, Dell lo reemplaza mediante un proceso de intercambio uno por uno. KYHD/KYCC/KYGPU le brindan la opción de conservar el dispositivo. Proporciona un control total de la información confidencial y minimiza los riesgos de seguridad, ya que le permite conservar las unidades, los componentes o GPU defectuosos cuando recibe piezas de reemplazo sin incurrir en costos adicionales.

- **Servicio Onsite Diagnosis:**

Ideal para sitios con personal no técnico. El técnico de campo de Dell realiza el diagnóstico inicial de solución de problemas en el sitio y lo transfiere a los ingenieros remotos de Dell para resolver el problema.

- **Complemento de ProSupport para HPC:**

Vendido como complemento de un contrato de ProSupport Service, el complemento de ProSupport para HPC ofrece soporte orientado a las soluciones a fin de cubrir los requisitos adicionales que se requieren para mantener un entorno de HPC, como los siguientes:

- Acceso a expertos ejecutivos de HPC
- Asistencia para el clúster de HPC avanzado: rendimiento, interoperabilidad y configuración
- Soporte integral mejorado a nivel de soluciones de HPC
- Contratación de soporte previo remoto con especialistas de HPC durante la implementación de ProDeploy

- **Complemento de ProSupport para Telco (Respond & Restore)**

Respond & Restore, un servicio complementario diseñado para los 31 clientes principales de TELCO en todo el mundo, proporciona acceso directo a expertos en soluciones de Dell que se especializan en soporte de grado de operador de TELCO. Este complemento también proporciona una garantía de tiempo de actividad del hardware, lo que significa que, si un sistema falla, Dell lo instala y lo pone en funcionamiento dentro de las 4 horas en el caso de los problemas de gravedad 1. Dell incurre en sanciones y cargos si no se cumplen con los SLA.

Soporte personalizado y experiencia complementaria en todo el sitio

- **Technical Account Manager:**

Líder tecnológico designado que monitorea y administra el rendimiento y la configuración de conjuntos de tecnologías específicas.

- **Designated Remote Support:**

Experto en soporte personalizado que administra toda la solución de problemas y la resolución de activos de TI.

- **Servicio Multivendor Support:**

Ofrece soporte a sus dispositivos de otros fabricantes como un solo plan de servicio para servidores, almacenamiento y redes (incluye cobertura para: Broadcom, Cisco, Fujitsu, HPE, Hitachi, Huawei, IBM, Lenovo, NetApp, Oracle, Quanta, SuperMicro y otros).

Servicios para grandes empresas

- **ProSupport One for Data Center:**

ProSupport One for Data Center ofrece soporte flexible en todo el sitio para centros de datos grandes y distribuidos con más de 1000 activos (total combinado de servidores, almacenamiento, redes, etc.). Esta oferta está diseñada con las características de ProSupport estándares que aprovechan nuestra escala global y que están diseñadas para las necesidades específicas de los clientes. Aunque no es para todos, esta opción de servicio ofrece una solución verdaderamente exclusiva para nuestros clientes más grandes, con los entornos más complejos.

- Equipo de servicio de ejecutivo de cuentas asignados con opciones remotas o en el sitio
- Ingenieros técnicos y de campo asignados que están capacitados en el entorno y las configuraciones del cliente.
- Generación de informes y recomendaciones según demanda habilitadas por las herramientas AIOps de ProSupport (MyService360, TechDirect y CloudIQ)
- Soporte flexible en el sitio y opciones de piezas que se ajustan a su modelo operativo
- Un plan de soporte especialmente diseñado y capacitación para el personal de operaciones del cliente

- **ProSupport One para el centro de datos: CSP (proveedor de servicios de nube) y solución de IA**

ProSupport One para centros de datos: solución de CSP e IA es una oferta única diseñada para un conjunto limitado de cuentas de Dell que adquieren soluciones de computación de IA de más de 1000 servidores y \$250 millones en ventas. PS1DC: el CSP y la IA mejoran toda la experiencia de servicios mediante la combinación de soporte, implementación (integración de rack), servicios de residencia, un ingeniero de soporte designado, un ingeniero de servicio en el sitio y un servicio de piezas en el sitio como una oferta integral. Los precios especiales se determinaron para competir eficazmente con los competidores y proporcionar la mejor experiencia para el cliente. PS1DC para CSP e IA solo se puede vender con servidores XE y todas las plataformas de redes (Dell y NVIDIA). Todos los demás productos serían elegibles para la PS1DC estándar, no para esta oferta única. Más detalles sobre PS1DC para CSP e IA [aquí](#).

- **Servicio de piezas en el sitio (OPS)**

Ideal para grandes empresas que tienen su propio personal para brindar soporte a su centro de datos. Dell ofrece un servicio que se denomina Servicio de piezas en el sitio (OPS) de Dell Services. OPS administra el inventario de piezas ubicado en la instalación designada del cliente. El programa Logistics Online Inventory Solution (LOIS) utilizará software para soportar el monitoreo y la reposición automática del inventario almacenado en el sitio del cliente. . Cada pieza de reemplazo iniciará automáticamente una reposición del inventario de piezas que Dell envía al día siguiente o lo entrega en el sitio durante una visita regular programada (que se denomina Servicio en el sitio programado). Como parte del sistema de LOIS, los clientes pueden integrar sus sistemas directamente a Dell TechDirect mediante el uso de API para ayudar a optimizar el proceso de administración de soporte.

Servicios de final del ciclo de vida

- **Post Standard Support (PSS)**

Extienda la vida útil más allá de los siete años iniciales de ProSupport, con la adición de hasta cinco años más de cobertura de hardware.

- **Data Sanitization & Data Destruction**

Hace que los datos sean irrecuperables en productos replanificados o retirados, lo cual garantiza la seguridad de los datos confidenciales y permite el cumplimiento de normas y proporciona una certificación compatible con NIST.

- **Asset Recovery Services**

Reciclaje, reventa y eliminación del hardware. Lo ayuda a retirar de forma segura y responsable los activos de TI que ya no son necesarios y, al mismo tiempo, proteger su empresa y el planeta.

ProDeploy Infrastructure Suite

ProDeploy Infrastructure Suite proporciona varias ofertas de implementación que satisfacen las necesidades exclusivas del cliente. Se compone de varias subofertas: servicios de configuración de fábrica, integración de rack, Basic Deployment, ProDeploy, ProDeploy Plus y, opcionalmente, ProDeploy FLEX, lo que permite personalizar algunas de las funciones enumeradas.

ProDeploy Infrastructure Suite

Versatile choices for accelerated deployments

NOTE: All XE Series servers require mandatory deployment

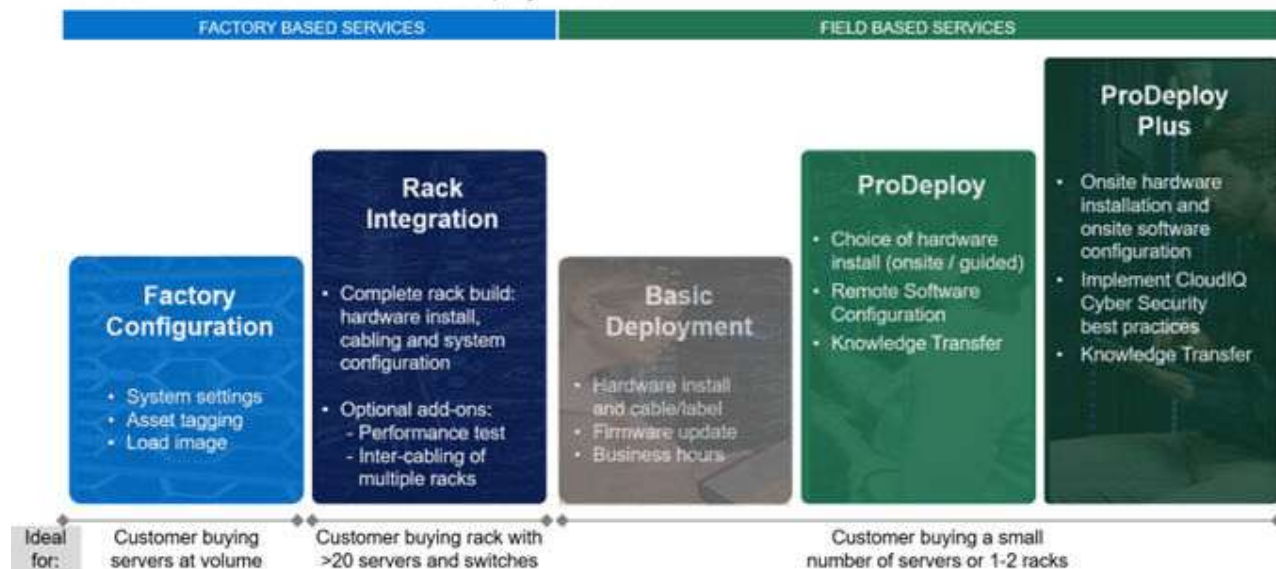


Ilustración 58. ProDeploy Infrastructure Suite

Servicios basados en fábrica

Sistemas preconfigurados o racks completos, personalizados antes del envío al sitio del cliente.

Integración de racks del cliente o integración de racks de ProDeploy FLEX

Dell ofrece sólidos servicios de integración de racks personalizados a través de dos programas principales: Enterprise Rack Integration Services y Integrated Rack Scalable Systems (IRSS). Estos servicios están diseñados para simplificar la implementación, reducir la complejidad y optimizar el rendimiento de los centros de datos, los entornos perimetrales y las cargas de trabajo de IA. Estos servicios de fábrica se compran como una contratación personalizada o como SKU de integración de rack de ProDeploy Flex.

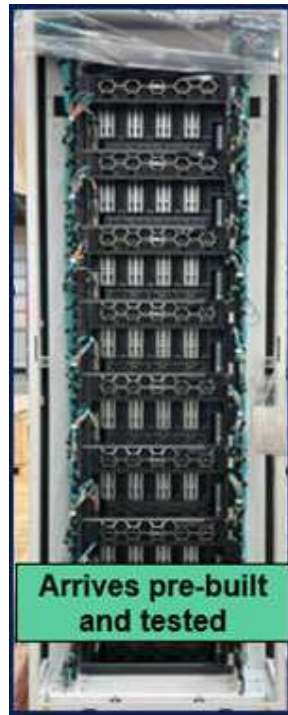


Ilustración 59. Sistema preconfigurado



Ilustración 60. Sistema preconfigurado

Configuración de fábrica

Ideal para los clientes que compran servidores en volumen y buscan una configuración previa antes del envío, como una imagen personalizada, la configuración del sistema y el etiquetado de activos para que llegue todo listo para su uso de inmediato. Además, los servidores se empaquetan y embalan para cumplir con los requisitos específicos de envío y distribución para cada ubicación del cliente a fin de facilitar el proceso de implementación. Una vez que el servidor esté en el sitio, Dell puede instalar y configurar el servidor en el entorno mediante cualquiera de los servicios de implementación basados en campo que se describen en la siguiente sección.

Servicios basados en campo

Ponga los servidores PowerEdge a trabajar más rápido con los servicios de implementación basados en campo de Dell. Ya sea que implementemos de un servidor a mil, usted estará cubierto. Dell ofrece opciones de entrega versátiles para adaptarse a cada presupuesto y modelo operativo.

- **ProDeploy Plus:** eleve las implementaciones de infraestructura con nuestro servicio más completo, desde la planificación hasta la instalación de hardware en el sitio y la configuración de software, incluida la implementación de las prácticas recomendadas de ciberseguridad. ProDeploy Plus proporciona la capacidad y la escala necesarias para llevar a cabo implementaciones exigentes correctamente en entornos de TI complejos de la actualidad. La implementación comienza con una revisión de la preparación del sitio y un plan de implementación. Expertos en implementación certificados realizan la configuración de software para incluir la configuración

de los hipervisores y sistemas operativos líderes. Dell también configurará las herramientas de software de PowerEdge para incluir las utilidades del sistema de OpenManage e iDRAC y también admitir las AI/Ops platforms: MyService360, TechDirect y CloudIQ. La implementación de ciberseguridad, que es exclusiva de ProDeploy Plus, ayuda a los clientes a comprender los posibles riesgos de seguridad y hacer recomendaciones para reducir las superficies de ataque de productos. El sistema se prueba y valida antes de su finalización. El cliente también recibirá documentación completa del proyecto y transferencia de conocimientos para completar el proceso.

- **ProDeploy:** ProDeploy proporciona configuración de software remota y opciones de instalación de hardware (en el sitio o guiada). ProDeploy es ideal para los clientes que son sensibles a los precios o que están dispuestos a participar en alguna parte de la implementación para incluir el suministro de acceso remoto a su red. La implementación de software remota de ProDeploy incluye todo lo mencionado en ProDeploy Plus, excepto que no incluye el valor agregado, la implementación de ciberseguridad ni las prácticas recomendadas.
- **Basic Deployment:** Basic Deployment ofrece una instalación profesional sin preocupaciones a cargo de técnicos experimentados. A menudo, este servicio se vende a partners habilitados para la competencia que harán que Dell realice la instalación de hardware, mientras ellos completan la configuración de software. Además, Basic Deployment tiende a ser adquirido por grandes empresas que tienen personal técnico inteligente. Estas empresas solo necesitan que Dell instale el hardware y ellas realizarán la configuración de software. El último caso de uso para Basic Deployment es cuando se combina con los servicios Factory Configuration. Los servidores se preconfiguran en fábrica y el servicio Basic Deployment instalará el sistema en el rack para finalizar la implementación.

ProDeploy Infrastructure Suite | Field services

		Basic Deployment	ProDeploy	ProDeploy Plus
Pre-deployment	Single point of contact for project management	-	●	In region
	Site readiness review and implementation planning	-	●	●
Deployment	Deployment service hours	Business hours	24/7	24/7
	Hardware installation options	Onsite	Onsite or guided ¹	Onsite
	System software installation and configuration options	-	Remote	Onsite
	Install connectivity software based on Secure Connect Gateway technology ²	-	●	●
	Implement CyberSecurity best practices and policies in APEX AI/Ops Infrastructure Observability	-	-	●
Post-deployment	Deployment verification, documentation and knowledge transfer	-	●	●
	Configuration data transfer to Dell technical support	-	●	●
Online collaboration	Online collaborative platform in TechDirect for planning, managing and tracking delivery	-	●	●

¹ Choose from onsite hardware installation or a guided option including project specific instructions, documentation and live expert guidance

² Post deployment use for intelligent, automated support & insights

Ilustración 61. ProDeploy Infrastructure Suite: servicios de campo

Servicios de implementación complementarios

Formas adicionales de expansión del alcance o de implementación para escenarios exclusivos.

Adición de dos hosts (requiere PD/PDP)

La implementación de nuevos dispositivos de almacenamiento, computación o redes puede requerir interconexión con otros servidores (también denominados hosts). El equipo de entrega de Dell configurará cuatro hosts por dispositivo como parte de cada servicio ProDeploy. Por ejemplo, si el cliente compra dos arreglos de almacenamiento, el servicio ProDeploy incluirá automáticamente la conectividad de cuatro hosts para cada uno (4x2=8 hosts en total por proyecto, ya que hay dos dispositivos). Este servicio adicional "Adición de dos hosts" proporciona la configuración de hosts adicionales, además de lo que ya se proporciona como parte del servicio ProDeploy. En muchos casos, los clientes pueden trabajar con nosotros mientras configuramos los hosts incluidos y así comprender cómo hacer el resto ellos mismos. Siempre pregúntele al cliente cuántos hosts se están conectando y venda la adición de hosts según el conjunto de habilidades tecnológicas del cliente. Tenga en cuenta que este servicio se aplica a la conectividad de dispositivos Dell, no a dispositivos de otros fabricantes.

Servicios Additional Deployment Time (ADT): se venden con o sin PD/PDP

Puede expandir el alcance de una participación de ProDeploy mediante el aprovechamiento de Additional Deployment Time (ADT). El ADT cubre tareas adicionales, además de las prestaciones normales de las ofertas de ProDeploy. El ADT también se puede utilizar como un servicio independiente sin ProDeploy. Las SKU están disponibles tanto para la administración de proyectos como para la experiencia en recursos técnicos. Las SKU se venden como bloques de cuatro horas remotas u ocho horas en el sitio. El equipo de entrega puede ayudar en el alcance de la cantidad de horas requeridas para tareas adicionales.

Servicios de migración de datos

La migración de conjuntos de datos no es una tarea fácil. Nuestros expertos utilizan herramientas y un proceso comprobados para optimizar las migraciones de datos y evitar comprometer los datos. Un administrador de proyectos del cliente trabaja con nuestro experimentado equipo de expertos para crear un plan de migración. La migración de datos es parte de cada actualización de tecnología, cambio de plataforma y cambio a la nube. Puede confiar en los servicios de migración de datos de Dell para realizar una transición sin contratiempos.

Servicios de residencia

Los profesionales técnicos certificados actúan como una extensión de su personal de TI para mejorar las funcionalidades y los recursos internos, y para ayudarlo a lograr una adopción más rápida y maximizar el ROI de la nueva tecnología. Los servicios de residencia ayudan a los clientes a realizar la transición a nuevas funcionalidades rápidamente, mediante el aprovechamiento de conjuntos de habilidades tecnológicas específicas. Los expertos de residencia pueden brindar administración posterior a la implementación y transferencia de conocimientos relacionados con una nueva adquisición de tecnología o con la administración operativa diaria de la infraestructura de TI.

- Expertos globales disponibles para prestar servicios en persona (en el sitio) o virtuales (remotos)
- Participaciones a partir de 2 semanas con flexibilidad para ajuste
- La residencia está disponible para las necesidades de administración de proyectos y muchos conjuntos de habilidades tecnológicas diferentes, como servidores, almacenamiento, IA generativa, redes, seguridad, múltiples nubes, administración de datos y residentes de aplicaciones de fuerza laboral moderna

Escenarios exclusivos de implementación

Servicios de implementación personalizada

Cuando una implementación está más allá del alcance de ProDeploy Infrastructure Suite, puede recurrir al equipo de servicios de implementación personalizada para abordar escenarios complejos de implementación y requisitos exclusivos del cliente. El equipo de implementación personalizada de Dell cuenta con arquitectos de soluciones que ayudarán con las llamadas de determinación del alcance del cliente para definir el proyecto y desarrollar la declaración de trabajo. Los servicios personalizados pueden manejar una amplia variedad de implementaciones que se pueden realizar en la fábrica o en el sitio. Todos los servicios de participación personalizada se solicitan a través de SFDC.

Implementación de IA o HPC mediante servicios de compilación de clúster

Una vez que el rack integrado llega al centro de datos o se construye en el sitio, Dell también puede convertir los racks en un gran clúster de computación. Dell proporciona varias opciones de implementación para implementaciones de inteligencia artificial (IA) o computación de alto rendimiento (HPC). Estos entornos complejos requieren especialistas que comprendan los conjuntos de características avanzadas para crear un clúster de computación unificado para las cargas de trabajo más exigentes. Seleccione uno de los siguientes complementos de compilación de clúster.

Increase Time to Value and with ProDeploy Flex and Cluster Builds

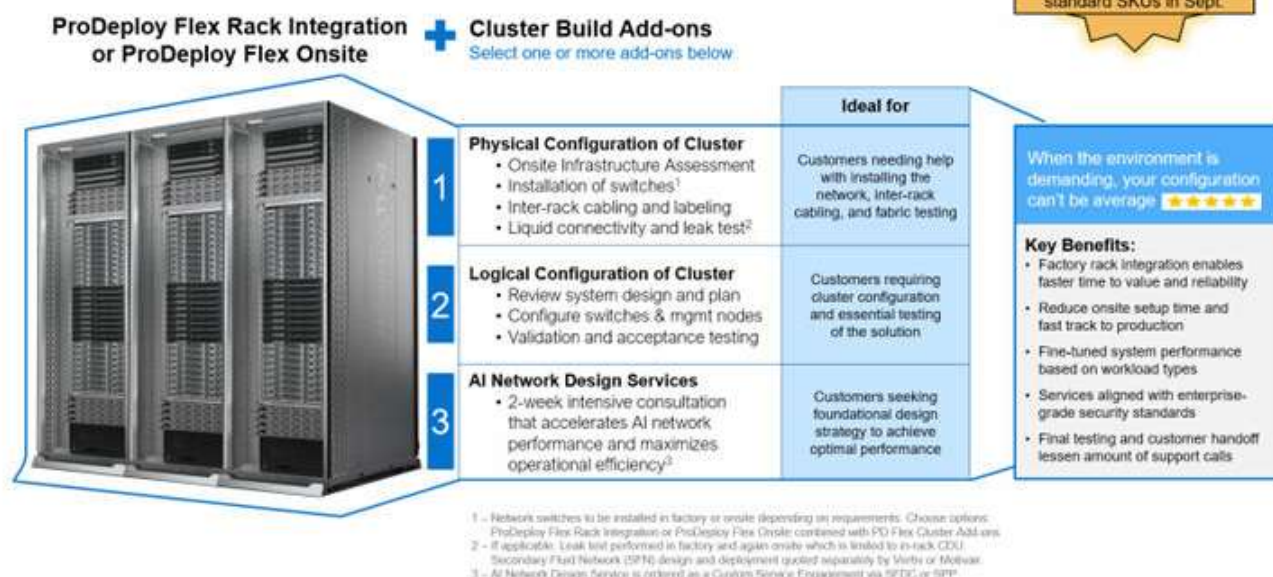


Ilustración 62. Opciones de implementación para la implementación de clúster

DÍA 2: servicios de automatización con Ansible

Las soluciones de Dell se crean como “preparadas para la automatización” con API (interfaces de programación de aplicaciones) integradas para permitir que los clientes realicen llamadas a la acción de manera programática sobre el producto a través del código. Aunque Dell ha publicado casos de uso de automatización de Ansible, algunos clientes necesitan ayuda adicional con GitOps. Al final del servicio, el cliente tendrá los componentes básicos necesarios para acelerar la automatización y comprender cómo funciona la programación en conjunto: scripts de automatización de casos de uso del día 1 y día 2 (Ansible Modules), la herramienta CI/CD (Jenkins) y el control de versiones (Git).

Servicios de Dell Technologies Consulting

Nuestros asesores expertos ayudan a los clientes a transformarse más rápido y lograr rápidamente resultados comerciales para cargas de trabajo de alto valor que los sistemas Dell PowerEdge pueden manejar. De la estrategia a la implementación a escala completa, Dell Technologies Consulting puede ayudar a determinar cómo realizar la transformación de TI, del personal o de las aplicaciones. Utilizamos enfoques prescriptivos y metodologías comprobadas, junto con el ecosistema de partners y el portafolio de Dell Technologies, para ayudar a obtener resultados comerciales reales. Desde los entornos multinube, las aplicaciones, las DevOps y las transformaciones de infraestructura hasta la resiliencia de la empresa, la modernización del centro de datos, el análisis, la colaboración del personal y las experiencias de los usuarios, estamos aquí para ayudarlo.

Servicios administrados de Dell

Algunos clientes prefieren que Dell administre la complejidad y el riesgo de las operaciones diarias de TI. Los servicios administrados de Dell utilizan operaciones de entrega proactivas habilitadas con IA y automatización moderna para ayudar a los clientes a obtener los resultados comerciales deseados a partir de sus inversiones en infraestructura. Con estas tecnologías, nuestros expertos ejecutan, actualizan y ajustan los entornos de los clientes con los niveles de servicio y proporcionan, a la vez, visibilidad en todo el entorno y en los dispositivos. Hay dos tipos de ofertas de servicios administrados. En primer lugar, el modelo de subcontratación o modelo CAPEX, donde Dell administra los activos de propiedad del cliente mediante nuestro personal y nuestras herramientas. El segundo es el modelo como servicio o modelo de gastos operativos, llamado Dell APEX. En este servicio, Dell posee toda la tecnología y toda la administración de ella. Muchos clientes tendrán una combinación de los dos tipos de administración según los objetivos de la organización.



Ilustración 63. Servicios administrados de Dell

Servicios de seguridad cibernética

Managed Detection and Response (MDR)

Dell Managed Detection and Response Pro Plus es nuestra solución de operaciones de seguridad de 360° completamente administrada que consta de nuestros servicios de ciberseguridad más avanzados, preventivos y con mayor capacidad de respuesta. MDR Pro Plus se diseñó teniendo en cuenta sus principales preocupaciones de seguridad, lo que le permite centrarse en los objetivos principales de su negocio mientras Dell maneja sus operaciones de seguridad. En primer lugar, tenemos Vulnerability Management. Con este servicio, realizaremos un escaneo continuo del entorno del cliente en busca de software que necesite parches. A continuación, se detallan las pruebas de penetración y la administración de simulación de ataques. Este servicio validará continuamente los controles y las políticas de seguridad con simulación de vulneraciones y ataques (BAS) automatizada, ya que una configuración incorrecta puede dar lugar a una exposición que un atacante puede explotar. El servicio también incluye una prueba de penetración anual para determinar si un actor de amenazas calificado podría explotar las rutas que conducen a activos o datos críticos. En tercer lugar, tenemos Managed Security Awareness Training. Este servicio capacitará a los usuarios finales del cliente para que no pongan en riesgo al cliente de manera inadvertida. Si piensa en nuestros módulos anuales de capacitación sobre cumplimiento, siempre hay un módulo de seguridad. Este es el mismo tipo de cosas, pero en lugar de una vez al año, serán piezas de contenido más pequeñas y del tamaño de un bocado que se entregarán durante todo el año. En cuarto lugar, está nuestro servicio de detección y respuesta administradas, que proporciona detección e investigación de amenazas 24x7, análisis de la actividad integral por parte de los actores de amenazas, búsqueda de amenazas e inicio rápido de respuesta ante incidentes cibernéticos cuando sea necesario. Los clientes pueden elegir entre Secureworks Taegis XDR, CrowdStrike Falcon XDR o Microsoft Defender XDR como la plataforma de análisis de seguridad que nuestros analistas utilizarán para monitorear su entorno. Estos cuatro servicios son prestados por expertos en seguridad de Dell certificados y experimentados que utilizan tecnología avanzada, como las plataformas de seguridad Secureworks Taegis XDR, CrowdStrike Falcon XDR o Microsoft Defender XDR.

Dell Technologies Education Services

Construya las habilidades de TI necesarias para influir en los resultados de transformación de la empresa. Promueva el talento y capacite a los equipos con las habilidades adecuadas para liderar y ejecutar una estrategia de transformación que impulse la ventaja competitiva. Aproveche la capacitación y certificación necesarias para la transformación real.

Dell Technologies Education Services ofrece capacitación y certificación para servidores PowerEdge, diseñados a fin de ayudar a los clientes a obtener más de su inversión en hardware. El plan de estudios proporciona la información y las habilidades prácticas y de forma directa que su equipo necesita para instalar, configurar, administrar y solucionar problemas en servidores de Dell.

Para obtener más información o registrarse para una clase hoy, consulte Education.Dell.com.

Recursos

[Servicio para PowerEdge](#)